MAXIMUS VI HERO

用 户 手 册

Motherboard

C8181
1.00 版
2013 年 5 月发行

版权说明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到着作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网http://support.asus.com，或是直接与华硕电脑客户关怀中心800-820-6655、400-620-6655联系（不能拨打800电话的用户，请拨打技术支持电话020-28047506）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

（1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。

（2）本产品序号模糊不清或丢失。

本产品的名称与版本都会印在主板/显卡上，版本数字的编码方式是用三个数字组成，并有一个小数点做间隔，如 1.02G、2.03G 等...数字越大表示版本越新，而越左边位数的数字更动表示更动幅度也越大。升级的详细说明请您到华硕的互联网浏览或是直接与华硕联络。

三年质保 全国联保

华硕产品质量保证卡

尊敬的华硕产品用户：

首先非常感谢您选用华硕公司产品，让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存此质量保证卡。

保修说明注意事项：

一、 请将此质量保证卡下方的用户数据填写完整，并由最终直接经销商加盖印章，如果没有加盖印章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留购买发票或复印件，否则华硕公司将以产品的出厂日期为参照进行保修。

二、 华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。

三、 华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行全国联保服务。注：

A. 消费者必须出具正规购买发票或国家认可的有效凭证方可享受全国联保。

B. 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证，则需送修至原购买经销商处享受保修服务。

四、 若经本公司判断属下列因素，则不属于免费保修服务的范围，本公司将有权利收取维修费用：

A. 超过华硕提供的质保有效期的主板、显卡产品。

B. 因遇不可抗拒外力（如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等）或人为之操作使用不慎造成之损害。

C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成的损坏。

D. 用户擅自或请第三方人员自行检修、改装、更改组件、修改线路等。

E. 因用户自行安装软件即设置不当所造成之使用问题及故障。

F. 本公司产品序列号标贴撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与实际产品不符。

G. 其他不正常使用所造成之问题及故障。

五、 技术支持及维修服务：

1. 我们建议您先登录华硕官方会员网站（http://vip.asus.com），对您购买的华硕产品进行在线注册，注册后您将会定期得到我们发送的产品信息以及技术数据；
2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；
3. 您亦可访问华硕中文网站技术支持页面（http://support.asus.com.cn）查询到相应的技术支持信息与常见问题排除；
4. 登录我们的在线技术支持服务区进行咨询（http://www.asus.com.cn/email）；
5. 也欢迎您拨打华硕海星服务 7x24 小时免费技术支持专线 800-820-6655、400-620-6655，由我们的在线工程师为您提供服务；（注：未开通 800 的地区或使用移动电话，请拨打技术支持电话 020-28047506）
6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修服务，您可以直接联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的华硕展示服务中心进行后续相应的检修服务。
7. 无论通过何种方式来寻求技术服务，请您务必要明确告知您使用的产品型号、BIOS 版本、搭配之硬件、详细的故障现象等，以利于华硕工程师能帮助您更加准确快速地判断出故障的原因。

用户填写数据

用户名称		购买日期	
联系人		联系电话	
联系地址			
经销商名称		产品种类	
产品型号		产品序列号	
	经销商印章		

请用剪刀沿虚线剪下

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License (“GPL”) and under the Lesser General Public License Version (“LGPL”). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable “work that uses the Library”) for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download;

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the locAMDon where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this informAMDon.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notificAMDon to the email address **gpl@asus.com**, stAMDng the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

目录内容

目录内容 vi
安全性须知 ix
电气方面的安全性 ix
操作方面的安全性 ix
REACH 信息 x
警语 x
射频（RF）设备须知 x
关于这本用户手册 xi
用户手册的编排方式 xi
提示符号 xii
跳线帽及图标说明 xii
哪里可以找到更多的产品信息 xii
MAXIMUS VI HERO 规格列表 xiv
产品包装 xviii
创建 PC 系统所需的其他工具与元件 xix

第一章：产品介绍

1.1 特殊功能 1-1
1.1.1 产品特写 1-1
1.1.2 玩家共和国（ROG）游戏功能 1-2
1.1.3 玩家共和国（ROG）独家功能 1-3
1.1.4 华硕独家功能 1-3
1.1.5 ROG 搭配软件 1-4
1.2 主板概述 1-5
1.2.1 主板安装前 1-5
1.2.2 主板结构图 1-6
1.2.3 中央处理器（CPU） 1-8
1.2.4 系统内存 1-9
1.2.5 扩展插槽 1-23
1.2.6 主板上的内置开关 1-25
1.2.7 跳线选择区 1-28
1.2.8 内置 LED 指示灯 1-29
1.2.9 内部接口 1-38

第二章：硬件设备信息

2.1 创建您的电脑系统 2-1
2.1.1 安装主板 2-1
2.1.2 安装中央处理器 2-3
2.1.3 处理器散热片与风扇安装 2-4
2.1.4 安装内存条 2-6
2.1.5 安装 ATX 电源 2-7
2.1.6 安装 SATA 设备 2-8

目录内容

2.1.7 安装前面板输出/输入接口 2-9
2.1.8 安装扩展卡 2-10
2.2 BIOS 更新应用程序 2-11
2.2.1 USB BIOS Flashback 2-11
2.3 主板后侧与音频接口 2-12
2.3.1 后面板接口 2-12
2.3.2 音频输出/输入连接图标说明 2-13
2.4 第一次启动电脑 2-17
2.5 关闭电源 2-17

第三章：BIOS 程序设置

3.1 认识 BIOS 程序 3-1
3.2 BIOS 程序设置 3-2
3.2.1 EZ Mode 3-3
3.2.2 Advanced Mode 3-4
3.3 My Favorites（我的最爱）菜单 3-6
3.4 Extreme Tweaker 菜单 3-7
3.5 主菜单（Main Menu） 3-23
3.6 高级菜单（Advanced menu） 3-25
3.6.1 处理器设置（CPU Configuration） 3-26
3.6.2 PCH 设置（PCH Configuration） 3-28
3.6.3 SATA 设备设置（SATA Configuration） 3-30
3.6.4 系统代理设置（System Agent Configuration） 3-31
3.6.5 USB 设备设置（USB Configuration） 3-33
3.6.6 平台各项设置（Platform Misc Configuration） 3-34
3.6.7 内置设备设置（OnBoard Devices Configuration） 3-35
3.6.8 高级电源管理设置（APM Configuration） 3-37
3.6.9 网络协议堆栈（Network Stack） 3-38
3.6.10 ROG Effects 3-38
3.7 监控菜单（Monitor menu） 3-39
3.8 启动菜单（Boot menu） 3-42
3.9 工具菜单（Tool menu） 3-47
3.9.1 ASUS EZ Flash 2 3-47
3.9.2 ROG Secure Erase（ROG 安全清除） 3-47
3.9.3 ASUS O.C. Profile 3-49
3.9.4 ASUS SPD Information 3-50
3.9.5 ROG OC Panel H-Key Configure 3-50
3.10 退出 BIOS 程序（Exit menu） 3-52
3.11 更新 BIOS 程序 3-53
3.11.1 EZ Update 3-53
3.11.2 华硕 EZ Flash 2 3-54
3.11.3 华硕 CrashFree BIOS 3 3-55

目录内容

3.11.4 华硕 BIOS Updater 3-56

第四章：软件支持

4.1 安装操作系统 4-1
4.2 驱动及应用程序 DVD 光盘信息 4-1
4.2.1 运行驱动及应用程序 DVD 光盘 4-1
4.2.2 取得软件用户手册 4-2
4.3 软件信息 4-3
4.4 华硕 AI Suite 3 程序 4-3
4.4.1 Dual Intelligent Processors 4 4-6
4.4.2 EZ Update 4-13
4.4.3 华硕 USB 3.0 Boost 程序 4-14
4.4.4 系统信息 4-15
4.4.5 USB BIOS Flashback 向导 4-17
4.4.6 USB Charger+ 4-18
4.4.7 音频设置程序 4-19
4.5 MemTweakIt 4-20
4.6 RAMDisk 4-22
4.7 Sonic Radar 4-25
4.7.1 快捷键和功能 4-26
4.7.2 Perfect Voice（完美声音） 4-27

第五章：RAID 支持

5.1 RAID 功能设置 5-1
5.1.1 RAID 定义 5-1
5.1.2 安装 Serial ATA（SATA）硬盘 5-2
5.1.3 在 BIOS 程序中设置 RAID 5-2
5.1.4 进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序 5-3
5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘 5-8
5.2.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘 5-8
5.2.2 在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘 5-8
5.2.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序 5-9

附录

华硕的连络信息 A-1

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要移除系统中的硬件设备时，请务必先连接该设备的信号线，然后再连接电源线。可能的话，在安装硬件设备之前先拔掉电脑的电源（PSU）电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的信号线之前，请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡之前，我们推荐您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源（PSU）的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值为何，那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源（PSU）已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前，请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽快联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形，请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。

请勿将本主板当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

REACH 信息

注意：谨遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm。

警语

经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或用户均不得擅自更改频率、加大功率或更改原设计之特性及功能。

低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。

前项合法通信，指依电信法规定操作之无线通信。

低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

射频（RF）设备须知

NCC: Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明
工作頻率 5.250 ～ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装本主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成：

- 第一章：产品介绍

  您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让您能很快地掌握本主板的各项特性，当然，在本章节中我们也会提及所有能够应用在本主板的新产品技术。

- 第二章：硬件设备信息

  本章节描述所有您在安装系统元件时必须完成的硬件安装程序。详细内容有：处理器与内存安装、跳线选择区设置以及主板的各种设备接口。

- 第三章：BIOS 程序设置

  本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的配置设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

- 第四章：软件支持

  您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱动程序及应用程序光盘中的软件相关信息。

- 第五章：RAID 支持

  本章节介绍 RAID 的各项设置。

- 附录

  在本附录里将列出相关的联络信息与认证信息。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置，请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。

警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。

小心：提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。

重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。

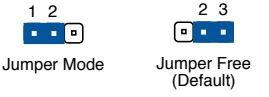
注意：提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套，里面有金属导线，可以套住选择区的任二只针脚（Pin）使其相连而成一通路（短路），本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置，兹利用以下图标说明。以下图为例，欲设置为「Jumper™ Mode」，需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽，本手册图标即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置，而空白的部份则代表空接针。以文字表示为：[1-2]。

因此，欲设置为「JumperFree™ Mode」，以右图表示即为在「第二及第三只针脚部份盖上跳线帽」，以文字表示即为：[2-3]。



Jumper Mode　　Jumper Free (Default)

哪里可以找到更多的产品信息

您可以经由下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 http://www.asus.com.cn 华硕电脑互联网取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能会夹带其他的文件，譬如经销商所附的产品保修单据等。

电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号连接口及线材	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示的环保使用期限，是指在一般正常使用状况下。

MAXIMUS VI HERO 规格列表

中央处理器	支持采用 LGA1150 规格插槽的第四代 Intel® Core™ i7 /Core™ i5/Core™ i3、Pentium/Celeron 处理器 支持 22nm 处理器 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 * 对 Intel® Turbo Boost 2.0 技术的支持依照处理器的类型而不同 ** 请访问 www.asus.com.cn 取得最新的 Intel 处理器支持列表
芯片组	Intel® Z87 Express 芯片组
内存	支持双通道内存结构 4 x 使用符合 non-ECC unbuffered DDR3 2800（超频）*/2666（超频）*/2600（超频）*/2500（超频）*/2400（超频）* /2200（超频）*/2133（超频）*/2000（超频）*/1866（超频）*/1800（超频）*/1600/1333 MHz 内存，最高可以扩展至 32GB 内存 支持 Intel® Extreme Memory Profile（XMP）技术 * 对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响 ** 请访问 www.asus.com.cn 或参考本用户手册取得内存合格供应商支持列表（QVL）
扩展槽	2 x PCI Express 3.0/2.0 x16 插槽（[红色]，单采 x16 或双采 x8/x8 模式） 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽（[黑色]，最大采 x4 模式）* 3 x PCI Express 2.0 x1 插槽** * PCIe 2.0 x16（PCIEX4_3）插槽与 PCIe 2.0 x1 共享带宽，默认为 x1 模式 ** 当 PCIe 2.0 x16（PCIEX4_3）插槽运行于 x4 速度以下时，PCIe 2.0 x16（PCIEX1_1/2/3）插槽将会关闭
VGA	集成式 Intel® HD 绘图处理器 支持 HDMI 输出，最高分辨率可达 4096x2160 @24Hz/2560x1600 @60Hz 支持 Intel® InTru™ 3D/Quick Sync Video/Clear Video HD 技术/Indiser™
多重图形显示控制器	支持 NVIDIA® SLI™ 和 AMD® CrossFireX™ 技术
存储介质连接槽	Intel® Z87 Express 芯片组： 6 x SATA 6.0 Gb/s 接口* - Intel Rapid Storage 12 支持 RAID 0、1、5 与 10 - 支持 Intel® Smart Response（智能回应）技术、Intel® Rapid Start 技术，以及 Intel® Smart Connect（智能连接）技术* ASMedia® SATA 6Gb/s 控制器： 2 x SATA 6Gb/s 接口** * 这些功能的运行取决于安装的处理器类型 ** 这些 SATA 接口只能连接数据磁盘，不支持 ATAPI 设备

（下页继续）

MAXIMUS VI HERO 规格列表

网络功能	1 x Intel® I217-V Gigabit 网络控制器
音频功能	Realtek® SupremeFX 音频，8 声道高保真音频编码器 - SupremeFX Shielding 技术 - ELNA® 高级音响电容 - 完整无失真 DVD 光盘音频、蓝光光盘音频与 HD 音频内容保护 - 支持音频接口检测、多音源独立输出（Multi-Streaming）技术与前面板音频插孔功能 - 后面板具备光纤 S/PDIF 数码输出接口 音频功能： - Sonic Rader - DTS Connect
USB	Intel® Z87 Express 芯片组： 6 x USB 3.0 接口（4 接口在主板后面板 [蓝色]；2 接口在主板中央 [红色]*） 8 x USB 2.0 接口（4 接口在主板后面板；4 接口在主板中央**） * 支持华硕 USB 3.0 Boost，UASP 标准在 Intel® 原生 USB 3.0 只支持 Windows® 8 操作系统 ** 2 个位于主板中央 USB 2.0 接口与 ROG extension（ROG_EXT）接口共享
后面板设备接口	1 x PS/2 键盘/鼠标复合接口 4 x USB 2.0 接口 1 x BIOS Flashback 按钮 1 x 光纤 S/PDIF 数码音频输出接口 1 x HDMI 接口 4 x USB 3.0 接口 [蓝色] 1 x RJ-45 网络接口 6 x 音频接口

（下页继续）

MAXIMUS VI HERO 规格列表

ROG 独家超频功能	Extreme Engine Digi+ III - 全数字 8+2 相式 CPU/内存电源 - NexFET™ Power Block MOSFET - 60A BlackWing Chokes - 10K 黑色金属固态电容 ROG GameFirst II ROG RAMDisk CPU Level Up UEFI BIOS 功能： - Extreme Tweaker - Tweaker’s Paradise - ROG SSD Secure Erase - BIOS Print - GPU. DIMM Post - O.C. Profile - ROG Pulse
其他特殊功能	华硕第四代智能双处理器 - 四向全方位优化调校按钮，合并 DIGI+ 电源控制、TPU、EPU 与 Fan Xpert 2 华硕独家功能 - AI Suite III - USB 3.0 Boost - USB Charger+ - AI Charger - Disk Unlocker 华硕 EZ DIY - USB BIOS Flashback - 华硕 CrashFree BIOS 3 应用程序 - 华硕 EZ Flash 2 程序 - 华硕 C.P.R.（CPU 参数自动恢复） 华硕 Q-Design - 华硕 Q-Code - 华硕 Q-Shield - 华硕 Q-Connector - 华硕 Q-LED（CPU、内存、显卡、启动设备指示灯） - 华硕 Q-Slot - 华硕 Q-DIMM

（下页继续）

MAXIMUS VI HERO 规格列表

内部 I/O 设备接口	1 x USB 3.0 接口（可扩展 2 个 USB 3.0 接口） 2 x USB 2.0 接口（可扩展 4 个 USB 2.0 接口，1 接口为通过 ROG_EXT 接口共享） 1 x ROG Extension（ROG_EXT）接口 8 x SATA 6.0Gb/s 插座 1 x 4-pin 处理器风扇插座，提供智能 DC/PWM 模式控制 1 x 4-pin 选用处理器风扇插座 3 x 4-pin 机箱风扇插座 1 x 24-pin EATX 电源插座 1 x 8-pin EATX 12V 电源插座 1 x Clear CMOS 跳线帽 1 x 电源按钮 1 x 重置按钮 1 x MemOK! 按钮 1 x DirectKey 按钮 1 x DRCT（DirectKey）插座 1 x S/PDIF OUT 插座 1 x 前面板音频插座（AAFP） 1 x 系统面板插座 1 x TPM 插座
BIOS 功能	64Mb UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 2.0、WfM 2.0、SM BIOS 2.5、ACPI 2.0a、多国语言 BIOS 程序
管理功能	WfM 2.0、DMI 2.0、网络唤醒功能（WOL by PME）、PXE
软件程序	驱动程序 ROG GameFirst II ROG RAMDisk ROG CPU-Z 程序 ROG Mem TweakIt Kaspersky® 防毒软件 DAEMON Tools Pro Standard 版 华硕 WebStorage 程序 华硕应用程序
机箱尺寸	ATX 型式：12 x 9.6 英寸（30.5 x 24.4 厘米）

规格若有任何更改，恕不另行通知。

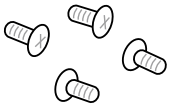
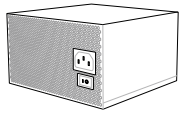
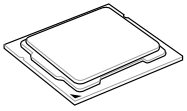
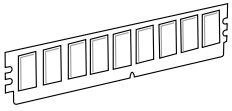
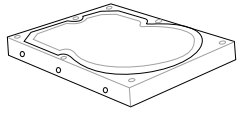
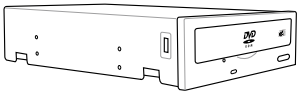
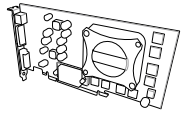
产品包装

请检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

主板	ROG MAXIMUS VI HERO 主板
排线	3 x 2 合 1 SATA 6Gb/s 排线 1 x SLI® 桥接器
配件	I/O 挡板 1 x 12 合 1 ROG 排线贴纸 1 x 2 合 1 Q-Connect 套件 1 x ROG 门挂钩
应用程序光盘	ROG 主板驱动及应用程序 DVD 光盘
相关文件	用户手册

若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽快与您的经销商联络。

创建 PC 系统所需的其他工具与元件

	
一袋螺丝	Philips（十字）螺丝起子
	
PC 机箱	电源供应设备
	
Intel LGA 1150 处理器	Intel LGA 1150 兼容处理器风扇
	
内存条	SATA 硬盘
	
SATA 光驱（选购）	显卡（选购）

上表所列的工具与元件并不包含在主板包装盒内。

1.1 特殊功能

1.1.1 产品特写

玩家共和国（Republic of Gamers）

玩家共和国只提供最优质的产品。我们提供最佳的硬件设计、最高速的性能与最创新的设计，欢迎对硬件规格有高度要求的玩家一同加入！

在玩家共和国的国度中，仁慈怜悯是弱者的行为，勇于挺身而出才是唯一王道。我们敢说我们擅长竞争，如果您的个性符合我们的特性，请加入我们的菁英俱乐部，在玩家共和国中让大家感受您的存在。

支持 LGA1150 规格的第四代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3、Pentium®/Celeron® 处理器

本主板支持最新 LGA1150 封装的第四代 Intel® Core™ i7/i5/i3、Pentium®/Celeron® 处理器，并通过 GPU、双通道 DDR3 内存插槽与 PCI Express 2.0/3.0 扩展插槽，能提供最佳的绘图显示与系统运算性能。。

采用 Intel® Z87 Express 芯片组

Intel® Z87 Express 芯片组采用最新的单芯片设计，是专为支持最新的 LGA1150 插槽的第四代 Intel® Core™ i7/i5/i3、Pentium®/Celeron® 处理器所设计，通过连续的点对点链接增加带宽与稳定性，并增强系统性能。原生支持高达六组 USB 3.0 接口，传输率较 USB 2.0 快达十倍。此外，Intel® Z87 Express 芯片组并支持 iGPU 功能，让用户享受最新的 Intel 集成绘图性能。

PCI Express® 3.0

最新的 PCI Express 3.0（PCIe 3.0）总线标准提供比当前 PCIe 2.0 快二倍的性能，x16 的总带宽可达 32GB/s，双倍于 PCIe 2.0（x16 模式）的 16GB/s。PCIe 3.0 提供用户前所未有的数据传输速度，提供与 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 设备完全向下兼容的便利与无缝传输。这是 PC 用户想要增进与最佳化图像性能必备的功能，也是必备的最新、最有前瞻性的功能。

支持 SLI®/CrossFireX™ On-Demand 技术

本主板可以让您有多种 GPU 选择，通过 SLI/CrossFireX On-Demand 技术，支持 Quad-GPU SLI 或 Quad-GPU CrossFireX 设置。搭配 Intel Z87 平台多 GPU，可将 PCIe 做最佳化的分配。无论您采用何种方式，都可以让图形显示达到前所未有、令人瞠目结舌的境界。

1.1.2 玩家共和国（ROG）游戏功能

SupremeFX

ROG 独家提供的 SupremeFX 音频已使用最新和独特的电路设计，提供 8 声道高保真音频，以提供相等的功率、清晰度和范围内专用的声卡。

我们通过许多遮蔽的方式而实现了几近无损的音频质量。首先 Red Line Shieled（红线挡板）从板上其余部分隔离音频硬件，以防止跨组件的干扰。随着增加至一个特殊的金属罩在 SupremeFX 芯片上来转移 EMI。也让 主板展现 ROG 风格纯净的声音，以及极具吸引力的外观。

搭载日本高优质 ELNA 电容，以确保所有游戏和多介质拥有的清晰度和高保真温暖自然的音频。让主板内置音频有革命性的表现，达到真正发烧级的性能。当您在进行游戏、电影、音乐，甚至在线聊天，都能体验优越的音频表现，并能明快地决定。

Sonic Rader

打破在线实战遊戏的传统模式，ROG 独家开发的Sonic Radar 可以重复堆栈在遊戏画面上，帮助您实时得知对手和队友所在的具体位置。屏幕上的雷达可精确显示枪声、脚步声等来源，以提供更好的情报，不给对手任何攻击偷袭的机会。

GameFirst II

提供功能强大，易于使用的网络控制，ROG GameFirst 使用了 cFos Traffic Shaping 技术，提供 ROG 玩家更直觉的用户界面。同时拥有独家的 EZ Mode 为初学者设置和 Advanced Mode 以提供专业玩家设置。这也意味着无论您的计算机同时执行了多种程序，GameFirst II 有效的网络优化优先设置，让您的网络游戏对战可以总是畅行无阻。

Intel Gigabit 网络

众所皆知的从 Intel 所提供的网络解决方案，久负盛名提供有更好的处理能力、使用较低的 CPU 资源以及更好的稳定性。本主板内置 Intel Gigabit 网络解决方案，让用户能获得前所未有的网络体验。

1.1.3 玩家共和国（ROG）独家功能

Extreme Engine Digi+ III

领先业界独家工程设计和完全数码化的 CPU/内存电压控制，以真实手动微调的准确性水准，在 Intel Z87 系列的主板中，只有 ROG 提供全手动电压调整，以达主板完美的超频。

搭配了 NexFET Power Block MOSFETs，结合强大的耐用性与在正常使用下提供高达 90% 效率。BlackWing Choke 能轻易地处理高压，额定功率高达 60A，或双通用电阻器！采用一组特殊的鳍片设计，可以让在低于 3-5C 电阻器增加稳定性，使用 gold-treated（镀金处理）涂层导电性和高效率成倍数增加，而只只损失极少的电力输送。

高优质的 10K 黑色金属固态电容，为应付达到超频和最极端环境需求所打造。而 Black Metallic 黑金电容较一般电容长达五倍使用寿命且具有更好的低温耐用性，最心 Intel® Core 系列处理器具备容许较大的超频能力，让独家的 ROG 工程师进一步允许处理器进行超频使用，达到完美的主板超频性能。

RAMDisk

RAMDisk 可以使用部分系统内存将它变成一个高速的实体存储，提供您在此存储缓存文件与游戏程序而能达到立即读取。此外，延长 SSD 的生命周期，并保持您的主要存储最佳化，则是相当重要的任务，并且可以获得自动备份与恢复文件。

CPU Level Up 功能

您曾希望自己可以拥有一个更贵的 CPU 吗？现在毋需额外花钱，只要使用玩家共和国的 CPU Level Up 功能就能升级您的 CPU 喔！只要选择您欲超频的处理器，剩下的就交给主板代劳。您只要看看新 CPU 的速度并立即享受它所带来的优异性能就对了！超频真是再简单也不过了。

1.1.4 华硕独家功能

AI Suite III

通过友善的用户界面，华硕 AI Suite III 将所有的华硕独家功能集成在一个软件套件中，可以用来监督超频、电源管理、风扇速度控制、电压与感应器读数，甚至可以通过蓝牙与移动设备互动。这个集所有功能于一身的软件提供多样化与容易使用的功能，并且不需要在不同的应用程序间来回切换。

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供有史以来最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频，不需要进入 BIOS 或操作系统，只要插入 USB 存储设备然后按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟，BIOS 程序就会自动在待机状态下更新，从此以后超频无须再烦恼，并拥有无与伦比的便利性。

1.1.5 ROG 搭配软件

Kaspersky® 防毒软件

Kaspersky® 个人防毒软件提供个人玩家与家庭办公用户优秀的病毒防护。此软件是基于高级的防毒技术，程序包含 Kaspersky® 防毒程序引擎，随时随地针对常见的恶意程序进行检测与提供高性能的防护。

DAEMON Tools Pro 标准版程序

DAEMON Tools Pro 为提供 CD、DVD 与蓝光光盘备份使用的程序，可以将光学介质转成虚拟光盘与模拟设备来以虚拟复制方式运行。DAEMON Tools Pro 工具程序可以组合数据、音乐、图像与相片在电脑、笔记本电脑或 netbook 上面。

ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 为 CPUID 针对 ROG 所量身订做的版本。具备与原来版本相同的功能与可信度，并拥有独特的设计。使用全新外观的 ROG CPU-Z 来确实地回报 CPU 相关信息与展现您的独特性。

Mem TweakIt

Mem TweakIt 是一个内存效率调整工具，提供您实时微调内存，并允许您在 ROG 官方网页上发表和分享您的内存设置参数。

DTS Connect

DTS Connect 包含 DTS Interactive 与 DTS Neo:PC™ 技术，DTS Neo:PC™ 可以将各种立体声信号，如：CD、MP3、WMA、网络收音机等转换成 7.1 声道，彻底发挥多声道音箱的威力，随时享受环绕音频。用户可以将电脑与家庭剧院连接，DTS Interactive 会将原本的音频重新编码成为 DTS 音频信号，通过数码音频接口如 S/PDIF 或 HDMI，从电脑传送至任何能兼容 DTS 的系统，提供您最佳的环绕音频。

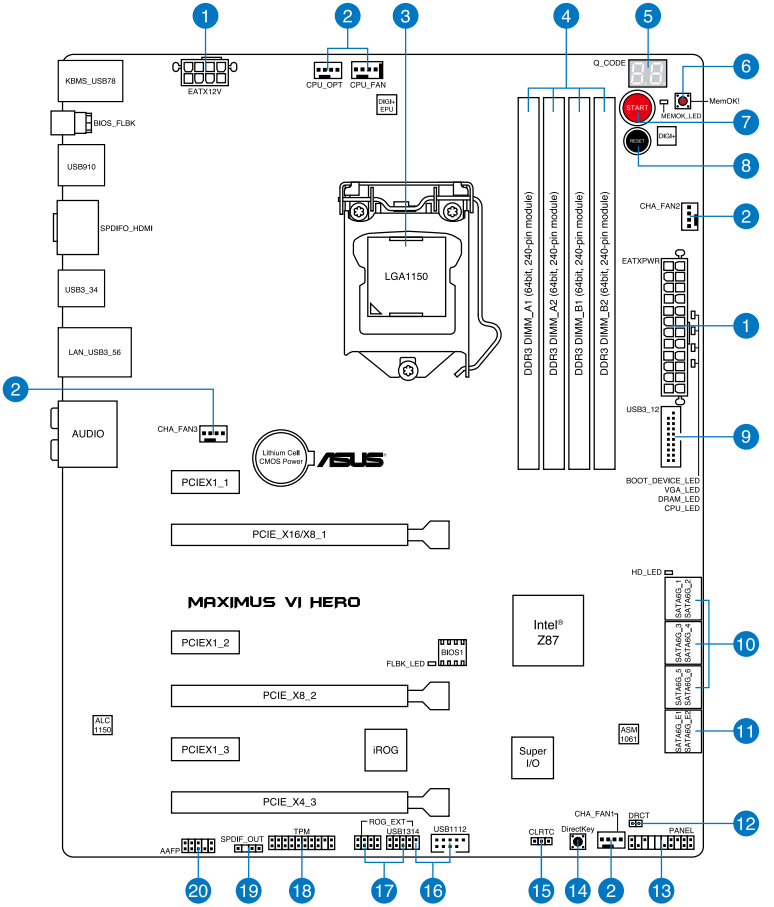
1.2 主板概述

1.2.1 主板安装前

主板以及扩展卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏，因此，在您动手更改主板上的任何设置之前，请务必先作好以下所列出的各项预防措施。

- 在处理主板上的内部功能设置时，您可以先拔掉电脑的电源线。
- 为避免生成静电，在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外，您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您删除任何一个集成电路元件后，请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电，或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或删除任何元件之前，请确认 ATX 电源的电源开关是切换到关闭（OFF）的位置，而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源线，等到安装/删除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

1.2.2 主板结构图



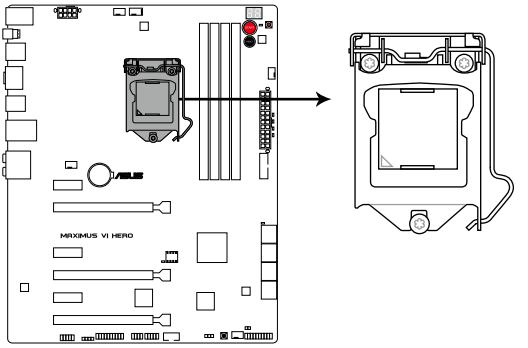
关于面板连接插座与内部连接插座的相关信息，请参考 1.2.9 内部接口与 2.3.1 後面板接口 一节中的说明。

主板元件说明

连接插槽/跳线选择区/开关与按钮/插槽		页数
1.	ATX power connectors (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V)	1-43
2.	CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-3)	1-42
3.	LGA1150 CPU Socket	1-8
4.	DDR3 DIMM slots	1-9
5.	Q_Code LEDs	1-31
6.	MemOK! button	1-26
7.	START (Power-on) button	1-25
8.	RESET button	1-25
9.	USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)	1-39
10.	Intel® Z87 Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [red])	1-38
11.	ASMedia® Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E12/ E34 [red])	1-39
12.	DirectKey connector (2-pin DRCT)	1-45
13.	System panel connector (20-8 pin PANEL)	1-44
14.	DirectKey button	1-27
15.	Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)	1-28
16.	USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112; USB1314)	1-41
17.	ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)	1-46
18.	TPM connector (20-1 pin TPM)	1-46
19.	Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)	1-40
20.	Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)	1-40

1.2.3 中央处理器（CPU）

本主板具备一个 LGA1150 处理器插槽，本插槽是专为第四代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3、Pentium®/Celeron® 处理器所设计。



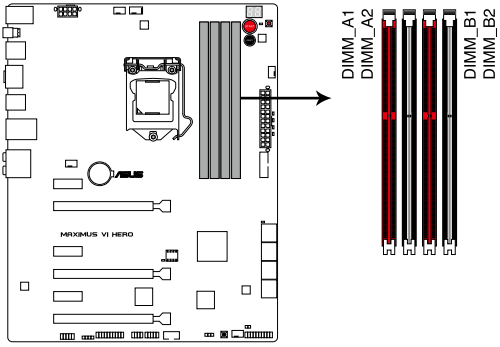
MAXIMUS VI HERO CPU LGA1150

- 当您安装 CPU 时，请确认所有的电源接口都已拔除。
- 本插槽只支持 LGA1150 处理器，请确认并安装正确的处理器，请勿将 LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1150 插槽。
- 在您购买本主板之后，请确认在 LGA1150 插座上附有一个即插即用的保护盖，并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经毁损或是没有保护盖，或者是插座接点已经弯曲，请立即与您的经销商联络。
- 在安装完主板后，请将即插即用的保护盖保留下来。只有 LGA1150 插槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization（RMA）的要求，华硕电脑才能为您处理产品的维修与保修。
- 本保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确的移除即插即用保护盖所造成的毁损。

1.2.4 系统内存

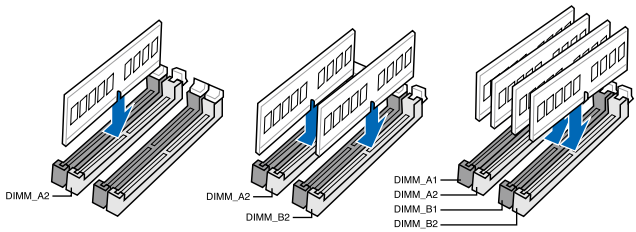
本主板配置有四组 DDR3（Double Data Rate 3）内存条插槽。

DDR3 内存条拥有与 DDR2 或 DDR 内存条相同的外观，但是 DDR3 内存插槽的缺口与 DDR2 或 DDR 内存插槽不同，以防止插入错误的内存条。



MAXIMUS VI HERO 240-pin DDR3 DIMM sockets

内存推荐设置



内存设置

您可以任意选择使用 1GB、2GB、4GB 与 8GB 的 unbuffered non-ECC DDR3 内存条至本主板的内存插槽上。

- 当内存条频率高于 2133MHz，并且相应时序或载入的 XMP 文件不是 JEDEC 标准时，内存条的稳定性与兼容性会依照处理器性能与其他已安装设备而有不同。
- 您可以在 Channel A 与 Channel B 安装不同容量的内存条，在双通道设置中，系统会检测较低容量通道的内存容量。任何在较高容量通道的其他内存容量，会被检测为单通道模式运行。
- 根据 Intel 处理器规格，推荐内存电压低于 1.65V 以保护处理器。
- 在本主板请使用相同 CL（CAS-Latency 行地址控制器延迟时间）内存条。为求最佳兼容性，推荐您使用同一厂商所生产的相同容量型号之内存。
- 由于 32-bit Windows 操作系统内存地址空间的限制，当您安装 4GB 或更多的内存条时，系统实际可用的总内存只有 3GB 或更少。为充分利用内存，您可以运行以下任一动作：
  - 若您使用 32-bit Windows 操作系统，推荐系统内存最高安装 3GB 即可。
  - 当主板安装 4GB 或更多的内存时，推荐您安装 64-bit Windows 操作系统。
  - 若需要更详细的数据，请访问 Microsoft 网站 http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-cn。
- 本主板不支持 512 Mb（64MB）芯片的内存条（内存容量以 Megabit 计算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB）。

- 默认的内存运行频率是根据其 SPD（Serial Presence Detect）。在默认状态下，某些内存在超频时的运行频率可能会较供应商所标示的数值为低。若要让内存条以供应商的数值或更高的频率运行，请参考 3.4 Extreme Tweaker 菜单 一节中，手动调整内存频率的说明。
- 在全负载（4 DIMM）或超频设置下，内存条可能需要更佳的冷却系统以维持运行的稳定。

MAXIMUS VI HERO 主板合格供应商列表（QVL）

DDR3 2800MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
AVEXIR	AVD3U28001204G-4CI	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C11	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2800C12	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65V	•	•
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXD	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	•	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXD	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	•	•
G.SKILL	F3-2800C11D-8GTXDG	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•
G.SKILL	F3-2800C11Q-16GTXDG	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	•	•
G.SKILL	F3-2800C12Q-32GTXG	32GB (4 x 8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	1.65V	•	•
G.SKILL	F3-2800C10D-8GBTXD	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	10-13-13-35	1.65V	•	•

DDR3 2666MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
Apacer	78.BAGFF.AFC0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•	•
Apacer	78.BAGFR.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•	•
Apacer	78.CAGFF.AFD0C(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•	•
G.SKILL	F3-2666C11Q-32GTXD(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
G.SKILL	F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	
GEIL	GOC332GB2666C11QC(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-32	1.65	•	•
Team	TXD34G2666HC11CBK(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•
Team	TXD38G2666HC11CBK(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	

DDR3 2600MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
A-DATA	AX3U2600GW8G11(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•

DDR3 2500MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
G.SKILL	F3-20000CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-11-11-31	1.65	•	•

DDR3 2400MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
A-DATA	AX3U2400GC4G10(XMP)	4GB	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•
A-DATA	AX3U2400GW8G11(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•
Apacer	78.BAGFL.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-12-12-30	-	•	•
Apacer	783BAGF3.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	-	•	•
CORSAIR	CMGTX8(XMP)	8GB (4x 2GB)	SS	-	-	10-12-10-30	1.65	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4A2400C9R (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	2400 9-11-11-31	1.65	•	•
G.SKILL	F3-19200CL10Q-32GBZHD(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•
G.SKILL	F3-19200CL11Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•	•
G.SKILL	F3-19200CL11Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•	•
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)	4G (2x 2G)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	
G.SKILL	F3-19200CL9Q-16GBZMD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•	•
GEIL	GET34GB2400C9DC (XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	
GEIL	GOC316GB2400C10QC (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
GEIL	GOC316GB2400C11QC (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•	•
Kingston	KHX2400C11D3K4/ 8GX(XMP)	8GB (4x 2GB)	SS	-	-	11-13-11-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX24C11K4/16X(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX24C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
KINGSTON	KHX24C11T3K4/32X(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
Patriot	PVV34G2400C9K(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.66	•	
Patriot	PXD38G2400C11K(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•	•
Patriot	PXD38G2400C11K(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	2400 11-11-11-30	1.65	•	•
Team	TXD38G2400HC10QBK (XMP)	8GB	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•

DDR3 2200MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
G.SKILL	F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP)	4G (2x 2G)	DS	-	-	7-10-10-28	1.65	•	
GEIL	GET34GB2200C9DC(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.65	•	•
GEIL	GET38GB2200C9ADC(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•

DDR3 2133MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
A-DATA	AX3U2133XC4G10(XMP)	4GB	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
A-DATA	AX3U2133XW8G10(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
A-DATA	AX3U2133XW8G10(XMP)	8GB	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	•
Apacer	AHU04GFB33CAQ3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-13-13-31	-	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-11-10-27	1.5	•	
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9(Ver 7.1)(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMT4GX3M2B2133C9(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL11Q2-64GBZLD(XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBXLD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•	•
G.SKILL	F3-17066CL9D-8GBPID(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
G.SKILL	F3-17066CL9Q-16GBTDD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
G.SKILL	F3-2133C11Q-32GZL(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.5	•	•
KINGSTON	KHX2133C11D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-12-11-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX21C11T3FK8/64X(XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
OCZ	OCZ3XTEP2133C9LV4GK	2GB	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	•	
Patriot	PV316G213C1K(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	•	•
Patriot	PVV34G2133C9K(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.66	•	•
Patriot	PXD38G2133C11K(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
Patriot	PXD38G2133C11K(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	2133 11-11-11-27	1.5	•	•
Team	TLD38G2133HC11ABK (XMP)	8GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•	•
Team	TXD34096M2133HC11A-V(XMP)	4GB	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•	•

DDR3 2000MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
AEXEA	AXA3ES2G2000LG28V (XMP)	2GB	DS	-	-	-	1.65	•	•
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V (XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
Apacer	78.AAGD5.9KD (XMP)	6GB (3x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-27	-	•	•
Asint	SLA302G08-ML2HB (XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRH9C	9-9-9-27	-	•	•
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBRH (XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
G.SKILL	F3-16000CL9D-4GBTD (XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
GEIL	GUP34GB2000C9DC (XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	•
Patriot	PV736G2000ELK (XMP)	6GB (3x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.65	•	•
Patriot	PVT36G2000LLK (XMP)	6GB (3x 2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
Patriot	PX7312G2000ELK (XMP)	12GB (3x 4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	•
Silicon Power	SP002GBLYU200S02 (XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	•	•
Team	TXD32048M2000C9 (XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD32048M2000C9-L (XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288LT-20	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD32048M2000C9-L (XMP)	2GB	DS	Team	T3D1288RT-20	9-9-9-24	1.6	•	•

DDR3 1866MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
A-DATA	AX3U1866XW8G10(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1866 9-9-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9(Ver3 .23)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1866C9R (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1866C9R(Ver 8.16)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10(Ver 3.23)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	•	•
Crucial	BLE4G3D1869DE1XT0.16F MD(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL10Q2-64GBZLD(XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-8GBFLD(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	•	•
G.SKILL	F3-1866C9Q-32GXM(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
KINGSTON	KHX1866C9D3K2/8GX(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
Patriot	PXD34G1866ELK(XMP)	4GB (2x 2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
Patriot	PXD38G1866ELK(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	•
Patriot	PXD38G1866ELK(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	•
Patriot	PXD38G1866ELK(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	•	•
Team	TED34G1866HC13BK	4GB	SS	-	-	-	-	•	•
Team	TED38G1866HC-13BK	8GB	DS	-	-	-	-	•	•
Team	TLD34G1866HC9KBK(XMP)	4GB	DS	-	-	9-11-9-27	1.5	•	•
Team	TLD38G1866HC10SBK(XMP)	8GB	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•

DDR3 1800MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
G.SKILL	F3-14400CL9D-4GBRL(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•

DDR3 1600MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
A-DATA	AD3U1600C2G11	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	11-11-11-28	-	•	•
A-DATA	AD3U1600C4G11	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	11-11-11-28	-	•	•
A-DATA	AD3U1600W4G11	4GB	SS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•	•
A-DATA	AD3U1600W8G11	8GB	DS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•	•
A-DATA	AX3U1600GW8G9 (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
A-DATA	AX3U1600W8G11	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.5	•	•
A-DATA	AXDU1600GW8G9B (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-11-9-27	1.65	•	•
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•	•
AMD	AE34G1609U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•	•
AMD	AP38G1608U2K (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	•
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK	-	1.65	•	•
Apacer	78.B1GET.9K00C	4GB	SS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-28	-	•	•
Apacer	78.C1GET.9K10C	8GB	DS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-31	-	•	•
Apacer	AHU04GFA60C9Q3R (XMP)	4GB	DS	-	-	11-11-11-28	-	•	•
Apacer	AHU08GFA60CBT3R (XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	•
Asint	SLA302G08-EGG1C (XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GG1C	9-9-9-27	-	•	•
Asint	SLA302G08-EGJ1C (XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GJ1C	9-9-9-27	-	•	•
Asint	SLA302G08-EGN1C	4GB	DS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•
Asint	SLA304G08-ENG1B	4GB	SS	Asint	304G08-GN1B	9-11-11-28	-	•	•
Asint	SLB304G08-EGJ1B (XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-27	-	•	•
Asint	SLB304G08-EGN1B	8GB	DS	ASint	304G08-GN1B	-	-	•	•
Asint	SLZ302G08-EGN1C	2GB	SS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•
Asint	SLZ3128M8-EGJ1D(XMP)	2GB	DS	Asint	3128M8-GJ1D	-	-	•	•
ATP	AQ12M64B8BKK0S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G08460	-	NO	•	•

DDR3 1600MHZ（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
CORSAIR	CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-8-8-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMG4GX3M2A1600C6	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-6-6-18	1.65	•	•
CORSAIR	CML16GX3M4X1600C8 (Ver 2.12)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	Heat-Sink Package	1.5	•	•
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8 (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMP6GX3M3A1600C8 (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMX6GX3M3C1600C7 (XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	7-8-7-20	1.65	•	•
CORSAIR	CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19)(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4A1600C9 (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8 (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M4X1600C9 (Ver 2.12)(XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	HX3X12G1600C9 (XMP)	12GB (6x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.6	•	•
Crucial	BL12864BN1608.8FF (XMP)	2GB (2x1GB)	SS	-	-	8-8-8-24	1.65	•	•
Crucial	BLT4G3D1608DT1TX 0.16FM (XMP)	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	•
EK Memory	EKM324L28BP8-I16 (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	•	•
EK Memory	EKM324L28BP8-I16 (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	•	•
Elixir	M2X2G64CB88G7N-DG (XMP)	2GB	SS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•	•
Elixir	M2X4G64CB8HG5N-DG (XMP)	4GB	DS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•	•
Elixir	M2X8G64CB8HB5N-DG (XMP)	8GB	DS	Elixir	N2CB4G80BN-DG	9-9-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-12800CL7D-8GBRH (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	•	•
G.SKILL	F3-12800CL7Q-16GBXH (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	7-8-7-24	1.6	•	•
G.SKILL	F3-12800CL8D-8GBECO (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.35	•	

DDR3 1600MHZ（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBRL (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9D-8GBSR2 (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.25	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9Q-16GBXL (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.Skill	F3-12800CL9Q-16GBZL (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-1600C9Q-32GXM (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
GEIL	GET316GB1600C9QC (XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.6	•	•
GEIL	GUP34GB1600C7DC (XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	•	•
GoodRam	GR1600D364L9/2G	2GB	DS	GoodRam	GF1008KC-JN	-	-	•	•
KINGMAX	FLGE85F-C8KL9A (XMP)	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•
KINGMAX	FLGF65F-C8KL9A (XMP)	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•
KINGSTON	KHX16009CD3K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3B1/4G (XMP)	4GB	SS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX (XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K6/24GX(XMP)	24GB (6x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K8/32GX(XMP)	32GB (8x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3LK2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3P1K2/8G	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C10B1K2/16X(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C9K2/16	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1333-9-9-9-24	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C9P1K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
KINGSTON	KVR16N11/4	4G	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRPBC	-	1.5	•	•
KINGTIGER	KTG2G1600PG3 (XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	•	•
MICRON	MT16JTF1G64AZ-1G6D1	8GB	DS	MICRON	D9PBC	-	1.5	•	•

DDR3 1600MHZ（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
Micron	MT16JTF1G64AZ-1G6E1	8GB	DS	Micron	D9QBJ	-	-	•	•
MICRON	MT16KTF51264AZ-1G6M1	4GB	DS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
Micron	MT8JTF51264AZ-1G6E1	4GB	SS	Micron	D9QBJ	-	-	•	•
MICRON	MT8KTF25664AZ-1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
Mushkin	996805(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65	•	•
Mushkin	998805(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	6-8-6-24	1.65	•	•
OCZ	OCZ3BE1600C8LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8	1.65	•	
Patriot	PGD316G1600ELK (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
Patriot	PGD316G1600ELK (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
Patriot	PGD38G1600ELK (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
Patriot	PGD38G1600ELK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
Patriot	PGS34G1600LLKA	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.7	•	•
Patriot	PGS34G1600LLKA2	4GB (2x2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.7	•	•
Patriot	PV38G160C9KRD (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Patriot	PVV38G1600LLK (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	•	•
Patriot	PX7312G1600LLK (XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	8-9-8-24	1.65	•	•
Patriot	PXD38G1600LLK (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1600 8-9-8-24	1.65	•	•
PSC	AL9F8L93B-GN2E	4GB	SS	PSC	A3P4GF3BLF	-	-	•	•
PSC	ALAF8L93B-GN2E	8GB	DS	PSC	A3P4GF3BLF	-	-	•	•
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRPBC	-	1.5	•	•
SanMax	SMD-4G68NG-16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	-	•	•
Silicon Power	SP002GBLTU160V02 (XMP)	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11-11-28	1.5	•	•
Silicon Power	SP004GBLTU160V02 (XMP)	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD34096M1600HC9-D (XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TC2G83BFRH9A	9-9-9-24	1.5	•	•
Transcend	JM1600KLH-8G (626633)	8GB	DS	Transcend	TK963EBF3	-	-	•	•
Transcend	TS1GLK64V6H (620945)	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	-	-	•	•
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11-28-1	-	•	•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11-28-2	-	•	•

DDR3 1333MHZ

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
ACTICA	ACT1GHU64B8F1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F	-	-	•	•
ACTICA	ACT1GHU72C8G1333S	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	•	•
ACTICA	ACT2GHU64B8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT	-	-	•	•
ACTICA	ACT2GHU72D8G1333M	2GB	DS	Micron	D9KPT(ECC)	-	-	•	•
ACTICA	ACT2GHU72D8G1333S	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846F(ECC)	-	-	•	•
ACTICA	ACT4GHU64B8H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR	-	-	•	•
ACTICA	ACT4GHU72D8H1333H	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFR(ECC)	-	-	•	•
AMD	AE32G1339U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5	•	•
AMD	AE34G1339U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5	•	•
Apacer	78.A1GC6.9L1	2GB	DS	Apacer	AM5D5808FEQSBG	9	-	•	•
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908CEHSBG	9	-	•	•
Asint	SLA302G08-EDJ1C	2GB	SS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	•	•
Asint	SLA304G08-EDJ1B	4GB	SS	Asint	304G08-DJ1B	9-10-10-26	-	•	•
Asint	SLB304G08-EDJ1B	8GB	DS	Asint	304G08-DJ1B	9-9-9-24	-	•	•
Asint	SLZ302G08-EDJ1C	4GB	DS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	•	•
ATP	AQ12M72E8BKH9S	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C(ECC)	-	-	•	•
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F	-	-	•	•
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F		-	•	•
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M8BN-CG		-	•	•
CORSAIR	CMV4GX3M2A1333C9	4GB (2x2GB)	SS	-	N/A	9-9-9-24	-	•	•
CORSAIR	CMV8GX3M2A1333C9	8GB (2x4GB)	DS	-	N/A	9-9-9-24	-	•	•
CORSAIR	CMX8GX3M1A1333C9 (Ver2.2)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMX8GX3M1A1333C9 (Ver3.23)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMX8GX3M2A1333C9 (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
EK Memory	EKM324L28BP8-I13	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9	-	•	•
G.SKILL	F3-10600CL9D-4GBNT	4GB (2x2GB)	DS	G.SKILL	D3 128M8CE9 2GB	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBRL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
GEIL	GET316GB1333C9QC	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•

DDR3 1333MHZ（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA115FW	9-9-9-24	1.3	•	•
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA15B	9-9-9-24	1.3	•	•
GEIL	GVP34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
GEIL	GVP38GB1333C7QC	8GB (4x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.5	•	•
GEIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
GoodRam	GR1333D364L9/2G	2GB	DS	Qimonda	IDSH1G-03A1F1C-13H	-	-	•	•
Hynix	HMT125U6TFR8A-H9	2GB	DS	Hynix	H5TC1G83TFR	-	-	•	•
INNODISK	M3UN-2GHJBC09	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83CFRH9C	9-9-9-24	-	•	•
INNODISK	M3UN-4GHJAC09	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRH9C	9-9-9-24	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-B8KL9	2GB	DS	KINGMAX	KFB8FNLXL-BNF-15A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLBF-GXX-12A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KM9	2GB	SS	Kingmax	KFC8FNMXF-BXX-15A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF-DXX-15A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KM9	4GB	DS	Kingmax	KFC8FNMXF-BXX-15A	-	-	•	•
KINGSTON	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE-DJ-F	9	1.5	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9H/4G	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	1.5	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9H/8G	8GB	DS	ELPIDA	J4208EASE-DJ-F	9-9-9-24	1.5	•	•
KINGSTON	KVR13N9S8H/4	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG-GN-F	-	1.5	•	•
KINGTIGER	F10DA2T1680	2GB	DS	KINGTIGER	KTG1333PS1208NST-C9	-	-	•	•
KINGTIGER	KTG2G1333PG3	2GB	DS	-	-	-	-	•	•
Mach Xtreme	MXD3U133316GQ	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	-	•	•
Mach Xtreme	MXD3V13332GS	2GB	SS	Mach Xtreme	C2S46D30-D313	-	-	•	•
MICRON	MT8JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
OCZ	OCZ3G1333LV4GK	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
OCZ	OCZ3G1333LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
OCZ	OCZ3G1333LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
OCZ	OCZ3RPR1333C9LV8GK	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9	1.65	•	
Patriot	PG38G1333EL(XMP)	8GB	DS	-	-	-	1.5	•	•

DDR3 1333MHZ（续上页表格）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽（选购）	
								2	4
Patriot	PGD316G1333ELK (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Patriot	PSD32G13332	2GB	DS	Prtriot	PM128M8D3BU-15	9	-	•	•
RiDATA	C304627CB1AG22Fe	2GB	DS	RiDATA	C304627CB1AG22Fe	9	-	•	•
RiDATA	E304459CB1AG32Cf	4GB	DS	RiDATA	E304459CB1AG32Cf	9	-	•	•
SAMSUNG	M378B5273CH0-CH9	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846C	-	-	•	•
Silicon Power	SP001GBLTE133S01	1GB	SS	NANYA	NT5CB128M8AN-CG	-	-	•	•
Silicon Power	SP001GBLTU133S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	•	•
Silicon Power	SP002GBLTU133V02	2GB	SS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•	•
Silicon Power	SP004GBLTU133V02	4GB	DS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•	•
Team	TED34096M1333HC9	4GB	DS	Team	T3D2568LT-13	-	-	•	•
Transcend	JM1333KLH-8G(623654)	8GB	DS	Transcend	TK963EBF3	-	-	•	•
Transcend	TS1GLK64V3H(620053)	8GB	DS	MICRON	D9QBJ	-	-	•	•

SS - 单面内存　DS - 双面内存

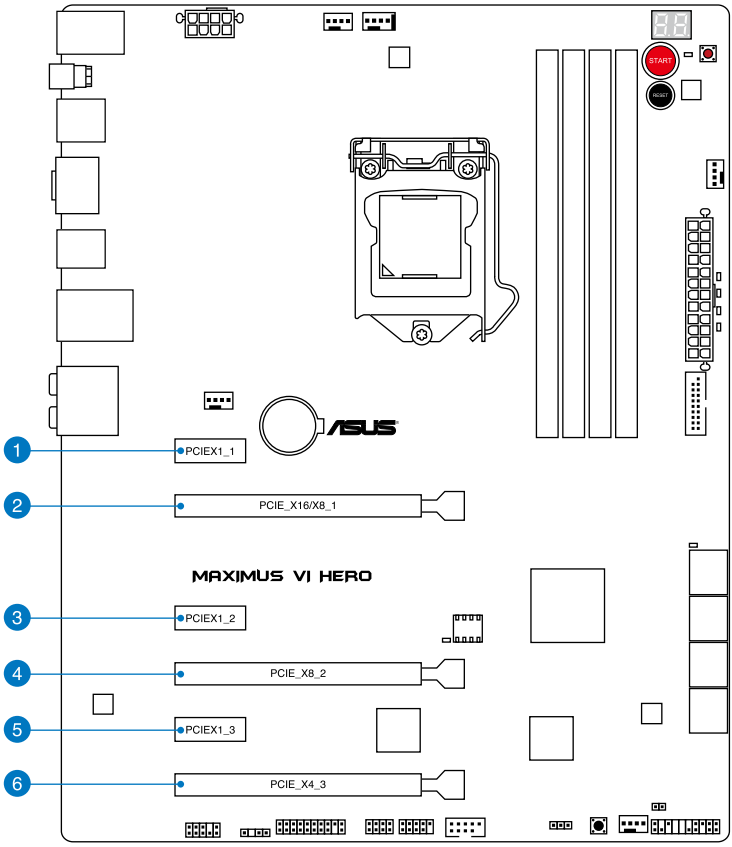
内存插槽支持：

- 支持 1 个模块 - 在单通道内存设置中，支持安装一组内存条在任一插槽，推荐您安装在 A1 插槽。
- 支持 2 个模块 - 支持安装二组内存条在红色或黑色插槽，作为一对双通道设置，推荐您安装在 A1 与 B1 插槽以获得更佳的兼容性。
- 支持 4 个模块 - 支持安装四组内存条在红色和黑色插槽，作为二对双通道设置。

- 华硕独家提供支持高速内存功能。
- 对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响。载入 BIOS 程序中的 X.M.P. 设置来支持高速内存。
- 请访问华硕网站（www.asus.com.cn）以查询最新内存供应商列表（QVL）。

1.2.5 扩展插槽

安装或移除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。



插槽编号	插槽说明
1	PCIe 2.0 x1_1 插槽
2	PCIe 3.0/2.0 x16/x8_1 插槽
3	PCIe 2.0 x1_2 插槽
4	PCIe 3.0/2.0 x16/x8_2 插槽
5	PCIe 2.0 x1_3 插槽
6	PCIe 2.0 x4_3 插槽

VGA 设置	PCIe 运行模式	
	PCIE_x16/x8_1	PCIE_x8_2
单 VGA/PCIe 卡	x16	N/A
双 VGA/PCIe 卡	x8	x8

- 当运行 CrossFireX™ 或 SLI® 模式时，推荐系统要有充足的电力供应。
- 当您安装多张显卡时，推荐您将机箱风扇的排线连接至主板上标示 CHA_FAN1-3 的插座，以获得更良好的散热环境。
- 第四代 Intel® Core™ 处理器支持 PCIe 3.0 传输速率。

当 PCIe_x8_2 插槽已占用时， PCIe_x16/x8_1 插槽则会切换为 x8 模式。

PCIe 运行模式				
PCIE_x4_3_SPEED	PCIE_x1_1	PCIE_x1_2	PCIE_x1_3	PCIE_x4_3
x1（默认）	x1	x1	x1	x1
x4	关闭	关闭	关闭	x4

如要设置 PCI Express x4_3 插槽（黑色）带宽选项，请参考 3.6.7 一节的说明。

本主板使用的中断请求（IRQ）一览表

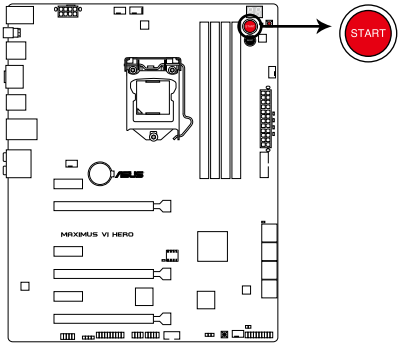
	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIE_x16/x8_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIE_x8_2	-	共享	-	-	-	-	-	-
PCIE_x4_3	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIE_x1_1	-	共享	-	-	-	-	-	-
PCIE_x1_2	-	-	共享	-	-	-	-	-
PCIE_x1_3	-	-	-	共享	-	-	-	-
I.G.F.X.	共享	-	-	-	-	-	-	-
Intel LAN 控制器	-	-	-	-	共享	-	-	-
SATA #0	-	共享	-	-	-	-	-	-
SATA #1	-	共享	-	-	-	-	-	-
高保真音频	-	-	-	-	-	-	共享	-
EHCI# 0 (USB 2.0)	-		-	-	-	-	-	共享
EHCI# 1 (USB 2.0)	-	-	-	-	共享	-	-	-
XHCI (USB 3.0)	-	-	-	-	-	共享	-	-
Asmedia SATA 6G 存储控制器	-	-	-	共享	-	-	-	-

1.2.6 主板上的内置开关

当您想要针对未安装在机箱的裸板或是开放机箱的系统作性能调校时，主板上内置的开关按钮与重置按钮可以方便您迅速地开关机或是重置系统。

1. 启动开关

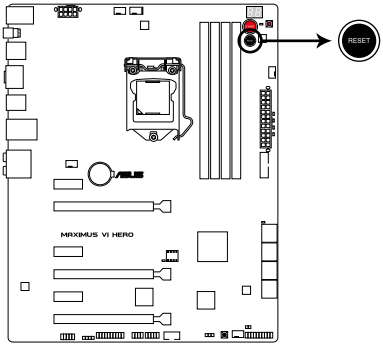
本主板拥有启动开关，让您可以唤醒系统或启动，并以灯号显示系统为开启、睡眠模式或在软关机的状态，这个灯号用来提醒您在本主板移除或插入任何元件之前要先关机。下图显示开关在主板上的位置。



MAXIMUS VI HERO Power on button

2. 重置开关

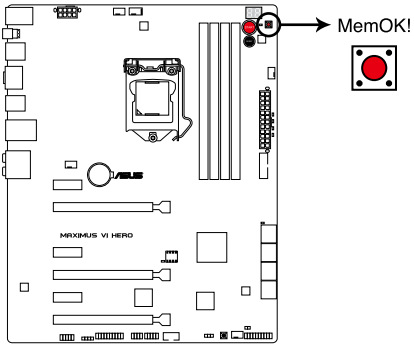
按下重置开关以重新启动系统。



MAXIMUS VI HERO Reset button

3. MemOK! 按钮

在主板上安装不兼容的内存条可能会导致启动失败，而且在 MemOK 开关旁的 MEMOK_LED 指示灯也会一直亮着。按住 MemOK! 开关直到 MEMOK_LED 指示灯开始闪烁，即开始自动将内存调整为兼容直到成功启动。

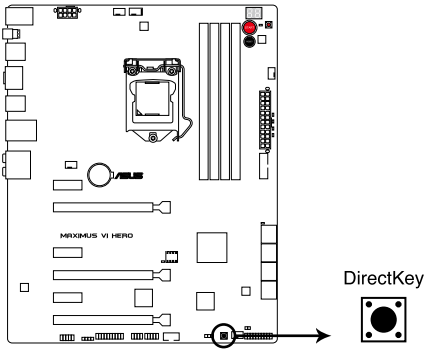


MAXIMUS VI HERO MemOK! button

- 请参考 1.2.8 内置指示灯 来找到 MEMOK_LED 更精确的位置。
- MEMOK_LED 指示灯在内存没有正确安装时也会亮起，在使用 MemOK! 功能前，请先关闭系统并重新安装内存。
- MemOK! 开关在 Windows® 操作系统下无法使用。
- 在调整过程中，系统会载入与测试故障安全防护内存设置。系统进行一项故障安全防护设置测试约需要 30 秒的时间，若是测试失败，系统会重新启动并测试下一个项目。MEMOK_LED 指示灯闪烁的速度增加表示正在运行不同的测试过程。
- 由于内存调整需求，系统将于每一组设置值测试时重新启动。在经过整个调整过程后若安装的内存仍然无法启动，MEMOK_LED 指示灯会持续亮着，请替换为用户手册或华硕网站（www.asus.com.cn）的合格供应商列表中推荐使用的内存。
- 在调整过程中，若是您将电脑关机并更换内存，在启动电脑后，系统会继续进行内存调整。若要停止内存调整，将电脑关机然后将电源线拔除大约 5～10 秒即可。
- 若系统因 BIOS 超频而无法启动，按一下 MemOK! 开关来启动电脑并载入默认的 BIOS 设置。在开机自检过程中会出现一个信息提醒您 BIOS 已经恢复至默认值。
- 在使用 MemOK! 功能后，推荐您到华硕网站（www.asus.com.cn）下载最新版本的 BIOS 程序。

4. DirectKey 按钮

这个按钮用来让用户在按下按钮后直接进入 BIOS 程序设置。通过 DirectKey 按钮，您可以不需要在开机自检（POST）过程中按下 <Del>，在任何时候皆可进入 BIOS 程序设置；也可以让您在启动过程中，启动或关闭系统，并轻松的进入 BIOS 程序。



MAXIMUS VI HERO DirectKey button

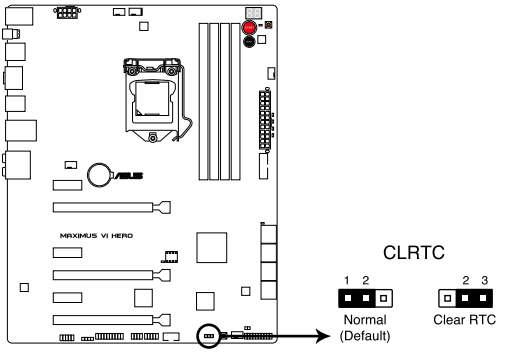
使用 DirectKey 按钮之前，请先确认您的数据已经存储。

- 当系统正在运行时按下 DirectKey 按钮，系统可能会关闭。再按一次本按钮或是启动按钮来重新启动，并直接进入 BIOS 程序设置。
- 请使用启动按钮来关闭系统，以让重新启动系统时运行开机自检（POST）程序（不进入 BIOS 程序）。
- 请参考 3.8 启动菜单（Boot Menu） 来获得 DirectKey 功能的详细信息。

1.2.7 跳线选择区

1. CMOS 配置数据清除（3-pin CLRTC）

这个跳线可清除在 COMS 里的实时时钟（RTC）RAM。您可以通过清除 CMOS 配置数据以删除 CMOS 内存中以及系统设置参数等数据。主板上的水银电池提供了 CMOS 里用来存储数据的 RAM 所需的电力，并可清除如系统密码等系统设置数据。



MAXIMUS VI HERO Clear RTC RAM

当想要清除配置数据时，请依照下列步骤进行：

(1) 关闭电脑电源，拔掉电源线。

(2) 将 CLRTC 跳线帽由 [1-2]（默认值）改为 [2-3] 约 5～10 秒钟（此时即清除 CMOS 数据），然后再将跳线帽改回 [1-2]。

(3) 插上电源线，开启电脑电源。

(4) 当启动步骤正在进行时按着键盘上的 <Del> 键进入 BIOS 程序画面重新设置 BIOS 数据。

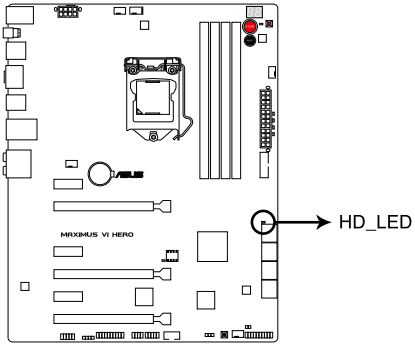
除了清除 RTC RAM 的数据以外，请勿将主板上 CLRTC 的跳线帽由默认值的位置移除，因为这么做可能会导致系统启动失败！

- 若上述的步骤没有作用，请将主板上的电池移除，并且再次将跳线帽依照上面的步骤来清除 CMOS RTC RAM 的数据。当完成清除的动作后，请再将电池装回主板上。
- 如果您是因为 CPU 超频的缘故导致系统死机，您无须使用上述的配置数据清除方式来排除问题。推荐可以采用 C.P.R（CPU 自动参数恢复）功能，只要将系统重新启动 BIOS 即可自动恢复默认值。
- 由于芯片组的作用，需要关闭 AC 电源才能启用 C.P.R 功能。您必须关闭电源或拔掉与重新接上电源线之前重新启动系统。

1.2.8 内置 LED 指示灯

1. 硬盘指示灯

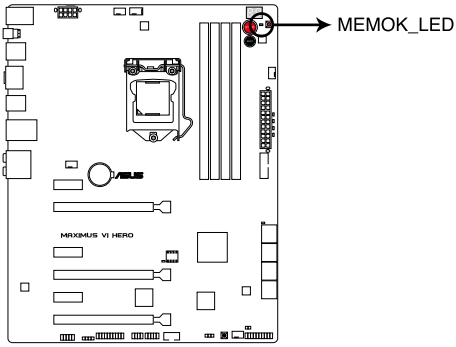
这个指示灯设计用来显示硬盘运行的状态。当指示灯闪烁时表示正在读取硬盘的数据或数据正在写入硬盘中，若是指示灯一直没有亮起，则表示本主板没有连接硬盘或是硬盘没有作用。



MAXIMUS VI HERO Hard Disk LED

2. MemOK！ 指示灯

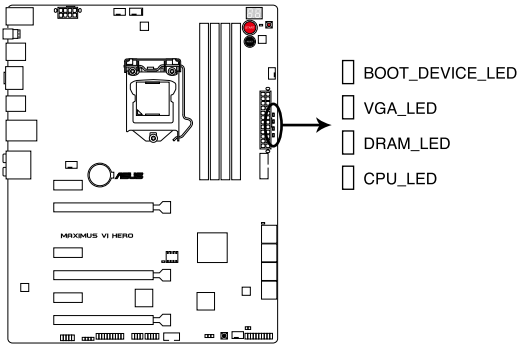
闪烁：表示在 POST（开机自检）前显示 MemOK! 已启动。



MAXIMUS VI HERO MEMOK LED

3. Q 指示灯

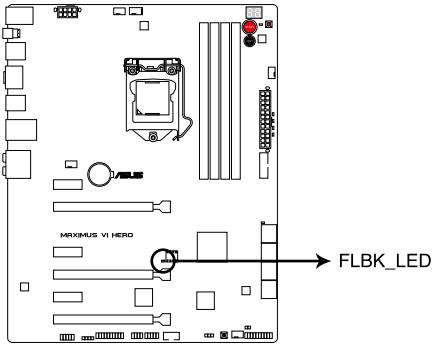
Q 指示灯提供查看主要元件（CPU、内存、显卡与启动设备），从主板启动后依序查看。当发现错误时，在该项目旁的指示灯则会亮灯直到问题解决。这项友善的设计提供直觉的方式，能在短短几秒内找到问题点。



MAXIMUS VI HERO CPU/ DRAM/ VGA/ BOOT_DEVICE LED

4. BIOS 指示灯

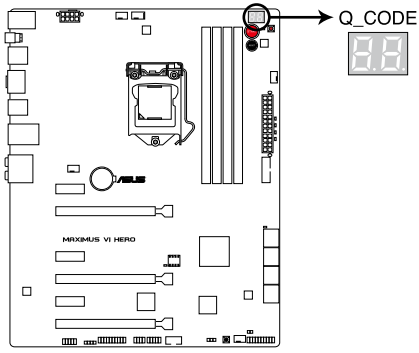
BIOS 指示灯为协助指示 BIOS 启动状态，按下 BIOS 按钮可以在 BIOS 1 与 BIOS 2 之间做切换，并且当相应的指示灯亮灯时，则表示该 BIOS 正在使用。



MAXIMUS VI HERO FLBK_LED

5. Q-Code 指示灯

Q-Code 指示灯设计为 2 位显示，用来得知系统状态。请参考下方 Q-Code 列表来获得更详细的信息。



MAXIMUS VI HERO Q-Code LED

Q-Code 列表

Code	说明
00	Not used
01	Power on. Reset type detection (soft/hard).
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization
0C — 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded
10	PEI Core is started
11 — 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 — 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 — 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B — 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 — 36	CPU post-memory initialization
37 — 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B — 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
50 — 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
00	Not used
01	Power on. Reset type detection (soft/hard).
02	AP initialization before microcode loading
03	System Agent initialization before microcode loading
04	PCH initialization before microcode loading
06	Microcode loading
07	AP initialization after microcode loading
08	System Agent initialization after microcode loading
09	PCH initialization after microcode loading
0B	Cache initialization
0C — 0D	Reserved for future AMI SEC error codes
0E	Microcode not found
0F	Microcode not loaded
10	PEI Core is started
11 — 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 — 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 — 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B — 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 — 36	CPU post-memory initialization
37 — 3A	Post-Memory System Agent initialization is started

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
3B — 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started
50 — 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C — 5F	Reserved for future AMI error codes
E0	S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 — E7	Reserved for future AMI progress codes
E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC — EF	Reserved for future AMI error codes
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 — F7	Reserved for future AMI progress codes
F8	Recovery PPI is not available

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
F9	Recovery capsule is not found
FA	Invalid recovery capsule
FB — FF	Reserved for future AMI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 — 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B — 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 — 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A — 7F	Reserved for future AMI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E — 9F	Reserved for future AMI codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8— BF	Reserved for future AMI codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error

Q-Code 列表（续上页表格）

Code	说明
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

ACPI/ASL 检查表

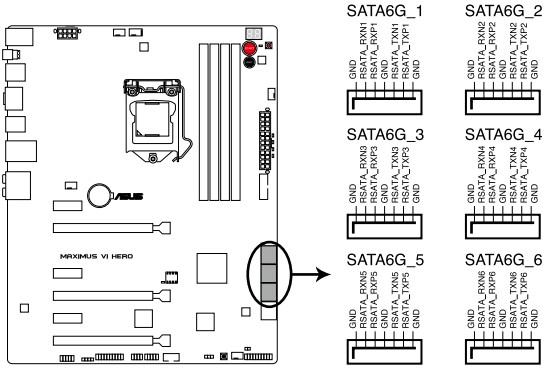
Code	说明
0x01	System is entering S1 sleep state
0x02	System is entering S2 sleep state
0x03	System is entering S3 sleep state
0x04	System is entering S4 sleep state
0x05	System is entering S5 sleep state
0x10	System is waking up from the S1 sleep state
0x20	System is waking up from the S2 sleep state
0x30	System is waking up from the S3 sleep state
0x40	System is waking up from the S4 sleep state
0xAC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
0xAA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

1.2.9 内部接口

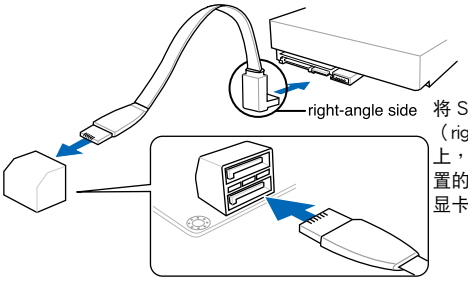
1. Intel® Z87 Serial ATA 6Gb/s 设备连接插槽（7-pin SATA6G_1-6 [红色]）

这些插槽可支持使用 Serial ATA 6Gb/s 排线来连接 Serial ATA 6Gb/s 硬盘。

若您安装了 Serial ATA 硬盘，您可以通过 Intel® Rapid Storage 技术，与内置的 Intel® Z87 芯片组来创建 RAID 0、1、5 与 RAID 10 磁盘数组。



MAXIMUS VI HERO Intel® SATA 6Gb/s connectors

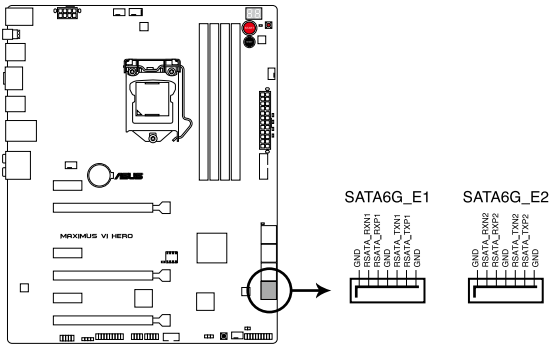


将 SATA 信号在线的直角接口端（right angle side）连接在 SATA 设备上，或是将直角接口端安装至主板内置的 SATA 接口，以避免造成与较大显卡的冲突。

- 这些插槽的默认值为 [AHCI Mode]，若您想要使用这些插槽来建构 Serial ATA RAID 功能，请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 项目设置为 [RAID Mode]。请参考 3.6.3 SATA 设置（SATA Configuration）一节的详细说明。
- 在创建 RAID 磁盘数组之前，请先参考 5.1 RAID 设置 或驱动程序与应用程序光盘中用户手册的说明。
- 当您使用支持 NCQ 技术的硬盘时，请先将 BIOS 程序中的 SATA Mode 设置为 [AHCI Mode]。请参考 3.6.3 SATA 设置（SATA Configuration）一节的说明。

2. ASMedia® Serial ATA 6Gb/s 插槽（7-pin SATA6G_E1/2 [红色]）

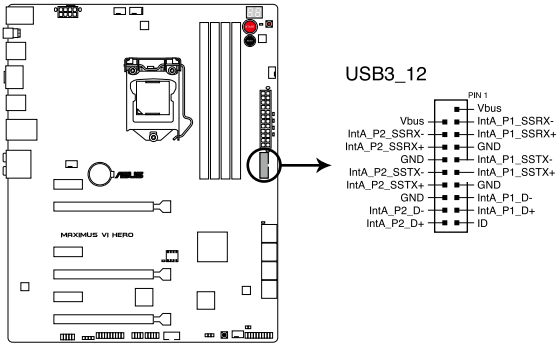
这些插槽可支持使用 Serial ATA 6Gb/s 排线来连接 Serial ATA 6Gb/s 硬盘。



MAXIMUS VI HERO Asmedia® SATA 6Gb/s connectors

3. USB 3.0 连接插槽（20-1 pin USB3_12）

这个插槽用来连接 USB 3.0 模块，可在前面板或后侧接口扩展 USB 3.0 模块。当您安装 USB 3.0 模块，您可以享受 USB 3.0 的益处，包括有更快的数据传输率最高达 5Gbps、对可充电的 USB 设备更快的充电速度、最佳化能源效率，以及与 USB 2.0 向下兼容。

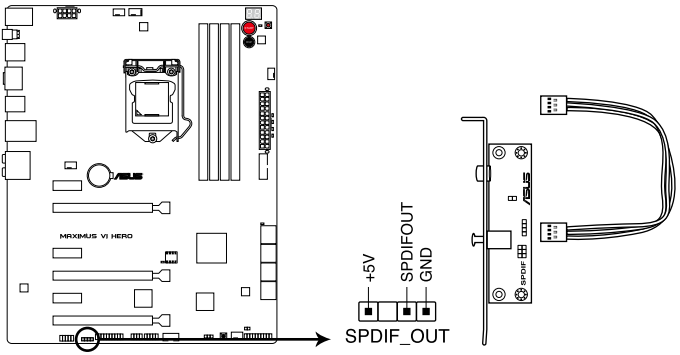


MAXIMUS VI HERO USB3.0 connector

- USB 3.0 模块为选购配备，请另行购买。
- 这个插槽是以 xHCI 规格为基础，推荐您在 Windows® 7 操作系统中安装相关的驱动程序来充分使用 USB 3.0 插槽。

4. 数码音频连接排针（4-1 pin SPDIF_OUT）

这组排针是用来连接 S/PDIF 数码音频模块，您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频信号线连接到音频设备的数码音频输出端，使用数码音频输出来代替常规的模拟音频输出。

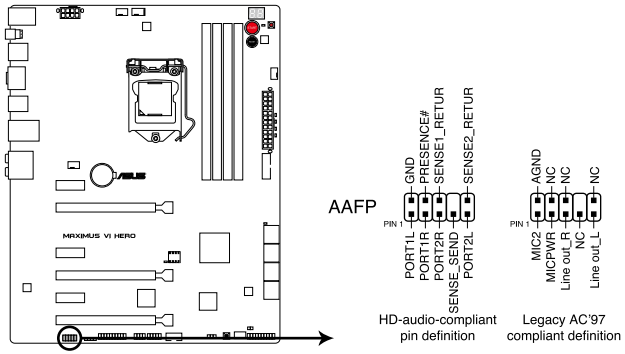


MAXIMUS VI HERO Digital audio connector

S/PDIF 模块为选购配备，请另行购买。

5. 前面板音频连接排针（10-1 pin AAFP）

这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线，除了让您可以轻松地通过主机前面板来控制音频输入/输出等功能，并且支持 AC’97 或 HD Audio（高保真音频）标准。将前面板音频输出/输入模块的连接排线之一端连接到这个插槽上。

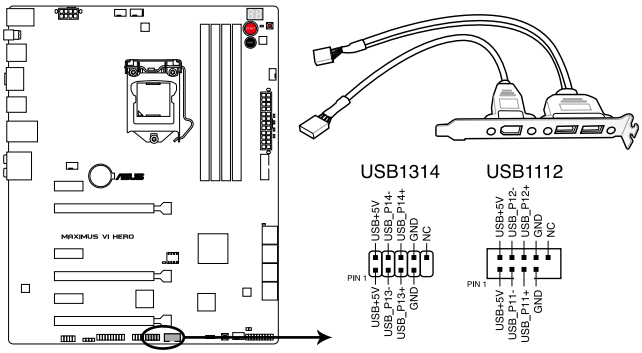


MAXIMUS VI HERO Analog front panel connector

- 推荐您将支持高保真（high definition）音频的前面板音频模块连接到这组排针，如此才能获得高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频或 AC’97 前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD] 或 [AC97]。

5. USB 2.0 连接插槽（10-1 pin USB1112；USB1314）

这些 USB 扩展套件排线插槽支持 USB 2.0 规格，将 USB 模块排线连接至任何一个插槽，然后将模块安装到机箱后面板中开放的插槽。这些 USB 插槽与 USB 2.0 规格兼容，并支持传输速率最高达 480 Mbps。



MAXIMUS VI HERO USB2.0 connectors

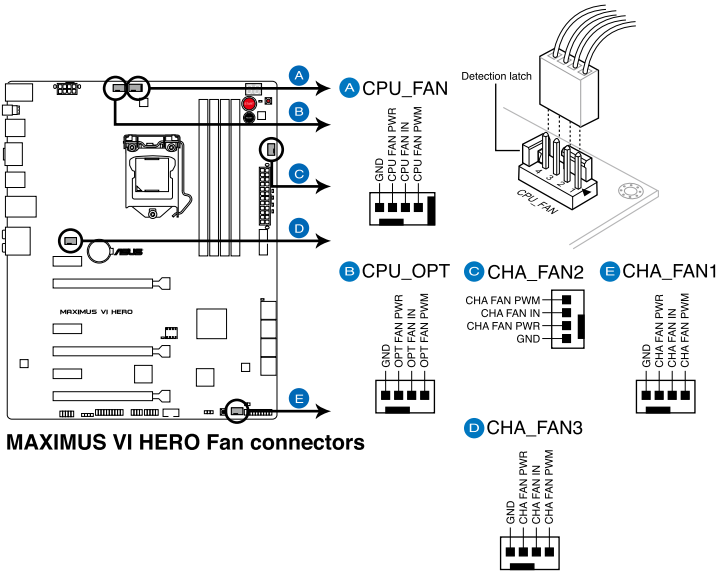
请勿将 1394 排线连接到 USB 插槽上，这么做可能会导致主板的损毁。

若是您的机箱拥有前面板 USB 接口，您可以将前面板 USB 排线连接至 ASUS Q-Connector（USB），然后将 Q-Connector（USB）安装至主板内置的 USB 插槽上。

2 组 USB2.0 接口（USB1314）位于主板中央与 ROG extension（ROG_EXT）接口共享。

7. 中央处理器、机箱与选用风扇电源插槽（4-pin CPU_FAN；4-pin CPU_OPT；4-pin CHA_FAN1-3）

将风扇排线连接至风扇插槽，并确认每条连接排线的黑线是接到风扇电源插槽上的接地端（GND）。



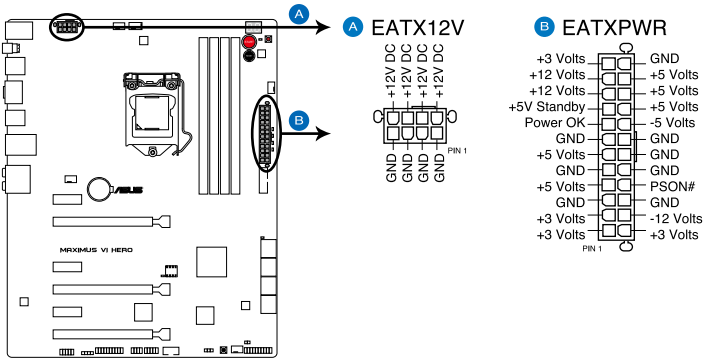
MAXIMUS VI HERO Fan connectors

千万要记得连接风扇的电源，若系统中缺乏足够的风量来散热，那么很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机，甚至更严重者会烧毁主板上的电子元件。注意：这些插槽并不是单纯的排针！不要将跳线帽套在它们的针脚上。

- CPU_FAN 插槽支持处理器风扇最大达 1 安培（12 瓦）的风扇电源。
- CPU 风扇插槽特殊的接口检测所安装的 CPU 风扇类型，并会自动更改风扇控制模式（DC 模式与 PWM 模式）以达到最精确的风扇控制功能。

8. 主板电源插槽（24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V）

这些电源插槽用来连接一个 ATX 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计，只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后，只需稳稳地将之套进插槽中即可。

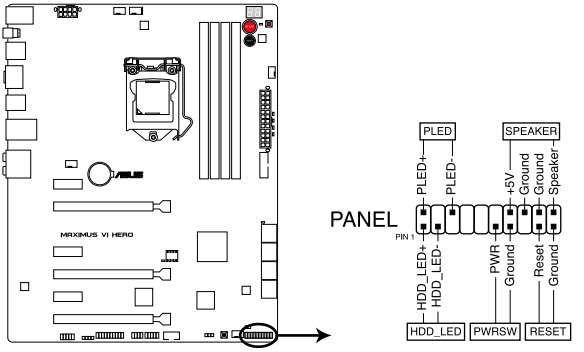


MAXIMUS VI HERO ATX power connectors

- 推荐您使用与 2.0 规格的 24-pin ATX 12V 兼容的电源（PSU），才能提供至少 350W 高功率的电源，以供应系统足够的电源需求。
- 请务必连接 4-pin/8-pin EATX12V 电源插头，否则系统可能无法顺利启动。
- 如果您想要安装其他的硬件设备，请务必使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。若电源无法提供设备足够的用电需求，则系统将会变得不稳定或无法开启。
- 若是您想要安装二张或更多的高级 PCI Express x16 显卡，请使用 1000 瓦以上的电源以确保运行稳定。
- 如果您不确定系统所要求的最小电源供应值为何，请至华硕技术支持网页中的**电源瓦数推荐值计算** http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-cn 获得详细的说明。

9. 系统控制面板连接排针（20-8 pin PANEL）

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。下述将针对各项功能作逐一简短说明。



MAXIMUS VI HERO System panel connector

- 系统电源指示灯连接排针（2-pin PLED）

  这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用电脑的情况下，该指示灯会持续亮着；而当指示灯闪烁亮着时，即表示电脑正处于睡眠模式中。

- IDE 硬盘动作指示灯号接针（2-pin HDD_LED）

  您可以连接此组 HDD_LED 接针到主板上的硬盘动作指示灯号，如此一旦硬盘有存取动作时，指示灯随即亮起或闪烁。

- 机箱音箱连接排针（4-pin SPEAKER）

  这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的音箱。当系统正常启动便可听到哔哔声，若启动时发生问题，则会以不同长短的音调来警示。

- ATX 电源/软关机开关连接排针（2-pin PWRSW）

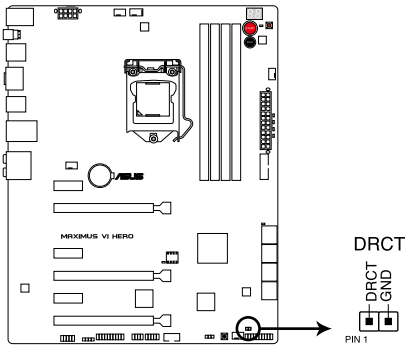
  这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序或操作系统的设置，来决定当按下开关时电脑会在正常运行和睡眠模式间切换，或者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机，请持续按住电源开关超过四秒的时间。

- 热启动开关连接排针（2-pin RESET）

  这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉电脑电源即可重新启动，尤其在系统死机的时候特别有用。

10. DirectKey 插槽（2-pin DRCT）

这个插槽用来连接机箱上的按钮来支持使用 DirectKey 功能。将机箱上支持本功能按钮之排线，从机箱连接至主板。

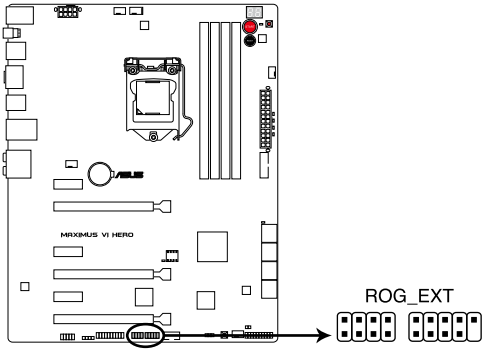


MAXIMUS VI HERO DirectKey connector

请确认您的机箱配备有支持本功能之排线，请参考机箱的用户手册来获得详细的说明。

11. ROG Extension - ROG_EXT 插槽（18-1 pin ROG_EXT）

这组插槽可供 OC Panel 连接使用 OC Panel，可帮助您进行超频的便利性而无须进入 BIOS 设置、下载操作系统或使用超频软件程序。

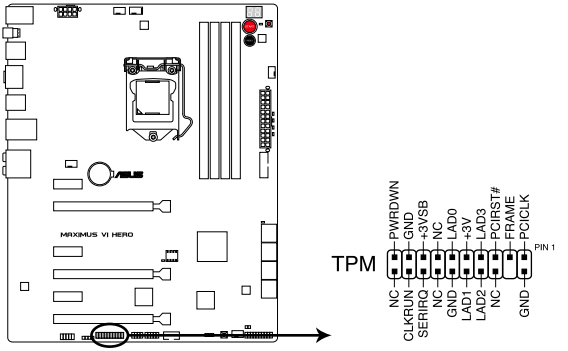


MAXIMUS VI HERO ROG_EXT connectors

OC Panel 套件为选购配备，请另行购买。

12. TPM 插座（20-1 pin TPM）

这个插座支持可信任安全平台模块（TPM）系统，用来安全地存储金钥、数码认证、密码和数据。可信任安全平台模块（TPM）系统也用来协助加强网络安全，保护数码身分，以及确保平台的安全性。



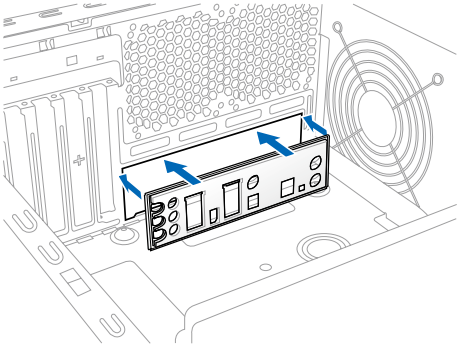
MAXIMUS VI HERO TPM connector

2.1 创建您的电脑系统

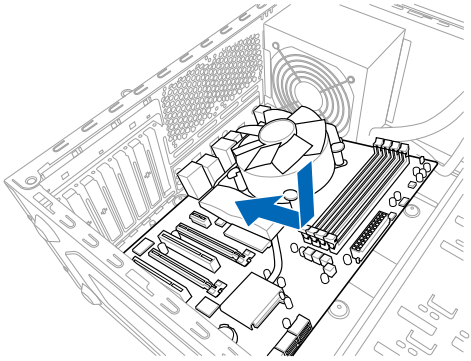
2.1.1 安装主板

本章节的图标只能参考，主板的结构可能会随着型号而有所不同，但是安装的步骤仍然是相同的。

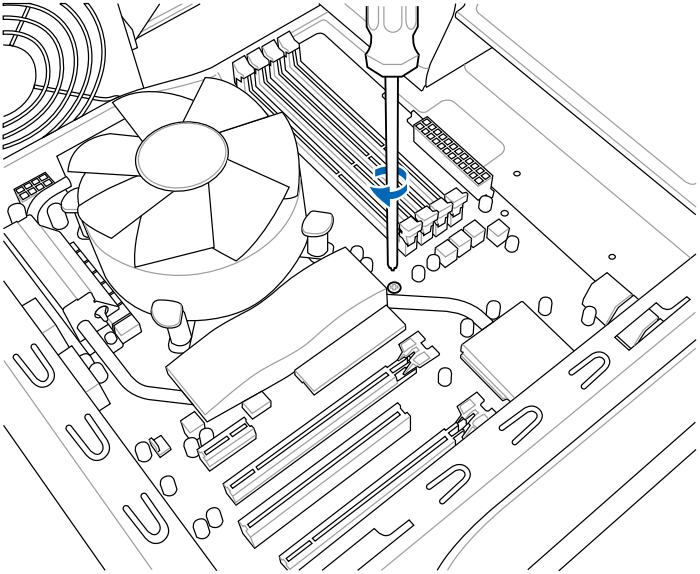
1. 安装华硕 Q-Shield 挡板至机箱的后侧 I/O 面板。

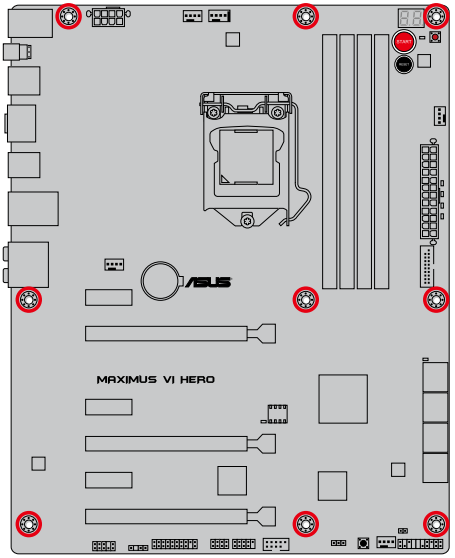


2. 将主板放入机箱，并确认后侧 I/O 接口对齐机箱的后侧 I/O 面板。



3. 将九个螺丝放入主板上的螺丝孔并旋转锁紧，以确保将主板锁至机箱。

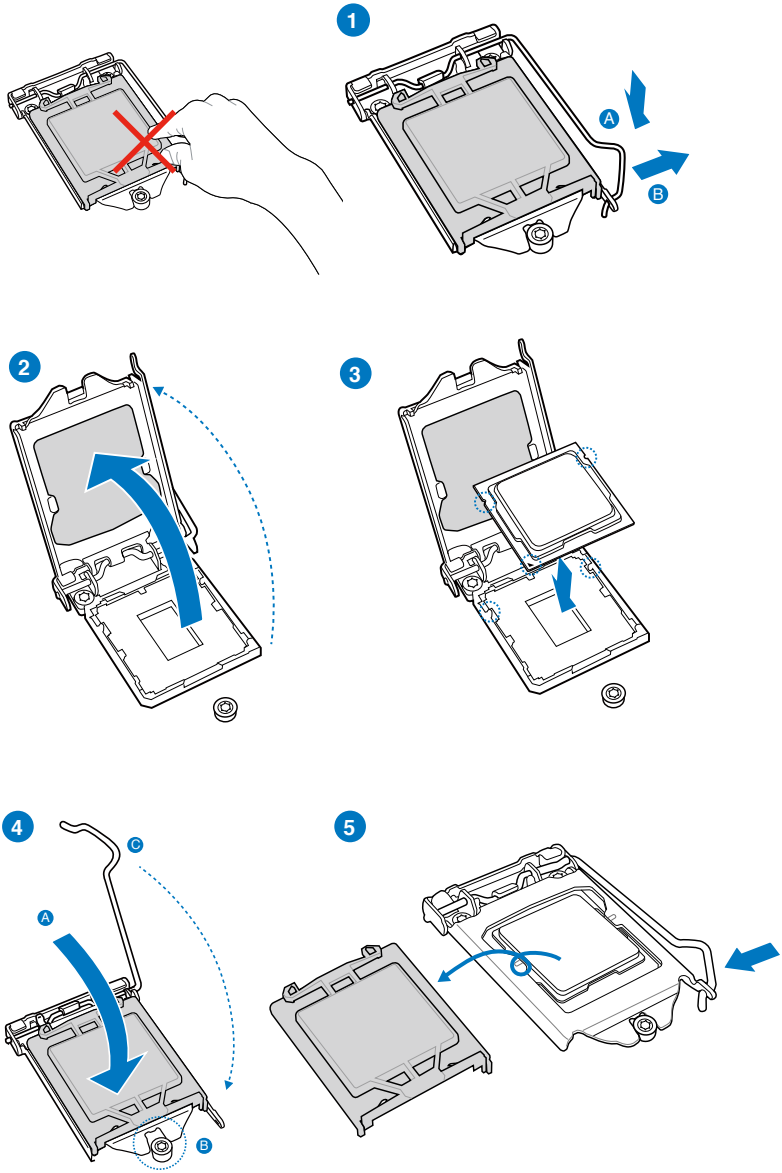




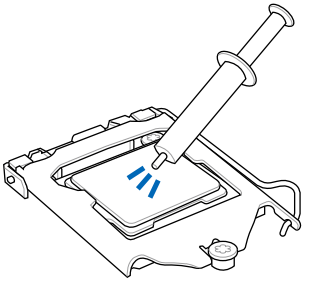
请勿将螺丝锁得太紧！否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。

2.1.2 安装中央处理器

本插槽只支持 LGA1150 处理器，请确认并安装正确的处理器，请勿将 LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1150 插槽。

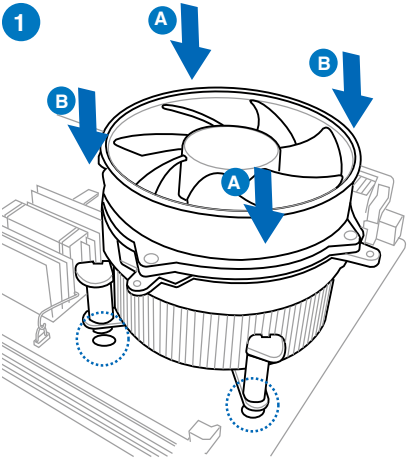


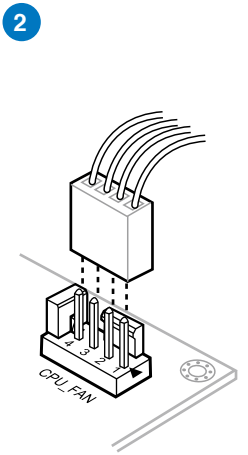
2.1.3 处理器散热片与风扇安装

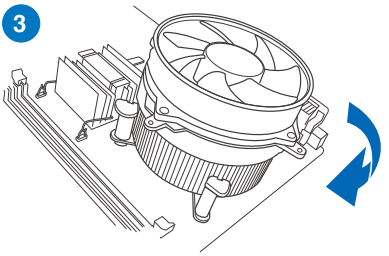


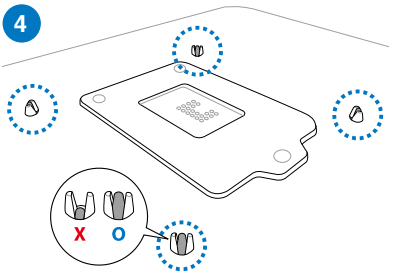
在安装散热片与风扇之前若有需要，请先将处理器与散热片涂上散热膏。

安装散热片与风扇



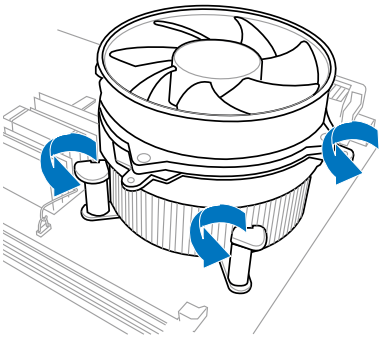




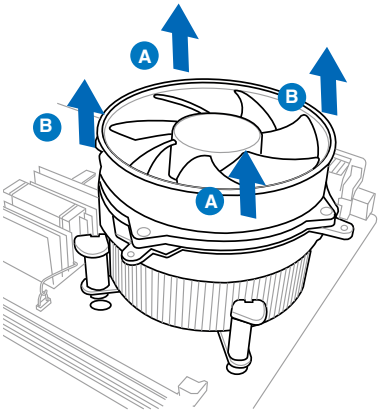


取出散热片与风扇

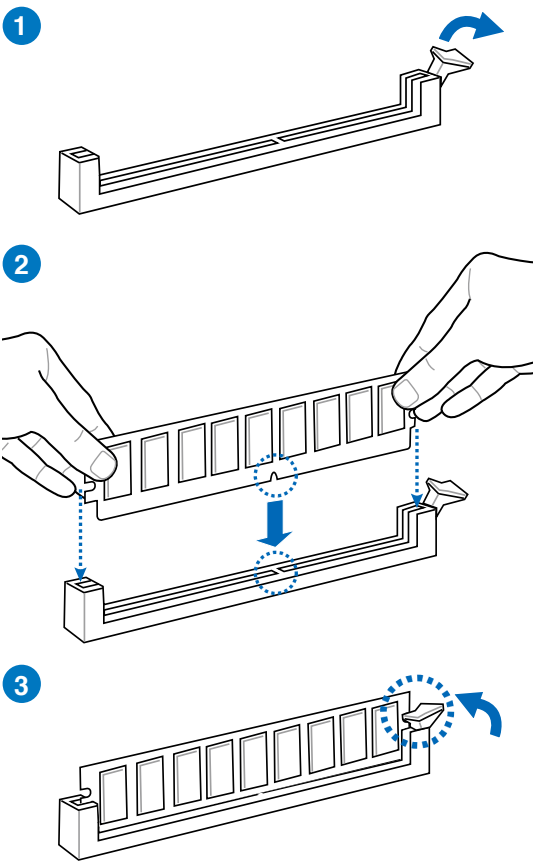
1



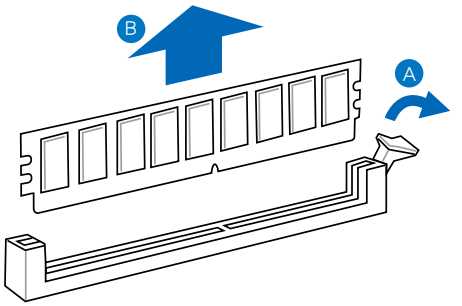
2



2.1.4 安装内存条

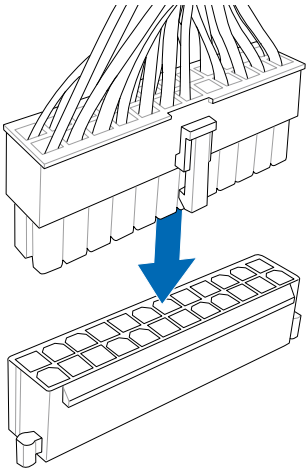


取出内存条

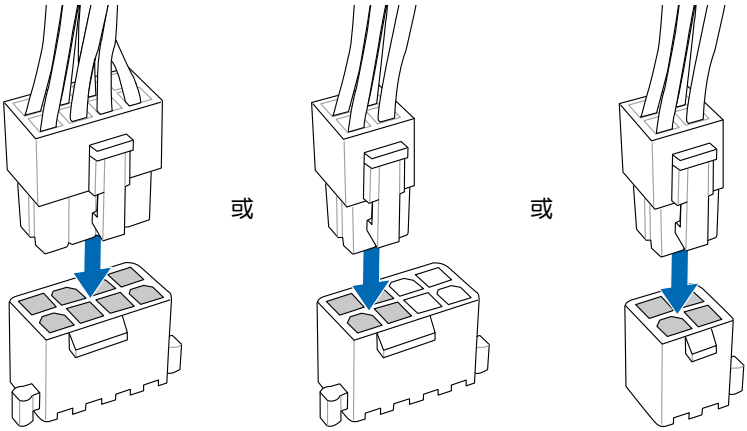


2.1.5 安装 ATX 电源

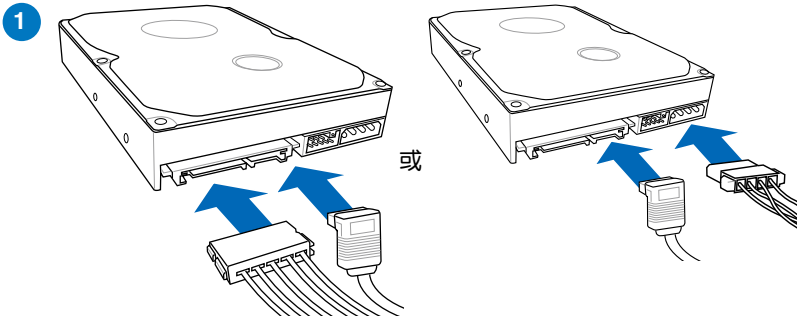
1

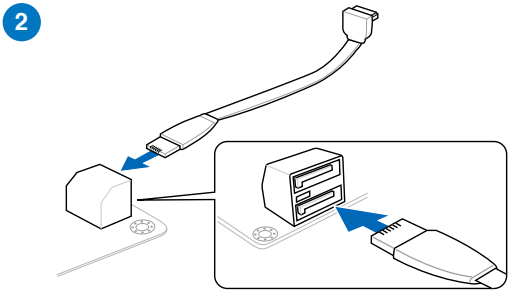


2



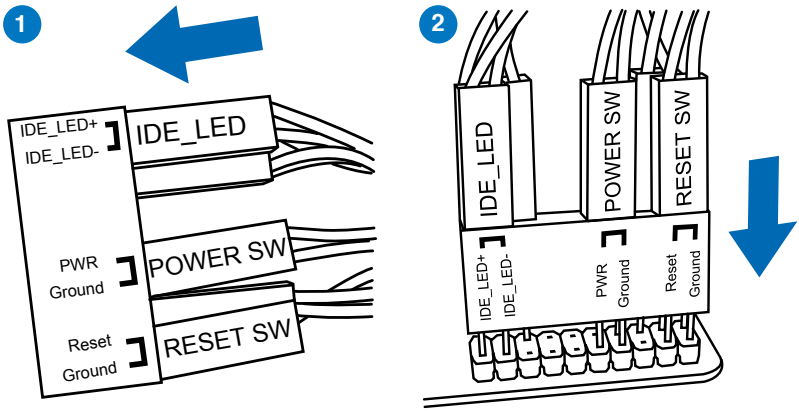
2.1.6 安装 SATA 设备



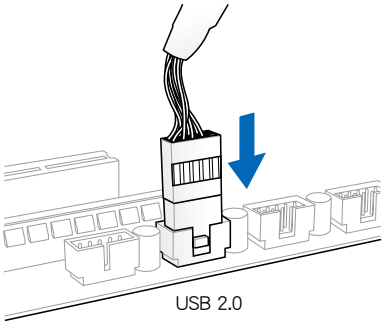


2.1.7 安装前面板输出/输入接口

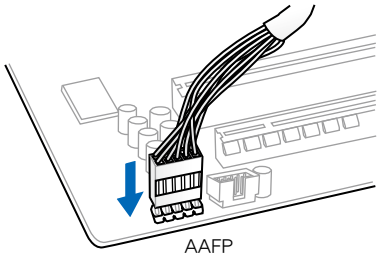
安装 ASUS Q-Connector



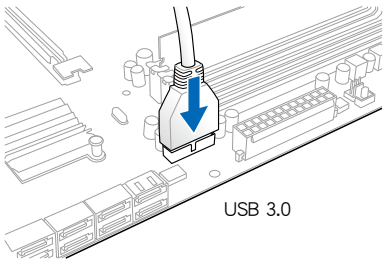
安装 USB 2.0 连接插槽



安装前面板音频连接插槽

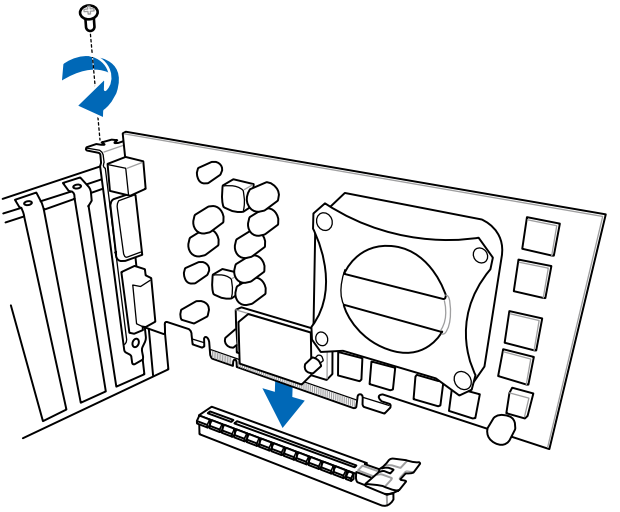


安装 USB 3.0 连接插槽



2.1.8 安装扩展卡

安装 PCIe x16 显卡



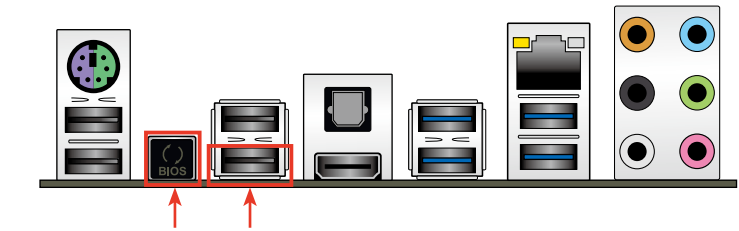
2.2 BIOS 更新应用程序

2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频，不需要进入 BIOS 或操作系统，只要插入 USB 存储设备然后按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟，BIOS 程序就会自动在待机状态下更新，从此以后超频无须再烦恼，并拥有无与伦比的便利性。

使用 USB BIOS Flashback：

1. 从华硕网站下载最新的 BIOS 文件。
2. 将取得的 BIOS 映像档更名为 M6H.CAP。
3. 将 M6H.CAP 文件复制到 USB 便携存储设备的根目录底下。
4. 将系统关机并将 USB 存储设备插入 ROG Connect 接口。
5. 按下 ROG Connect 按钮并且当指示灯闪烁亮灯时放掉按钮，此时则表示 BIOS Flashback 功能已经启动。
6. 当指示灯停止闪烁时，即表示更新已经完成。

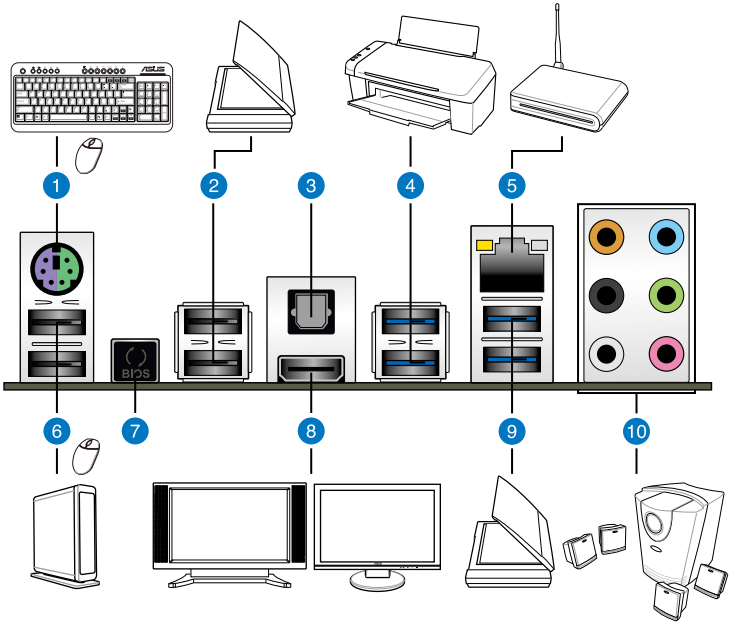


若要了解更多有关 BIOS 程序的设置方式，请参考第三章的说明。

- 在更新 BIOS 过程中，请勿将外接式存储设备、电源拔除，也请勿按下 CLR_CMOS 按钮，否则更新过程将会被中断。若是发生更新中断的状况，请依照上述步骤重新进行更新直至更新完成为止。
- 更新 BIOS 可能会有风险，若是在更新过程中发生 BIOS 程序毁损导致系统无法重新启动时，请与当地的客服中心联络寻求协助。

2.3 主板后侧与音频接口

2.3.1 后面板接口



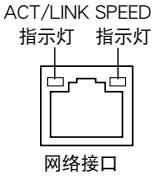
后面板接口
1. PS/2 键盘/鼠标复合式接口
2. Intel® USB 2.0 接口 9 和 10
3. 光纤 S/PDIF 输出接口
4. Intel® USB 3.0 接口 3 和 4
5. RJ-45 网络接口*
6. Intel® USB 2.0 接口 7 和 8
7. USB BIOS Flashback 按钮
8. HDMI 接口
9. Intel® USB 3.0 接口 5 和 6
10. 音频输出/输入接口**

* 与 **：请参考下页表格中网络接口指示灯与音频接口的定义。

- 由于 USB 3.0 的限制，USB 3.0 设备只能在 Windows® 操作系统环境下，以及安装过 USB 3.0 驱动程序后才能使用。
- USB 3.0 设备只能用来作为数据磁盘。
- 强烈推荐您将 USB 3.0 设备连接至 USB 3.0 接口，才能让 USB 3.0 设备获得更快更好的性能表现。
- 由于 Intel 8 系列芯片组的设计，所有连接至 USB 2.0 与 USB 3.0 接口的 USB 设备都是由 xHCI 控制器所控制。有些常规的 USB 设备必须更新固件后才能拥有更好的兼容性。

* 网络指示灯之灯号说明

Activity 连接指示灯		Speed 指示灯	
状态	说明	状态	说明
关闭	没有连接	关闭	连接速度 10 Mbps
橘色灯号	已连接	橘色灯号	连接速度 100 Mbps
闪烁	数据传输中	绿色灯号	连接速度 1 Gbps

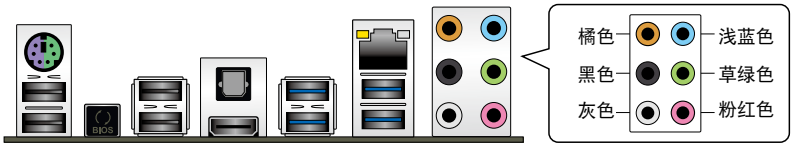


** 二、四、六或八声道音频设置

接口	耳机/二声道音箱输出	四声道音箱输出	六声道音箱输出	八声道音箱输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置音箱输出	前置音箱输出	前置音箱输出
粉红色	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入
橘色	-	-	中央声道/重低音音箱输出	中央声道/重低音音箱输出
黑色		后置音箱输出	后置音箱输出	后置音箱输出
灰色	-	-	-	侧边音箱输出

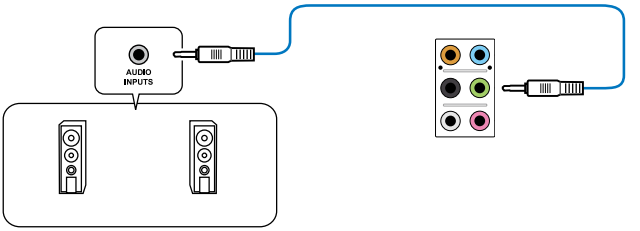
2.3.2 音频输出/输入连接图标说明

音频输出/输入接口

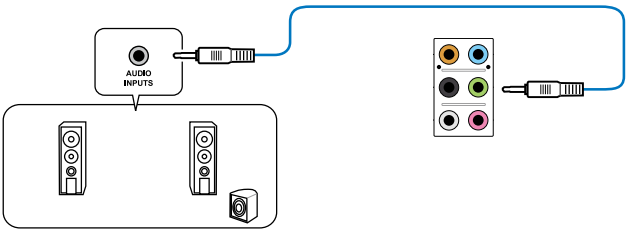


连接耳机与麦克风

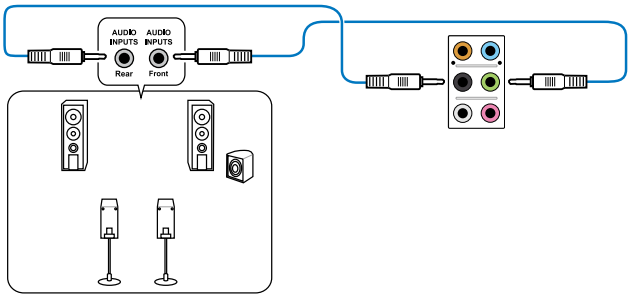
连接立体声音箱



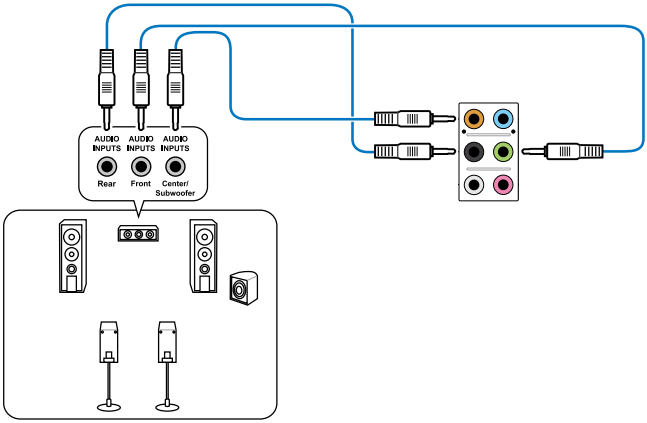
连接 2.1 声道音箱



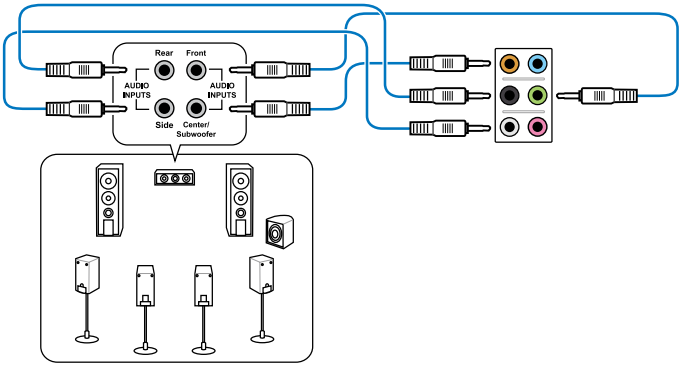
连接 4.1 声道音箱



连接 5.1 声道音箱



连接 7.1 声道音箱


Rear
Front
AUDIO INPUTS
AUDIO INPUTS
Side
Center/ Subwoofer

2.4 第一次启动电脑

1. 确认所有排线与接脚都接妥，然后盖上机箱的外盖。
2. 确定所有的开关都已关闭
3. 将电源线接上机箱背面的电输入插座。
4. 情况许可的话，最好将电源线路上加接突波吸收/保护器。
5. 您可以先开启以下周边的电源：
   a. 显示器
   b. 外接式 SCSI 接口外围设备（从串连的最后端开始）
   c. 系统电源（ATX 的电源不会因为送电而马上动作，而是等待面板上的按钮动作后才会工作）
6. 送电之后，机箱面板上应该会有电源指示灯亮起才对。如果是使用 ATX 电源的话，必须等到面板按钮被触碰后才会启动电源，电源指示灯此时才会亮起。如果您的电脑符合绿色省电标准，已随时准备可以进入省电模式的话，显示器指示灯也会亮起。如果启动过程一切顺利的话，不久就可以在显示器上看到画面了，如果送电之后超过 30 秒而画面未有动静的话，表示电脑的设置尚有问题存在，请再进一步地的检查各项动作，如果还是不行，就需要向厂商求助了！

BIOS 哔声所代表的意义

哔声	代表意义
一短哔声	检测到 VGA 显卡 快速启动设置为关闭 没有键盘被检测到
一连续哔声后跟随两短哔声，暂停一下然后重复	没有内存被检测到
一连续哔声后跟随三短哔声	没有 VGA 显卡被检测到
一连续哔声后跟随四短哔声	硬件组件失效

7. 在电源开启之后可按下 <Del> 键以进入 BIOS 的设置模式，详细设置方法请看本用户手册的第三章部份。

2.5 关闭电源

当系统在启动状态，压着电源开关少于四秒钟，系统会根据 BIOS 的设置，进入睡眠或热启动模式；若是压着电源开关多于四秒，不论 BIOS 的设置为何，系统则会直接进入热启动模式。

第三章

3.1 认识 BIOS 程序

华硕全新的 UEFI BIOS 是可延伸固件界面，符合最新的 UEFI 结构，这个友善的使用界面，跳脱常规使用键盘输入 BIOS 方式，提供更有弹性与更便利的鼠标控制操作。您可以轻易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的操作系统般顺畅。在本用户手册中的「BIOS」一词除非特别说明，所指皆为「UEFI BIOS」。

BIOS（Basic Input and Output System；基本输出入系统）用来存储系统启动时所需要的硬件设置，例如存储设备设置、超频设置、高级电源管理与启动设置等，这些设置会存储在主板的 CMOS 中，在正常情况下，默认的 BIOS 程序设置提供大多数使用情况下可以获得最佳的运行性能，**推荐您不要更改默认的 BIOS 设置**，除了以下几种状况：

- 在系统启动期间，屏幕上出现错误信息，并要求您运行 BIOS 程序设置。
- 安装新的系统元件，需要进一步的 BIOS 设置或更新。

不适当的 BIOS 设置可能会导致系统不稳定或启动失败，**强烈推荐您只有在受过训练专业人士的协助下，才可以运行 BIOS 程序设置的更改。**

下载或更新 BIOS 文件时，请将文件名称更改为 M6H.CAP 给本主板使用。

3.2 BIOS 程序设置

使用 BIOS Setup（BIOS 设置）功能可以更新 BIOS 或设置其参数。BIOS 设置画面包含导览键与简要的画面辅助说明，以指示您使用 BIOS 设置程序。

在启动过程进入 BIOS

当启动时进入 BIOS 设置程序：

- 当进入开机自检（POST）过程时，按下 <Delete> 键可以进入 BIOS 设置画面。若您未按下 <Delete> 键，则开机自检（POST）功能会继续进行。

在 POST 结束后才进入 BIOS

当 POST 结束后才进入 BIOS 设置程序：

- 按下 <Ctrl>+<Alt>+<Delete> 键。
- 或是按下机箱上的 RESET（重置）键重新启动。
- 或是将按下机箱上的电源按钮，将电脑关闭后再重新启动。如果前两种方式无效，再选用最后一种方式。
- 然后再于开机自检（POST）过程时按下 <Delete> 键进入 BIOS 设置画面。

- 在本章节的 BIOS 程序画面只能参考，将可能与您所见到的画面有所差异。
- 若您想在 BIOS 设置程序中使用鼠标操控，请先确认已将 USB 接口鼠标连接至主板。
- BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能，但是若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定，请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请选择 Exit 菜单中的 Load Optimized Defaults 项目或按下 <F5> 键，请参阅 3.10 退出 BIOS 程序 一节中的详细说明。
- 若是更改 BIOS 设置后启动失败，请试着使用清除 CMOS，然后将主板的设置值恢复为默认值。请参考 1.2.6 主板上的内置开关 一节关于 Clear CMOS 开关 的说明。
- BIOS 设置程序不支持蓝牙设备。

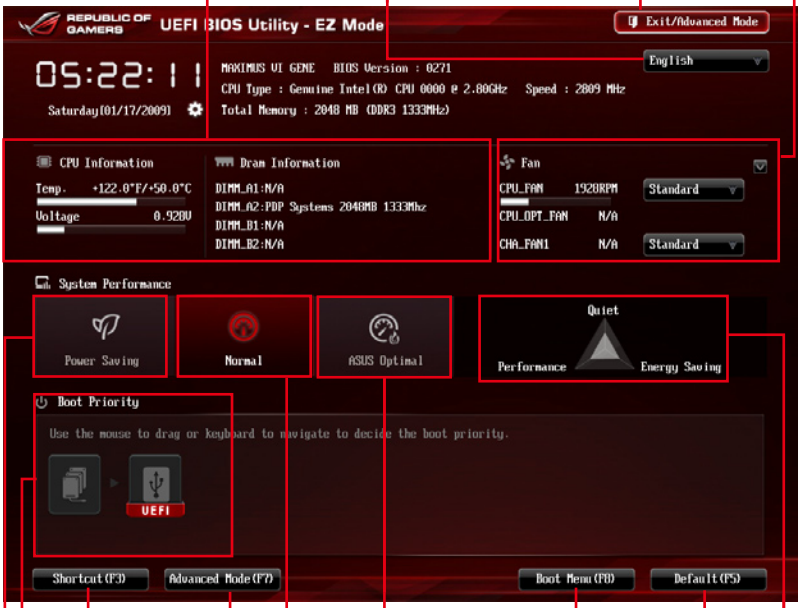
BIOS 菜单画面

本主板的 BIOS 设置程序提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 两种模式。您可以由 Exit 菜单中切换，或是选择 EZ Mode/Advanced Mode 菜单中的 Exit/Advanced Mode。

3.2.1 EZ Mode

您可在 EZ Mode 中查看系统基本数据，并可以选择显示语言、喜好设置及启动设备顺序。若要进入 Advanced Mode，请点击 Exit/Advanced Mode 然后选择 Advanced Mode，或是按下 F7 快捷键。

进入 BIOS 设置程序的画面可个人化设置，请参考 3.8 启动菜单（Boot menu）中关于 Setup Mode 项目的说明。

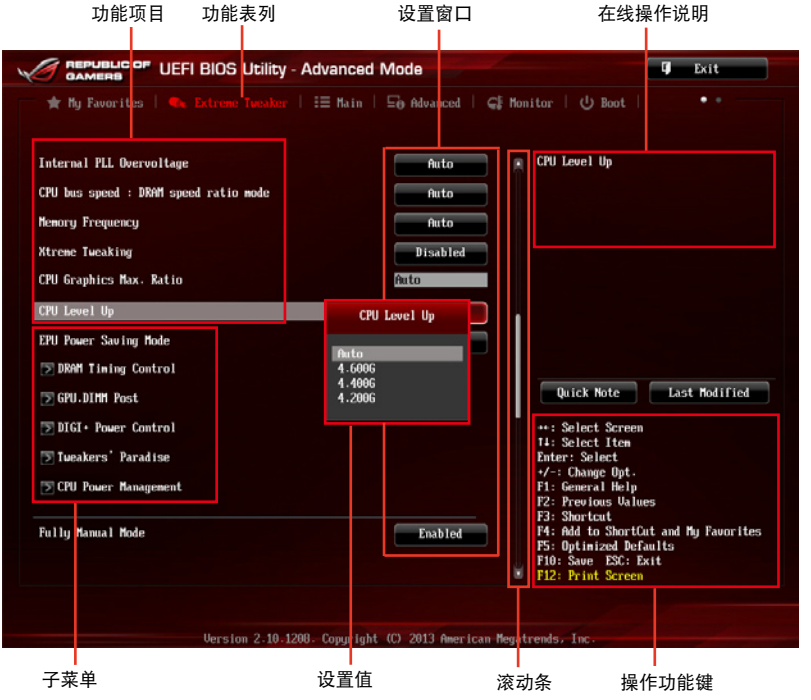


- 启动启动设备的选项将依您所安装的设备而异。
- Boot Menu(F8) 按钮只在启动设备安装于系统时才会显示。

3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供您更高级的 BIOS 设置选项。以下为 Advanced Mode 画面之范例，各个设置选项的详细说明请参考之后的章节。

欲进入 EZ Mode 时，请点击 Exit 并选择 Advanced Mode 或按 <F7> 键。



功能表列

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下：

My Favorites	本项目将记录时常使用的系统设置及设置值。
Extreme Tweaker	本项目提供超频设置。
Main	本项目提供系统基本设置。
Advanced	本项目提供系统高级功能设置。
Monitor	本项目提供温度、电源及风扇功能设置。
Boot	本项目提供启动磁盘设置。
Tool	本项目提供特殊功能设置。
Exit	本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。

菜单项目

于功能表列选定选项时，被选择的功能将会反白，即选择 Main 菜单所出现的项目。

点击菜单中的其他项目（My Favorites（我的最爱）、Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot、Tool 与 Exit）也会出现该项目不同的选项。

返回

在子菜单时即会出现此按钮。请按下 <Esc> 键或使用鼠标按下此按键回到前一菜单画面。

子菜单

在菜单画面中，若功能选项前面有一个小三角形（>）标记，代表此为子菜单，您可利用方向键来选择，并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

设置窗口

在菜单中选择功能项目，然后按下 <Enter> 键，程序将会显示包含此功能所提供的选项小窗口，您可以利用此窗口来设置您所想要的设置。

滚动条

在菜单画面的右方若出现如右图的滚动条画面，即代表此页选项超过可显示的画面，您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

操作功能键

在菜单画面的右下角将显示 BIOS 设置程序的操作功能键，请使用操作功能键选择项目进行设置。

如果您在 F3: 捷径列表中删除所有的捷径项目，在您下一次启动时，默认的捷径项目会再次出现。

操作说明

在菜单画面的右上方为当前所选择的作用选项的功能说明，此说明会依选项的不同而自动更改。使用 <F12> 键来抓取 BIOS 屏幕画面，并存储至携带式存储设备。

设置值

这些存在于菜单中的设置值是提供给用户选择与设置之用。这些项目中，有的功能选项只为告知用户当前运行状态，并无法更改。而可更改的项目，被选择时会以反白显示。

当可更改的项目已选择时将会反白，请按下 <Enter> 键以显示详细的设置选项。

快速笔记

按下此按钮，可让您针对已在 BIOS 中进行的设置输入笔记。

- 快速笔记不支持以下键盘功能：删除、剪下、复制与贴上。
- 您只能使用英文字母与数字来输入笔记。

上次修改的设置值

按下此按钮可查看您上次修改并存储的 BIOS 项目。

3.3 My Favorites（我的最爱）菜单

本菜单是专属您个人空间，让您在此轻易存入和读取您所喜爱的 BIOS 项目。

增加项目至我的最爱

请依照以下步骤增加项目至我的最爱：

1. 请使用箭头符号选择想要增加的项目，使用鼠标时，请将光标移至该项目上。
2. 按下 <F4> 键或是鼠标右键，以将项目增加至我的最爱。

以下项目无法加入至我的最爱：

- 有子菜单的项目。
- 用户自订项目，例如：语言、启动设备顺序。
- 设置项目，例如：内存 SPD 信息、系统时间与日期。

3.4 Extreme Tweaker 菜单

本菜单可让您设置超频功能的相关选项。

注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。

以下项目中所默认的数值，可能会随您所安装在主板上的 CPU 型式与内存条而有所不同。

将滚动条往下滚动来显示以下项目。

Ai Overclock Tuner [Auto]

本项目可以让您设置 CPU 的超频选项来达到您所想要的 CPU 内频。请选择以下任一种默认的超频选项：

[Auto] 自动载入系统最佳化设置值。

[Manual] 可让您独立设置超频参数。

[X.M.P.] 若您安装的内存有支持 eXtreme Memory Profile（X.M.P.）技术，请选择本项目来设置内存参数有效运行。

[X.M.P] 设置项目只有在当所安装的内存条支持 X.M.P（eXtreme Memory Profile）时才会出现。

ASUS MultiCore Enhancement [Enabled]

[Enabled] 默认值为 [Enabled] 以在 XMP/Manual/User-defined 内存频率模式下获得最佳化性能。

[Disabled] 本项目用来设置默认的核心比率。

CPU Core Ratio [Auto]

本项目用来设置 CPU 比值与自动同步、每个核心或所有核心。设置值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core]

当 CPU Core Ratio 设置为 [Auto] 时会出现以下项目：

Min CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置处理器的 uncore ratio 值至可能的最小值。设置值有：[Auto] [1] - [30]

Max CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置处理器的 uncore ratio 值至可能的最大值。设置值有：[Auto] [1] - [30]

当 CPU Core Ratio 设置为 [Sync All Core] 时会出现以下项目：

1-Core Ratio Limit [Auto]

本项目用来设置 1-Core Ratio Limit。

[Auto] 选择并应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置。

[Manual] 选择手动指定 1-Core Ratio Limit 数值高于或等于 2-Core Ratio Limit。

当 CPU Core Ratio 设置为 [Per Core] 时会出现以下项目：

1-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 选择并应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置。

[Manual] 选择手动指定 1-Core Ratio Limit 数值高于或等于 2-Core Ratio Limit。

2-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 选择并应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置。

[Manual] 选择手动指定 2-Core Ratio Limit 数值高于或等于 3-Core Ratio Limit。1-Core Ratio Limit 必须不能设为 [Auto]。

3-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 选择并应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置。

[Manual] 选择手动指定 3-Core Ratio Limit 数值高于或等于 4-Core Ratio Limit。1-Core/2-Core Ratio Limit 必须不能设为 [Auto]。

4-Core Ratio Limit [Auto]

[Auto] 选择并应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置。

若您要指派一个数值给更多的 Core Ratio Limit，请不要将其 Core Ratio Limit 设置为 [Auto]。

Internal PLL Overvoltage [Auto]

本项目用来设置 Internal PLL 电压，让 K 型号的处理器能获得最大的超频性能。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

CPU bus speed : DRAM speed ratio mode [Auto]

本项目用来将 CPU 总线速度设置为 DRAM 速度倍频模式。

[Auto] DRAM 速度设置为最佳化设置值。

[100：100] CPU 总线速度到 DRAM 速度倍频设置为 100：100。

[100：133] CPU 总线速度到 DRAM 速度倍频设置为 100：133。

Memory Frequency [Auto]

本项目可让您设置内存的运行频率。设置选项会随着 BCLK/PCIE Frequency 设置值变动。

Xtreme Tweaking [Disabled]

本项目会增强部分测试性能。设置值有：Enabled] [Disabled]

CPU Graphics Max. Ratio [Auto]

提供您自动最佳化 CPU Graphics Ratio 或以手动方式输入一个最佳的 CPU Graphics Ratio 数值。您可以使用 <+> 或 <-> 键可以调整 CPU 图形倍频，最小的数值会依照所安装的处理器而定。

CPU Level Up [Auto]

提供您选择 CPU 层级，且这个可选择的参数会依照所选择的 CPU level 而有自动调整。设置值有：[Auto] [4.600G] [4.400G] [4.200G]

EPU Power Saving Mode [Disabled]

启用或关闭 EPU 省电功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control

本菜单中的项目可让您设置 DRAM timing 控制功能，您可以使用 <+> 与 <-> 键调整数值。当您要恢复默认值时，请使用键盘输入 <auto> 并按下 <Enter> 键。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]

DRAM COMMAND Rate [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [3]

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM REF Cycle Time [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [511]

DRAM Refresh Interval [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [65535]

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [16]

DRAM READ to PRE Time [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [255]

DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM CKE Minimum pulse width [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

DRAM CAS# Write to Latency [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [31]

RTL IOL control

DRAM RTL Initial Value [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM RTL (CHA_R0D0) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM RTL (CHA_R0D1) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM RTL (CHA_R1D0) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM RTL (CHA_R1D1) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM RTL (CHB_R0D0) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM RTL (CHB_R0D1) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM RTL (CHB_R1D0) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]

DRAM RTL (CHB_R1D1) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]
DRAM IO-L (CHA_R0D0) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]
DRAM IO-L (CHA_R0D1) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]
DRAM IO-L (CHA_R1D0 [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]
DRAM IO-L (CHA_R1D1 [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]
DRAM IO-L (CHB_R0D0 [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]
DRAM IO-L (CHB_R0D1) [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]
DRAM IO-L (CHB_R1D0 [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]
DRAM IO-L (CHB_R1D1 [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

Third Timings

tRDRD [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [7]

tRDRD_dr [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

tRDRD_dd [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

tWRRD [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [63]

tWRRD_dr [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

tWRRD_dd [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

tWRWR [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [7]

tWRWR_dr [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

tWRWR_dd [Auto]
设置值有：[Auto] [1] - [15]

Dec_WRD
设置值有：[Auto] [0] - [1]

tRDWR [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

tRDWR_dr [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

tRDWR_dd [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

MISC

MRC Fast Boot [Auto]

提供您设置 MRC 快速启动模式为自动、启用或关闭。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

DRAM CLK Period [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [14]

Channel A DIMM Control [Enable Bot...]

提供您启用或关闭 Channel A 内存插槽采用以下的设置值：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Channel B DIMM Control [Enable Bot...]

提供您启用或关闭 Channel B 内存插槽采用以下的设置值：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Scrambler Setting [Optimized ...]

设置本选项为 [Optimized (ASUS)] 以增强系统稳定性。设置值有：[Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]

DQ Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] - [-16]

DQS Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] - [-16]

CMD Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] - [-16]

GPU.DIMM Post

本项目自动检测和显示安装的 PCIe 设备与内存状态。若该字段显示为 N/A，则表示该插槽并未安装此设备。

DIGI+ Power Control

CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根据 Intel 所订立之 VRM 规格，其设置值将影响 CPU 电压。CPU 运行电压将依 CPU 的负载呈比例性递减，当您将此项目的设置值设置越高时，将可提高电压值与超频能力，但会增加 CPU 及 VRM 的温度。

请从 Level 1 至 Level 8 来调整处理器电源电压从 0% 至 100%。

- 实际提升的性能将视 CPU 型号而异。
- 请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

CPU Voltage Frequency [Auto]

切换频率将影响 VRM 输出电压的暂态响应和元件的散热性。设置较高的频率可获得较快的电压暂态响应。设置值有：[Auto] [Manual]

当本项目设置为 [Manual] 模式时，请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

以下项目只有在 CPU Voltage Frequency 设置为 [Auto] 时才会出现。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

本项目可让您启动 VRM Spread Spectrum 项目以增加系统稳定性。设置值有：[Enable] [Disable]。

Active Frequency Mode [Disabled]

本项目可让您启动 Active Frequency Mode 项目以增强省电性能。设置值有：[Enable] [Disable]。

以下项目只有在 CPU Voltage Frequency 设置为 [Manual] 时才会出现。

CPU Fixed Frequency [XXX]

请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。数值以 10k Hz 为间隔，更改的范围由 300k Hz 至 500k Hz。

VCCIN MOS Volt Control [Auto]

此为设置 VCCIN Rail 上 MOSFET 的驱动电压。设置值有：[Auto] [Manual] [Active VGD]

CPU Power Phase Control [Auto]

相数切换代表 VRM 有几相供应 CPU 所需电源。在系统高负载时，可增加电源相数以提升 VRM 输出电压的暂态响应并可得到更好的散热性能。在系统低负载时，通过减少电源相数可增加 VRM 电源性能。

[Standard]	根据 CPU 自身的参数设置以决定电源相数
[Optimized]	使用华硕最佳化参数设置。
[Extreme]	全相数电源模式。
[Manual Adjustment]	提供手动方式调整较高的相式响应以增加系统性能，或是较慢的相式响应以增加内存效率。

当本项目设置为 [Extreme] 和 [Manual Adjustment] 模式时请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

以下项目只有在 CPU Power Phase Control 设置为 [Manual Adjustment] 时才会出现。

Manual Adjustment [Fast]

本项目为 CPU 设置较快的相式响应以增进系统性能，或较低的相式响应来降低 DRAM 电力性能。设置值有：[Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

DIGI+ VRM Duty control 用来调整每个元件相数的电流与散热环境。

[T.Probe]	维持各相散热平衡。
[Extreme]	维持各相电流平衡。

请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

CPU Current Capability [Auto]

本项目用来设置 DIGI+ VRM Current Capability 总电力范围，同时扩展超频频率的范围。设置值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。

当系统超频，或是在较高负载的 CPU 要获得额外的电力支持时，请选择较高的数值。

CPU Power Thermal Control [130]

较高的温度带给 CPU 电力更大的散热范围，并扩展超频容忍度来增加超频的潜力。使用 <+> 与 <-> 键调整数值，更改的范围从 130 至 151。

请勿将散热系统移除，且散热环境需受到监控。

CPU Input Boot Voltage [Auto]

VCCIN 为 CPU 启动权。设置值有：[Auto] [0.800] - [2.440V]

DRAM Current Capability [100%]

较高的数值提供更大的总电力范围，同时扩展超频频率的范围。设置值有：[100%] [110%] [120%] [130%]

DRAM Voltage Frequency [Auto]

本项目用来调整内存切换频率。指派固定的高内存频率来增加超频的范围，或低内存频率以获得较佳的系统稳定度。设置值有：[Auto] [Manual]

以下项目只有在 DRAM Voltage Frequency 设置为 [Manual] 时才会出现。

DRAM Fixed Frequency Mode [300]

本项目提供您设置一个固定较高的内存频率以增加超频范围，或较低的内存频率让系统有较佳的稳定性。设置值为以 10kHz 为间隔，设置的范围从 300kHz 至 500kHz。

DRAM Power Phase Control [Auto]

提供您设置 DRAM 的电源相式。

[Auto] 设置自动模式。

[Optimized] 设置华硕最佳化相数调整设置档。

[Extreme] 设置全相式模式。

Tweakers' Paradise

本子菜单里的项目为提供设置处理器的倍频与功能。

BCLK Tuning

VCCIN Shadow Voltage [Auto]

VCCIN 虚拟电压。设置值有：[Auto]［0.800］- ［2.440V］

Termination Anti-Aliasing [Auto]

设置 Termination Anti-Aliasing。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

Initial PLL Termination Voltage [Auto]

初始电压为 CPU BCLKs 终止。维持一个接近 CPU 输入电压等级将可以协助 BCLK 超频。设置值有：[Auto] [0.0000] - [3.0000]

PLL Termination Reset Voltage [Auto]

设置 PLL Termination Reset Voltage。设置值有：[Auto] [0.0000] - [3.0000]

Eventual PLL Termination Voltage [Auto]

设置最终的 PLL 终端电压。设置值有：[Auto] [0.0000] - [3.0000]

ICC Ringback Canceller [Auto]

设置 Termination Anti-Aliasing。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

Clock Crossing VBoot [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。设置值有：[Auto] [0.1000] - [1.9000]

Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。设置值有：[Auto] [0.1000] - [1.9000]

Clock Crossing Voltage [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。设置值有： [Auto] [0.1000] - [1.9000]

DMI Gen 2 [Auto]

提供您启用或关闭 DMI Gen 2。选择 [Auto] 表示启用。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

DMI De-emphasis Control [-6 dB]

设置在 DMI 上的 De-emphasis 控制。设置值有：[-6 dB] [-3.5 db]

PCIE Tuning

Internal Graphics [Auto]

根据设置选项保留 IGD 启用。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Power Management

这个子菜单为提供您设置处理器比率与频率。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

提供操作系统动态调整处理器电压与核心频率以降低耗电量与帮助散热。设置值有：[Enabled] [Disabled]

Turbo Mode [Enabled]

本项目提供您让处理器核心在特定情况下以比标示频率更快的速度运行。设置值有：[Disabled] [Enabled]

以下的项目只当将 Turbo Mode 设置为 [Enabled] 时才会显示。

Turbo Mode Parameters

Long Duration Package Power Limit [Auto]

提供您限制 Turbo Ratio 的持续时间超过 TDP（Thermal Design Power）以获得最大性能。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1W 到 4096W。

Package Power Time Window [Auto]

亦称为 Power Limit 1，并且提供您维持在 Turbo Ratio 上的 TDP（Thermal Design Power）时间窗口。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1 秒至 127 秒。

Short Duration Package Power Limit [Auto]

亦称为 Power Limit 2，当封包电源超过 Power Limit 1 时，提供您快速的防护。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1W 至 4096W。

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]

提供您设置一个较高的电流限值，以防止在超频时的频率和功率的限制。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值为以 0.125V 为间隔，更改的范围从 0.125 至 1023.875。

以下的项目只当将 Turbo Mode 设置为 [Disabled] 时才会显示。

CPU Internal Power Switching Frequency

Frequency Tuning Mode [Auto]

提供您增加或降低内部稳压器的开关频率。降低的话有助于消耗较少的功率，或增加则会有助于电压稳定。当本项目设为 [+] 或 [-] 时，会显示 Frequency Tuning Offset 项目，且提供您可设置其数值范围从 0% 至 6%。

CPU Internal Power Fault Control

Thermal Feedback [Auto]

当外部稳压器的散热条件超出门槛值时，允许处理器采取预防措施。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Integrated VR Fault Management [Auto]

当发生过电压时，提供您预防 Fully Integrated Voltage Regulator 的跳脱。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

当进行超频时，推荐您将本项设置为 [Disable]。

CPU Internal Power Configuration

CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]

当处理器处于低功率状态时，允许您提高电源省电。在 Fully Integrated Voltage Regulator 所有高性能运行下则禁用此项目。设置值有：[Auto] [High Performance] [Balanced]

Power Decay Mode [Auto]

提供您启用这个项目以改善 Fully Integrated Voltage Regulator 如处理器进入低电流状态。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

Idle Power-in Response [Auto]

提供您设置 Fully Integrated Voltage Regulator 为较慢的速率，如同进入手动操作模式。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]

Idle Power-out Response [Auto]

提供您设置 Fully Integrated Voltage Regulator 为较慢的速率，如同退出手动操作模式。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]

Power Current Slope [Auto]

提供您调整高速启动相位电流平衡在负载瞬变期间时的渐变，以消除电流的不平衡。此会导致从靠近开关频率的负载电流震荡。设置值有：[Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

Power Current Offset [Auto]

提供您增加或降低由处理器所检测到的输出电流。找到之间的平衡点，同时从以下选择保持最佳调节的电流门槛。设置值有：[Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

Power Fast Ramp Response [Auto]

提供您增加以加强在瞬间负载的电压调节器的响应。设置值有：[Auto] [0.00] - [1.50]

CPU Internal Power Saving Control

Power Saving Level 1 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，更改的范围从 0A 至 80A。

Power Saving Level 2 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，更改的范围从 0A 至 50A。

Power Saving Level 3 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，更改的范围从 0A 至 30A。

CPU Core Voltage [Auto]

本项用来设置处理器核心的电压源总量。当核心频率增加时请增加电压总量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.003125V 为间隔，更改的范围从 1.050000V 至 2.200000V。

CPU Core Voltage Override [Auto]

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Manual] 时才会出现。

Offset Mode Sign [+]

CPU Core Voltage Offset [Auto]

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Offset / Adaptive Mode] 时才会出现。

Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [Auto]

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Adaptive Mode] 时才会出现。

CPU Cache Voltage [Auto]

本项用来设置处理器核心的电压源总量。当核心频率增加时请增加电压总量。

CPU Graphics Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器绘图元件的电压源总量。当 iGPU 频率增加时请增加电压总量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 -0.999V 至 0.999V。

CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

本项目用来设置处理器系统代理的电压源总量，包括 PCIe 控制器和电源控制元件。当 DRAM 频率增加时请增加电压总量。使用 <+> 或 <-> 键来调整数值。

CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 -0.999V 至 0.999V。

CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

本项目用来设置处理器 I/O 类比部分的电压源总量。当 DRAM 频率增加时请增加电压总量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。

CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 -0.999V 至 0.999V。

CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

本项目用来设置处理器 I/O 数码部分的电压源总量。当 DRAM 频率增加时请增加电压总量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。

CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 -0.999V 至 0.999V。

以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Auto] 时才会出现。

SVID Support [Auto]

关闭 SVID 支持，可以中断处理器与外接电压调节器的连接。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

Initial CPU Input Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器的输入电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.800V 至 2.700V。

Eventual CPU Input Voltage [Auto]

本项目用来设置最终处理器的输入电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.800V 至 2.700V。

DRAM Voltage [Auto]

本项目可让您设置 DRAM 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 1.20V 至 2.4V。

PCH VLX Voltage [Auto]

本项目用来设置 PCH 的 I/O 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.8000V 至 2.0000V。

PCH Voltage [Auto]

本项目用来设置 Platform Controller Hub 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.7000V 至 1.8000V。

VTTDDR Voltage [Auto]

本项目可以让您设置 VTTDDR 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00625V 为间隔，更改的范围从 0.6000V 至 1.4000V。

DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

本项目可让您设置 DRAM 控制参考电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.0050x 为间隔，更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。不同比率将可提升 DRAM 的超频性能。

DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

本项目可让您设置在 A/B 通道的 DRAM 控制参考电压。设置值以 0.005x 为间隔，更改的范围从 0.3950x 至 0.6300x。不同比率将可提升 DRAM 的超频性能。

CPU Spread Spectrum [Auto]

[Auto] 自动调整设置值。

[Disabled] 提升 BCLK 的超频能力。

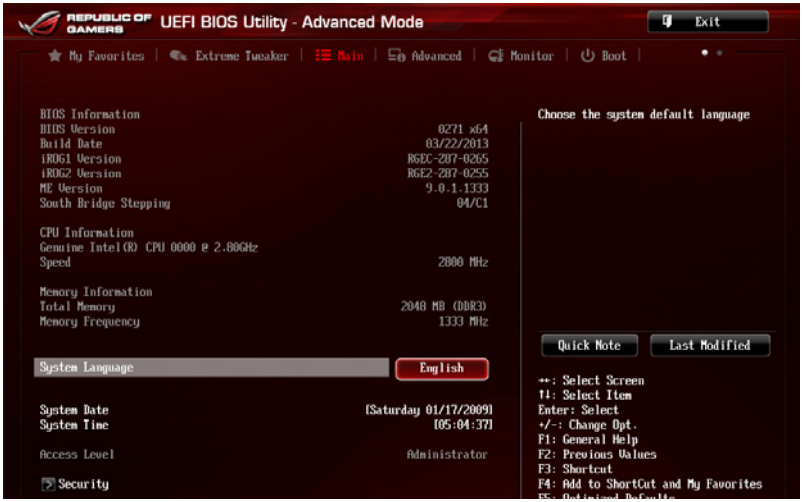
[Enabled] 由 EMI 控制。

BCLK Recovery [Enabled]

本项目用来还原 BCLK 参数。设置值有：[Enabled] [Disabled] [Ignore]

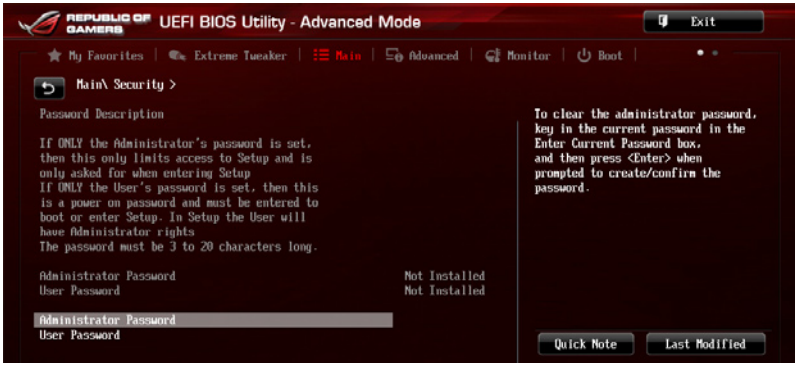
3.5 主菜单（Main Menu）

主菜单只有在您进入 Advanced Mode 时才会出现。您可以由主菜单查看系统基本数据，并设置系统日期、时间、语言和安全性。



安全性菜单（Security）

本菜单可以让您改变系统安全设置。



- 若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时钟（RTC）内存。请参考 1.2.6 主板上的内置开关 一节的说明。
- Administrator 或 User Password 项目默认值为 Not Installed，当您设置密码之后将显示为 Installed。

Administrator Password（设置系统管理员密码）

当您设置系统管理员密码后，推荐您先登入您的帐户，以免 BIOS 设置程序中的某些信息无法查看或更改设置。

请依照以下步骤设置系统管理员密码（Administrator Password）：

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤更改系统管理员密码（Administrator Password）：

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除系统管理员密码时，请依照更改系统管理员密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除系统管理员密码后，Administrator Password 项目将显示为 Not Installed。

User Password（设置用户密码）

当您设置用户密码后，你必需登入您的帐户才能使用 BIOS 设置程序。用户密码的默认值为 Not Installed，当您设置密码后将显示 Installed。

请依照以下步骤设置用户密码（User Password）：

1. 请选择 User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤更改用户密码（User Password）：

1. 请选择 User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除用户密码时，请依照更改用户密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除用户密码后，User Password 项目将显示为 Not Installed。

3.6 高级菜单（Advanced menu）

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。

注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的数值将导致系统损毁。

3.6.1 处理器设置（CPU Configuration）

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与更改中央处理器的相关设置。

以下画面所显示项目可能会因您所安装处理器不同而有所差异。

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled]　　启动 CPU 散热监控功能帮助散热。

[Disabled]　　关闭 CPU 散热监控功能。

Hyper-threading [Enabled]

本项目只当安装支持此技术的处理器时，才会显示。Intel 超线程技术（Intel® Hyper-Threading Technology）能让单颗处理器同时拥有两条运行绪以处理数据，让操作系统能安排两个运行绪或进程同时进行。

[Enabled]　　启动两条运行绪处理核心。

[Disabled]　　使用单一运行绪处理核心。

Active Processor Cores [All]

本项可以让您设置在每个处理封包中启用的处理器核心数量。设置值有：[All] [1] [2] [3]

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Disabled]　　关闭此功能。

[Enabled]　　本项目可以让系统无处理器 CPUID 功能支持时亦可正常启动。

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] 启动 No-Excution Page Protection 技术。

[Disabled] 强迫 XD 功能总是降低至 0。

Intel® Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] 启动 Intel 虚拟技术（Virtualization Technology）让硬件平台可以同时运行多个操作系统，将一个系统平台虚拟为多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

Hardware Prefetcher

[Enabled] 本项目可以让硬件平台独立和同步运行多重操作系统。

[Disabled] 关闭此功能。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled] 本项目可以让硬件平台运行 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。

[Disabled] 关闭此功能。

Boot Performance Mode [Max Non-Tu...]

本项目用来让您在操作系统切换前选择 BIOS 设置的性能状态。设置值有：[Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]。

Dynamic Storage Accelerator [Disabled]

本项目可以让您启动或关闭 C state 的 Dynamic Storage Accelerator 功能。

设置值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU Power Management Configuration

本项目用来管理与设置 CPU 电力。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

本项目为启动或关闭 Intel EIST 技术（Enhanced Intel® SpeedStep Technology）。

[Disabled] 处理器会以默认速度运行。

[Enabled] 处理器的速度则由操作系统控制。

Turbo Mode [Enabled]

本项目用来设置处理器在特定情况下以比标示频率更快的速度运行。设置值有：[Enabled] [Disabled]

CPU C States [Auto]

本项可让您启动或关闭 CPU C states。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

以下项目只有在 CPU C States 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Enhanced C1 state [Enabled]

本项目可以让处理器在闲置时降低电力消耗。

设置值有：[Enabled] [Disabled]

CPU C3 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C3 报告给操作系统。

设置值有：[Enabled] [Disabled]

CPU C6 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C6 报告给操作系统。

设置值有：[Enabled] [Disabled]

C6 Latency [Short]

本项目可以让您设置 C6 state 的 C6 延迟期间。

设置值有：[Short] [Long]

CPU C7 Report [CPU C7s]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C7 报告给操作系统。

设置值有：[Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

C7 Latency [Long]

本项目可以让您设置 C7 state 的 C7 延迟期间。

设置值有：[Short] [Long]

Package C State Support [Auto]

本项目用来启动或关闭 CPU C State 支持功能。设置值有：[Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

3.6.2 PCH 设置（PCH Configuration）

PCI Express Configuration

本项目用来管理与设置 PCI Express 插槽。

DMI Link ASPM Control [Auto]

本项目用来设置 DMI Link 上北桥与南桥的 ASPM（Active State Power Management）功能。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

ASPM Support [Disabled]

本项目为设置 ASPM 层级。设置值有：[Disabled] [Auto] [L0s] [L1] [L0sL1]

PCIe Speed [Auto]

本项目用来设置 PCI Express 接口速度。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2]

Intel(R) Rapid Start Technology [Disbled]

本项目用来启动或关闭 Intel Rapid Start Technology 功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

以下项目只有在 Intel Rapid Start Technology 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

本项用来启动系统的实时钟（RTC）唤醒功能。设置值有：[Disable] [Enabled]

Entry After [0]

本项目只当 Entry on S3 RTC Wake 设为 [Enabled] 时才会显示，这个项目提供您启用 S3 Entry 的系统实时钟（RTC）唤醒功能。数值的范围从 0（立即）至 120 分钟。

Active Page Threshold Support [Enabled]

本功能支持在小容量分区磁区中的 Intel® Rapid Start Technology 技术。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

请确认缓存磁区的容量大于整个内存的容量。

Active Memory Threshold [0]

本项目只当 Active Page Threshold Support 设置为 [Enabled] 时才会显示。输入另一个分区磁区的容量大小以供 Active Page Threshold 之用。

Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

本项用来启动或关闭 Hybrid Hard Disk 功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]

Intel(R) Smart Connect Technology

ISCT Support [Disabled]

本项目用来启动或关闭 Intel® Smart Connect Technology（ISCT）设置。设置值有：[Enabled] [Disabled]

3.6.3 SATA 设备设置（SATA Configuration）

当您进入 BIOS 设置程序时，BIOS 设置程序将自动检测已安装的 SATA 设备。当未侦侧到 SATA 设备时将显示 Not Present。

SATA Mode Selection [AHCI]

本项目可设置 Serial ATA 硬件设备的相关设置。

[Disabled] 关闭 SATA 功能。

[IDE] 若要将 Serial ATA 作为 Parallel ATA 实体存储接口，请将本项目设置为 [IDE]。

[AHCI] 若要 Serial ATA 硬件设备使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，请将本项目设置为 [AHCI]。AHCI 模式可让内置的存储设备启动高级的 Serial ATA 功能，通过原生命令排序技术来提升工作性能。

[RAID] 若要在 Serial ATA 硬盘设置 RAID 磁盘数组，请将本项目设置为 [RAID]。

Aggressive LPM Support [Auto]

本项为启动 PCH 强制进入链接电源状态。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

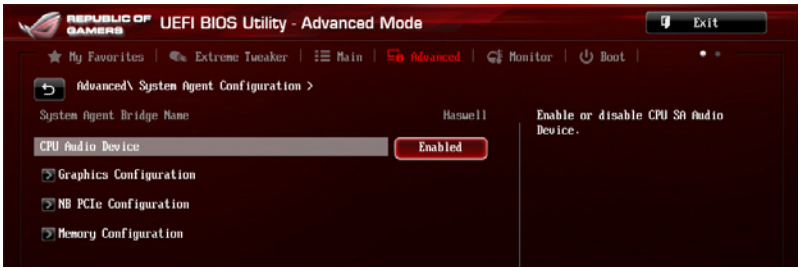
S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

S.M.A.R.T.（自动检测、分析、报告技术，Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology）是一个监控软件，可以监控您的硬盘，并在发生错误时于开机自检（POST）时显示错误信息。设置值有：[Enabled] [Disabled]

Hot Plug [Disabled]（SATA6G_1 - SATA6G_6 [红色]）

这些项目只有在 SATA mode 设置为 [AHC] 或 [RAID] 模式时才会出现，用来启动或关闭支持 SATA 热插拔功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

3.6.4 系统代理设置（System Agent Configuration）



CPU Audio Devices [Enabled]

本项目用来启动或关闭 CPU SA Audio 设备。devices.

设置值有：[Enabled] [Disabled]

Graphics Configuration

本项目用来选择以 iGPU 或 PCIe 显示设备作为优先使用的显示设备。

Primary Display [Auto]

本项目用来选择以 iGPU 或 PCIe 显示设备作为优先使用的显示设备。设置值有：[Auto] [iGPU] [PCIE]

iGPU Memory [Auto]

本项用来选择由 iGPU 指派给 DVMT 5.0 的系统内存总量。设置值有：[Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M] [320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M] [1024M]

Render Standby [Auto]

本项目用来启动 Intel® Graphics Render Standby 功能来支持系统闲置时降低 iGPU 电力的消耗。设置值有：Configuration options: [Auto] [Disabled] [Enabled]

iGPU Multi-Monitor [Disabled]

本项用来启动 iGPU Muiti-Monitor 功能。iGPU 共享系统内存固定为 64MB。设置值有：[Disabled] [Enabled]

NB PCIe Configuration

本项目用来设置 NB PCI Express 设置值。

PCIEx16_1/2 Link Speed [Auto]

本项目用来设置 PCIEX16 速度。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

DMI Link ASPM Control [Auto]

本项目用来设置 DMI Link 的 ASPM（Active State Power Management）功能。设置值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

PEG - ASPM [Disabled]

本项目用来设置 PEG 设备的 ASPM 支持。设置值有：[Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

Memory Configuration

本项目用来设置内存设置参数。

Memory Scrambler [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Memory Scrambler 支持。

设置值有：[Enabled] [Disabled]

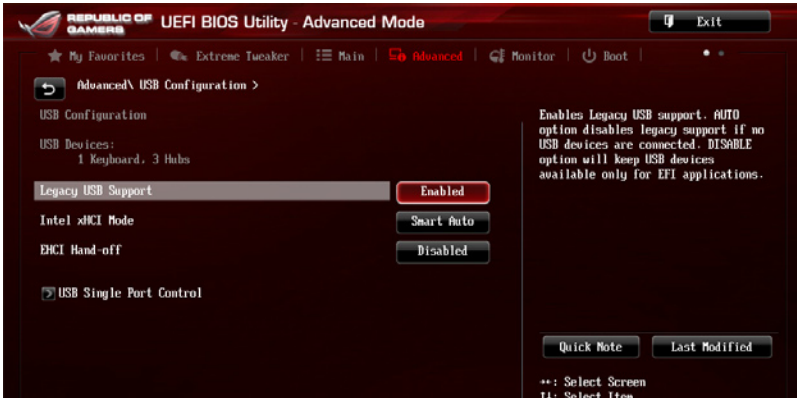
Memory Remap [Enabled]

本项目用来启动 remapping the memory above 4GB.

设置值有：[Enabled] [Disabled]

3.6.5 USB 设备设置（USB Configuration）

本菜单可以让您更改 USB 设备的各项相关设置。



在 USB Devices 项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示 None。

Legacy USB Support [Enabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 启动在一般常规操作系统中支持 USB 设备功能。

[Auto] 系统可以在启动时便自动检测是否有 USB 设备存在，若是，则启动 USB 控制器；反之则不会启动。

Intel xHCI Mode [Smart Auto]

[Auto] 启动 xHCI 控制器的运行。

[Smart Auto] 在启动时维持前一次 xHCI 控制器的运行状态。

[Enabled] 启用本功能。

[Disabled] 关闭本功能。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] 启动支持没有 EHCI hand-off 功能的操作系统。

[Disabled] 关闭本功能。

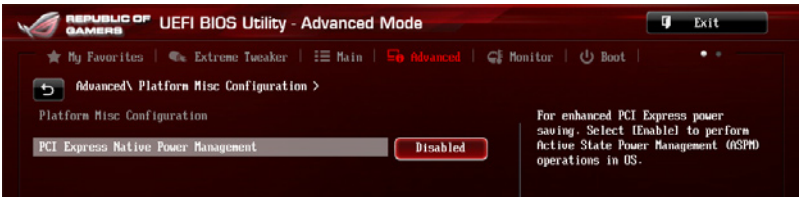
USB Single Port Control

本项目用来启动或关闭个别 USB 接口。

USB 接口的位置请参考 1.2.2 主板结构图 的说明。

3.6.6 平台各项设置（Platform Misc Configuration）

本菜单可让您更改平台相关的各项设置。



PCI Express Native Power Management [Disabled]

本项目用来设置 PCI Express 的省电功能及操作系统的 ASPM 功能。

设置值有：[Disabled] [Enabled]

以下项目只有在 PCI Express Native Power Management 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Native ASPM [Disabled]

[Enabled]　由 Vista 控制设备的 ASPM 支持。

[Disabled]　由 BIOS 控制设备的 ASPM 支持。

第三章

3.6.7 内置设备设置（OnBoard Devices Configuration）

往下滚动可以看到更多的 BIOS 项目。

HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled]　　启动高保真音频控制器。

[Disabled]　　关闭这个控制器。

以下选项只有在 HD Audio Controller 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Front Panel Type [HD]

本项目可以让您依照前面板音频接口的支持功能，将前面板音频接口（AAFP）模式设置为 legacy AC’97 或是高保真音频。

[HD]　　将前面板音频接口（AAFP）模式设置为高保真音频。

[AC97]　　将前面板音频接口（AAFP）模式设置为 legacy AC’97。

SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF]　　设置为 SPDIF 输出。

[HDMI]　　设置为 HDMI 输出。

ASM1061 Storage Controller SATA6G_E12 [Enabled]

本项目用来选择 ASM1061 存储控制器的运行模式。

[Disabled] 关闭此控制器。

[Enabled] 启动这个控制器。

Hot-plug [Disabled]

[Disabled] 关闭支持热插拔。

[Enabled] 启用支持热插拔。

Intel LAN Controller [Enabled]

[Enabled] 启动 GbE 控制器。

[Disabled] 关闭此控制器。

以下项目只有在 Intel LAN Controller 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Intel PXE OPROM [Disabled]

本项目只有在前一项目设置为 [Enabled] 时才会出现，可让您开启或关闭 Intel 网络控制器的 PXE OptionRom。设置值有：[Enabled] [Disabled]

3.6.8 高级电源管理设置（APM Configuration）

ErP Ready [Disabled]

在 S5 休眠模式下关闭某些电源，减少待机模式下电力的流失，以符合欧盟能源使用产品（Energy Related Product）的规范。网络唤醒功能（WOL）、USB 唤醒功能、音频，及主板上 LED 指示灯的电源将会关闭，您可能无法使用网络功能、USB 唤醒功能及音频提醒等。设置值有：[Disabled] [Enabled (S4+S5] [Enabled (S5)]

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] 系统在电源中断之后重新开启。

[Power Off] 系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。

[Last State] 将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] 关闭使用 PS/2 键盘启动功能。

[Space Bar] 启动使用 PS/2 键盘上的空白键启动功能。

[Ctrl-Esc] 启动使用 PS/2 键盘上的 Ctrl 及 Esc 键启动之功能。

[Power Key] 启动使用 PS/2 键盘上的电源键启动之功能。要使用本功能，ATX 电源（PSU）必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。

Power On By PCIE/PCI [Disabled]

[Disabled] 关闭 PCIE/PCI 设备的唤醒功能。

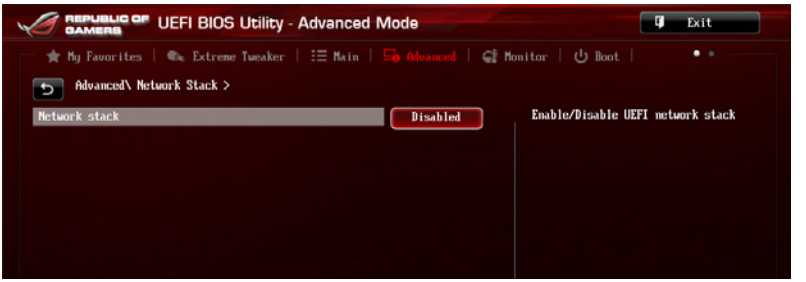
[Enabled] 启动 PCIE/PCI 设备的唤醒功能。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 关闭实时时钟（RTC）唤醒功能。

[Enabled] 当您设为 [Enabled] 时，将出现 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 与 RTC Alarm Second 子项目，您可自行设置时间让系统自动启动。

3.6.9 网络协议堆栈（Network Stack）


UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Extreme Tweaker | Main | Advanced | Monitor | Boot
Advanced\ Network Stack >
Network stack
Disabled
Enable/Disable UEFI network stack

Network Stack [Disable Link]

本项目用来启动或关闭 UEFI 网络协议堆栈（network stack）功能。设置值有：[Disable Link] [Enable] 。

以下的项目只当您将 Network Stack 设置为 [Enabled] 时，才会显示。

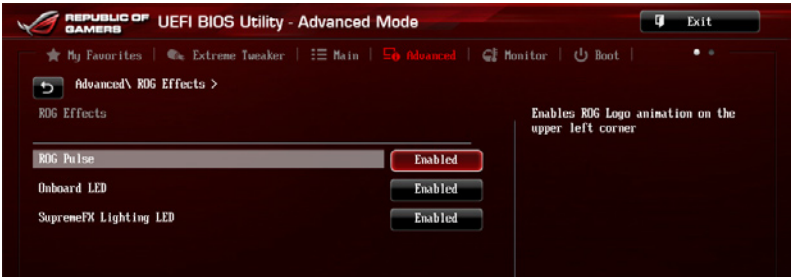
Ipv4 PXE Support [Enable]

本项目为启用或关闭 Ipv4 PXE 支持功能。设置值有：[Disable Link] [Enabled]

Ipv6 PXE Support [Enable]

本项目为启用或关闭 Ipv6 PXE 支持功能。设置值有：[Disable Link] [Enabled]

3.6.10 ROG Effects



ROG Pulse [Enabled]

本项目提供您启用或关闭屏幕左上方的动画。设置值有：[Enable] [Disabled]

Onboard LED [Enabled]

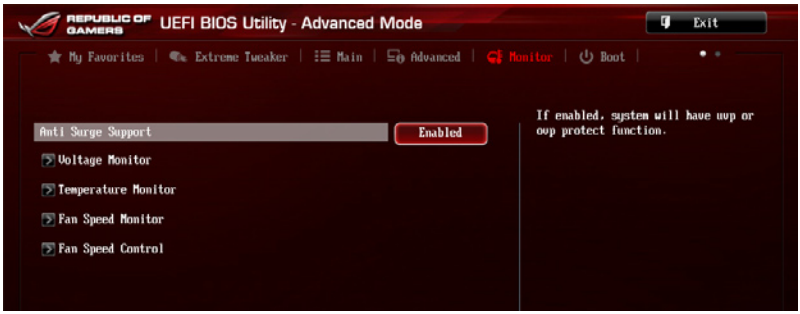
本项目提供您启用或关闭主板内置的指示灯。设置值有：[Disable Link] [Enable]

SupremeFX Lighting LED [Enabled]

本项目提供您启用 SupremeFX Lighting 指示灯。设置值有：[Enabled] [Disabled]

3.7 监控菜单（Monitor menu）

监控菜单可让您查看系统温度/电力状况，并且对风扇做高级设置。



Anti Surge Support [Enabled]

本项目为启用或关闭 Anti Surge 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Voltage Monitor

CPU Core 0-3 Voltage; CPU Cache Voltage; CPU System Agent Voltage; CPU Analog I/O Voltage; CPU Digital I/O Voltage; CPU Input Voltage; DRAM Voltage; PCH Voltage; 3.3V Voltage; 5V Voltage; 12V Voltage

这些内置的硬件监控功能，会自动检测经由内置电压调节所输出的电压值。如果风扇并未连接至主板，本项目会显示 N/A。若是您不想显示检测这个项目，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignore]。

Temperature Monitor

CPU Temperature; MB Temperature [xxx℃/xxx℉]

本系列主板具备了中央处理器、主板的温度探测器，可自动检测并显示当前的温度。若您不想要显示检测的温度，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignored]。

Fan Speed Monitor

CPU FAN Speed; CPU OPT Speed; Chassis FAN1/2/3 Speed

为了避免系统因为过热而造成损坏，本系列主板备有中央处理器风扇的转速 RPM（Rotations Per Minute）监控，所有的风扇都设置了转速安全范围，一旦风扇转速低于安全范围，华硕智能型主板就会发出警讯，通知用户注意。若没有安装至主板，则会显示 [N/A]。若您不想显示该项检测的温度值，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignore]。

Fan Speed Control

CPU Q-Fan Control [Auto]

本项目用来设置 CPU Q-Fan 运行模式。

[Disabled] 关闭 CPU Q-Fan 控制功能。

[Auto] 在 PWM 模式启动 CPU Q-Fan 控制来使用 4-pin 处理器风扇。

[Advance Mode] 检测安装的处理器风扇类型并自动切换控制模式。当安装 3-pin 的处理器风扇时，请选择本项目来使用 Q-Fan 控制的 DC 模式。

以下的项目只有在 CPU Q-Fan Control 设为 [Advance Mode] 与 [Auto] 时才会出现。

CPU Fan Speed Low Limit [600 RPM]

本项为设置当 CPU 风扇低于所选择的转速时，系统会发送警告信息通知。设置值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

本项目只有在 CPU Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现，用来设置处理器风扇适当的性能。

[Standard] 设为 [Standard] 让处理器风扇根据处理器的温度自动调整。

[Silent] 设为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。

[Turbo] 设为 [Turbo] 来获得处理器风扇的最大转速。

[Manual] 设为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。

以下的项目只有当您将 CPU Fan Profile 设为 [Manual] 时才会出现。

CPU Upper Temperature [70]

请使用 <+> 与 <-> 键调整处理器温度的数值。数值的更改范围由 20℃ 至 75℃。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

请使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最大工作周期。数值的更改范围由 20% 至 100%。当处理器温度达最大值时，处理器风扇将以最大工作周期运行。

CPU Lower Temperature [20]

显示处理器温度的最小值。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [40]

请用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最小工作周期。数值的更改范围由 20% 至 100%。当处理器温度低于 40℃ 时，处理器风扇将以最小工作周期运行。

Chassis1/Chassis2/Chassis3 Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled]　关闭机箱 Q-Fan 控制功能。

[Enabled]　启动机箱 Q-Fan 控制功能。

Chassis1/Chassis2/Chassis3 Fan Speed Low Limit [600 RPM]

本项目只有在 Chassis Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现。本项目可以让您设置 CPU Q-Fan Control 的功能及机箱风扇速度。设置值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

以下的项目只有当您将 Chassis1/Chassis2/Chassis3 Q-Fan Control 设为 [Enabled] 时才会出现。

Chassis1/Chassis2/Chassis3 Fan Profile [Standard]

本项目只有在 Chassis Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现，用来设置机箱风扇适当的性能。

[Standard]　设置为 [Standard] 让机箱风扇根据处理器的温度自动调整。

[Silent]　设为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。

[Turbo]　设置为 [Turbo] 来获得机箱风扇的最大转速。

[Manual]　设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。

以下的项目只有当您将 Chassis1/Chassis2/Chassis3 Fan Profile 设为 [Manual] 时才会出现。

Chassis1/Chassis2/Chassis3 Upper Temperature [70]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱温度的数值。数值的更改范围由 40℃ 至 75℃。

Chassis1/Chassis2/Chassis3 Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最大工作周期。数值的更改范围由 60% 至 100%。当机箱温度达最大值时，机箱风扇将以最大工作周期运行。

Chassis1/Chassis2/Chassis3 Lower Temperature [40]

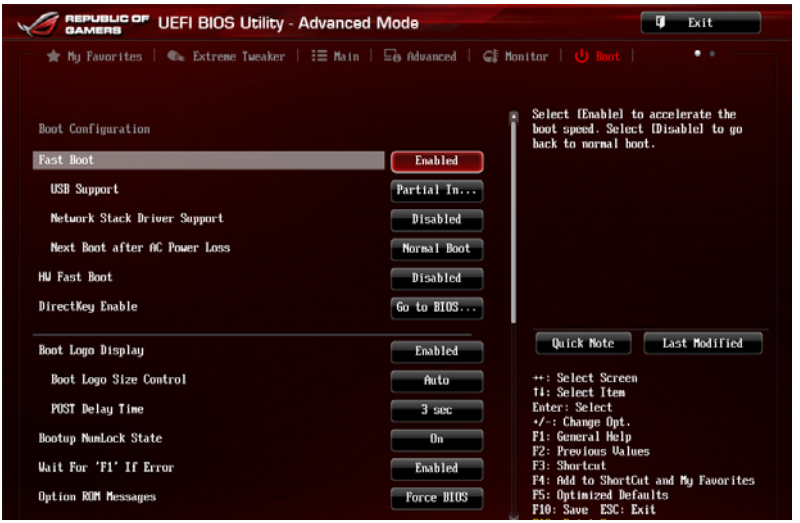
显示机箱温度的最小值。

Chassis1/Chassis2/Chassis3 Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

请用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最小工作周期。数值的更改范围由 0% 至 100%。当机箱温度低于 40℃ 时，机箱风扇将以最小工作周期运行。

3.8 启动菜单（Boot menu）

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

[Disabled]　使系统使用正常启动速度。

[Enabled]　加速系统启动速度。

以下的项目只有当您将 Fast Boot 设为 [Enabled] 时才会出现。

SATA Support [All Sata D...]

USB Support [Partial In...]

[Disabled]　所有 USB 设备直到操作系统开启后才可使用。

[Full Initialization]　所有 USB 设备在操作系统环境及 POST 时均可使用。

[Partial Initialization]　在操作系统开启前只可使用 USB 键盘与鼠标。

P/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]

提供您关闭或让 PS/2 设备在 POST（开机自检）时使用完整的系统控制。

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled]　在 POST 时略过载入网络协议堆栈驱动器。

[Enabled]　在 POST 时载入网络协议堆栈驱动器。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot] 在电源中断后恢复至正常启动速度。

[Fast Boot] 在电源中断后加快启动速度。

HW Fast Boot [Disabled]

本项目用来启动或关闭 HW Fast Boot。

设置值有：[Disabled] [Enabled]。

DirectKey Enable [Go to BIOS...]

[Disabled] 关闭 DirectKey 键功能，当按下 DirectKey 键时系统只会启动或关机。

[Enabled] 当按下 DirectKey 键时系统会启动并直接进入 BIOS。

Boot Logo Display [Auto]

[Disabled] 关闭全屏幕个人化启动画面功能。

[Enabled] 启动全屏幕个人化启动画面功能。

如果您欲使用华硕 MyLogo2™ 功能，请务必将 Boot Logo Display 项目设置为 [Enabled]。

Post Report [5 sec]

本项目可以让您选择 post report 的等候时间。您可以在正常启动下只运行 POST 延后。数值的更改范围由 0 秒至 10 秒。

以下的项目只当 Boot Logo Display 设置为 [Auto] 或 [Full Screen] 时才会显示。

Post Delay Time [3 sec]

本项目可以让您选择 POST 的等候时间。数值的更改范围为 0 至 10秒。

本功能只支持正常启动时使用。

Bootup NumLock State [On]

[Off] 设置启动时 NumLock 键自动关闭。

[On] 设置启动时 NumLock 键自动开启。

Wait For ‘F1’ If Error [Enabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 系统在启动过程出现错误信息时，将会等待您按下 <F1> 键确认才会继续进行启动程序。

Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] 选购设备固件程序信息会强制在启动显示。

[Keep Current] 选购设备固件程序信息只有在该程序供应商设置为显示时，才会在启动时显示。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

本项目用来使用随选内存（ROM）限制中断 19。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Setup Mode [Advanced Mode]

[Advanced Mode] 将 Advanced Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

[EZ Mode] 将 EZ Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

CSM (Compatibility Support Module)

本项目用来设置 CSM 项目以增加对 VGA、启动设备和及其他设备的兼容性。

Launch CSM [Enabled]

[Auto] 系统将自动检测启动设备和及其他设备。

[Enabled] 启动 CSM 以支持 non-UEFI 设备或 Windows® UEFI 模式。

[Disabled] 关闭此功能。

以下的项目只有当您将 Launch CSM 设为 [Enabled] 时才会出现。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

本项目用来设置启动设备的类型。设置值有：[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来设置想要运行的网络设备。设置值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来设置想要运行的存储设备。设置值有：[Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

本项目用来设置想要运行的 PCIe/PCI 扩展设备。设置值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

Secure Boot

本项用来设置并管理 Windows® Secure Boot，以提升系统在 POST 时的安全性。

OS Type [Windows UEFI mode]

[Windows UEFI Mode]	可以让您选择要运行 Microsoft® Secure Boot 的操作系统。当启动 Windows® UEFI 模式或其他 Microsoft® Secure Boot 兼容操作系统时请选择此项目。
[Other OS]	当运行 Windows® non-UEFI 模式，或是 Windows® Vista/ Windows® XP 等不兼容于 Microsoft® Secure Boot 的操作系统时运行最佳化功能。Microsoft® Secure Boot 只支持 Windows® UEFI 模式。

以下项目只当 OS Type 设置为 [Windows UEFI mode] 时，才会出现。

Key Management

本项目只有当您将 Secure Boot 设为 [Windows UEFI mode] 时才会出现。可以让您管理 Secure Boot 的金钥。

Clear Secure Boot Keys

本项目用来载入默认的 Security Boot 金钥，包括 Platform key（PK）、Key-exchange Key（KEK）、Signature database（db）和 Revoked Signatures（dbx）。当载入默认的 Secure boot 金钥后，PK 状态会变为载入模式。

Save Secure Boot Keys

本项目用来将 PK（Platform Keys）存储至 USB 存储设备。

PK Management

Platform Key（PK）锁定并保护固件遭到未授权的更改。在进入操作系统前将需先验证 PK。

Delete PK

本项用来删除系统中的 PK，当 PK 删除后即无法使用 Secure Boot 金钥。

设置值有：[Yes] [No]。

Load PK from File

本项目用来设置由 USB 存储设备载入 PK。

PK 文件须为 UEFI 变数格式。

KEK Management

KEK（Key-exchange Key 或 Key Enrollment Key）用来管理 db 和 dbx。

Key-exchange Key（KEK）为 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key（KEK）。

Delete the KEK

本项目用来删除系统中的 KEK。

设置值有：[Yes] [No]。

Load KEK from File

本项目用来设置由 USB 存储设备下载 KEK。

Append KEK from File

本项目用来设置由存储设备下载其他 KEK 以管理 db 和 dbx。

KEK 文件须为 UEFI 变数格式。

DB Management

db（Authorized Signature database）包含授权认证和数码签章等，可载入后运行。

Delete the db

本项目用来删除系统中的 db 文件。

设置值有：[Yes] [No]。

Load db from File

本项目用来设置由 USB 存储设备下载 db 文件。

Append db from file

本项目用来设置由存储设备下载其他 db 文件以提升安全性。

db 文件须为 UEFI 变数格式。

DBX Management

dbx（Revoked Signature database）包含禁止使用的授权认证和数码签章等，不被允许载入或运行。

Delete the dbx

本项目用来删除系统中的 dbx 文件。

Load dbx from File

本项目用来设置由 USB 存储设备下载 dbx 文件。

设置值有：[Yes] [No]。

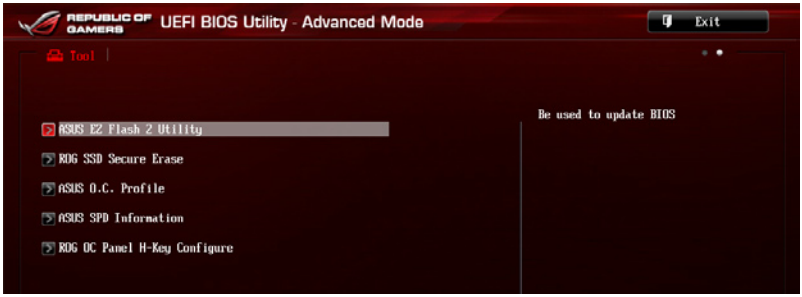
Append dbx from File

本项目用来设置由存储设备下载其他 dbx 文件以提升安全性。

dbx 文件须为 UEFI 变数格式。

3.9 工具菜单（Tool menu）

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



3.9.1 ASUS EZ Flash 2

本项目可以让您启动华硕 EZ Flash 2 程序，按下 <Enter> 会出现再次确认的窗口，请使用左右键选择 [Yes] 或 [No]，接着按下 <Enter> 确认。

请参考 3.11.2 华硕 EZ Flash 2 的说明。

3.9.2 ROG Secure Erase（ROG 安全清除）

随着使用的时间，存储在 SSD 里的文件数据可能会导致速度变慢，因此进行完整的 Secure Erase（安全清除）和安全清理您的 SSD，可以恢复到出厂时的性能水准。

Secure Erase 功能只在 AHCI 模式下使用，请先确认将 SATA 模式设置为 AHCI。点击 Advanced > SATA Configuration > AHCI 进行设置。

要启用 ROG SSD Secure Erase，请点击 Advanced 菜单下的 Tool > ROG SSD Secure Erase 以进行开启。

请上网至华硕支持网站以查看完整的 SSD 支持 Secure Erase 的测试列表。若您使用不兼容的 SSD 运行 Secure Erase 则可能会造成系统不稳定。

- 运行时视 SSD 的容量大小而需等候一段时间来进行清除，在进行的过程中请勿关闭系统。
- Secure Erase 功能只支持 Intel SATA 接口，如欲了解更多关于 Intel SATA 接口的信息，请参考本手册 1.2.2 一节的说明。.

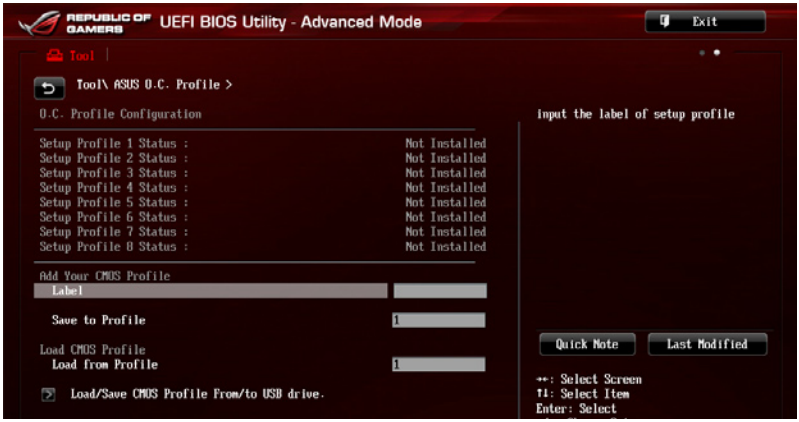
状态定义：:

Frozen（冻结）：这个状态为 BIOS 的保护措施， BIOS 守卫在启动前冻结没有密码保护的驱动程序。如果驱动程序被冻结，则必须关机或必须将电脑用 Secure Erase. 运行硬件重置。

Locked（锁定）：若 Secure Erase 运行不完整或已经停止，SSD 可能被锁住。这可能需要使用由华硕定义的第三方不同密码。您必须在使用 Secure Erase 前，先使用软件将 SSD 解锁。

3.9.3 ASUS O.C. Profile

本菜单可以让您存储或载入 BIOS 设置。


REPUBLIC OF GAMERS
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
Tool
Tool\ ASUS O.C. Profile >
O.C. Profile Configuration
Input the label of setup profile
Setup Profile 1 Status : Not Installed
Setup Profile 2 Status : Not Installed
Setup Profile 3 Status : Not Installed
Setup Profile 4 Status : Not Installed
Setup Profile 5 Status : Not Installed
Setup Profile 6 Status : Not Installed
Setup Profile 7 Status : Not Installed
Setup Profile 8 Status : Not Installed
Add Your CMOS Profile
Label
Save to Profile
1
Load CMOS Profile
Load from Profile
1
Load/Save CMOS Profile From/to USB drive.
Quick Note
Last Modified
↔: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select

若您尚未存储新的 BIOS 文件时，O.C. Profile Configuration 项目将显示为 Not Installed。

Label

提供您输入 Label（标签）的设置文件。

Save to Profile

本项目可以让您存储当前的 BIOS 文件至 BIOS Flash 中，请输入您的文件名称，然后按下 <Enter> 键，接着选择 Yes。

Load from Profiles

本项目可以让您载入先前存储在 BIOS Flash 中的 BIOS 设置。请按下 <Enter> 键并 选择 Yes 来载入文件。

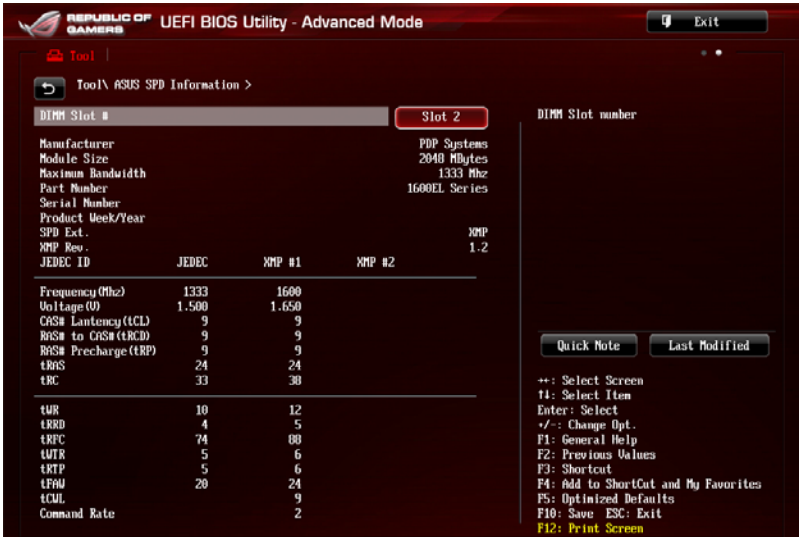
- 当进行 BIOS 升级时，请勿关闭或重新启动系统以免造成系统启动失败。
- 推荐您只在相同的内存/处理器设置与相同的 BIOS 版本状态下更新 BIOS 程序。

Load/Save CMOS Profile From/To USB drive

当点击或选定后，本项提供您从 USB 存储设备载入或存储 CMOS profiles 文件。.

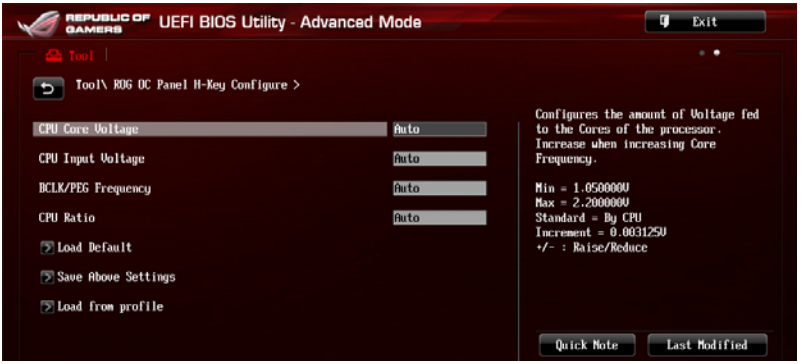
3.9.4 ASUS SPD Information

本菜单显存插槽的相关信息。



3.9.5 ROG OC Panel H-Key Configure

ROG OC Panel H-Key 提供您输入并存储 CPU input voltage、BCLK Frequency 与 CPU ratio 数值。这些已存储的数值可以同步至OC Panel 设备，提供用户可以在 OS 下进行调校，而无须进入 BIOS 菜单进行。另外，这些数值也可以通过 OC Panel 做更改！



CPU Input Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器的输入电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，更改的范围从 0.800V 至 3.040V。

BCLK Frequency [Auto]

本项目提供您调整 BCLK 频率。更改的数值范围从 60 MHz 至 300 MHz。

CPU Ratio [Auto]

本项目用来设置 CPU 核心时序与前端总线频率的比值。请使用 <+> 或 <-> 按键来调整。设置值会随着所安装的处理器而有不同。

Load Default

本项目用来载入 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 默认值。重置 Load Default 所有数值请选 [Auto]。

Save Above Settings

本项目提供您存储新设置好的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 设置值。

Load from profile

本项目提供您载入前一次的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 设置值。

3.10 退出 BIOS 程序（Exit menu）

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。你也可以由 Exit 菜单进入 EZ Mode。

Load Optimized Defaults

本项目可让您载入 BIOS 程序设置菜单中每个参数的默认值。当您选择本项目或按下 <F5>，便会出现一个确认对话窗口，选择 Yes 以载入默认值。

Save Changes & Reset

当您完成对 BIOS 设置程序所做的更改后，请选择本项目或按下 <F10>，将会出现一个确认对话窗口，请选择 Yes 以存储设置并退出 BIOS 设置程序。

Discard Changes & Exit

本项目可让您放弃所做的更改，并恢复原先存储的设置。在选择本项目或按下 <Esc>键后，将会出现一个确认对话窗口，请选择 Yes 以放弃任何设置并载入原先存储的设置，同时退出 BIOS 设置程序。

ASUS EZ Mode

选择本项目可进入 EZ Mode 菜单。

Launch EFI Shell from filesystem device

本项目可以让您由含有数据系统的设备中启动 EFI Shell（shellx64.efi）。

3.11 更新 BIOS 程序

华硕网站上提供有最新的 BIOS 程序，可以强化系统的稳定度、兼容性或运行性能，但是运行 BIOS 程序更新是具有潜在性风险的，若是使用现有版本的 BIOS 程序都没有发生问题时，**请勿手动运行更新 BIOS 程序**。不适当的 BIOS 程序更新可能会导致系统启动失败。若有需要，请使用以下各节的方法来更新您的 BIOS 程序。

请访问华硕网站（http://www.asus.com.cn）来下载本主板最新的 BIOS 程序。

1. EZ Update：在 Windows 操作系统中更新 BIOS 程序。
2. ASUS EZ Flash 2：使用 U 盘来更新 BIOS。
3. ASUS CrashFree BIOS 3：当 BIOS 文件遗失或损毁时，可以使用 U 盘或主板的驱动程序与应用程序光盘来更新 BIOS。
4. ASUS BIOS Updater：在 DOS 环境下，使用主板驱动程序与应用程序光盘与 U 盘来更新并备份 BIOS。

上述软件请参考相关章节的详细使用说明。

推荐您先将主板原始的 BIOS 程序备份到 U 盘中，以备您往后需要再次安装原始的 BIOS 程序。请使用 ASUS Update 或 ASUS BIOS Updater 来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

3.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以让您在 Windows 操作系统下，用来更新主板 BIOS 文件的应用程序。

- 在使用 EZ Update 之前，请先确认您已经经由内部网络对外连接，或者经由网络服务提供商（ISP）所提供的连接方式连接到互联网。
- 这个程序可以在主板附赠的驱动程序及应用程序光盘中找到。

3.11.2 华硕 EZ Flash 2

华硕 EZ Flash 2 程序让您能轻松的更新 BIOS 程序，可以不必再通过启动盘的冗长程序或是到 DOS 模式下运行。

请至华硕网站 http://www.asus.com.cn 下载最新的 BIOS 程序文件。

请依照以下步骤通过 EZ Flash 2 更新 BIOS 程序：

1. 将存储有最新的 BIOS 文件的 U 盘插入 USB 接口。
2. 进入 BIOS 设置程序的 Advanced Mode，选择 Tool > ASUS EZ Flash Utility，接着请按下 <Enter> 键。

3. 请使用 <Tab> 键操控至 Drive 字段。
4. 请利用上/下方向键找到存放有最新 BIOS 文件的 U 盘，接着请按下 <Enter> 键。
5. 请使用 <Tab> 键操控 Folder Info 区域。
6. 请利用上/下方向键找到 U 盘中最新的 BIOS 文件，接着请按下 <Enter> 键开始 BIOS 更新操作。当 BIOS 更新操作完成后请重新启动电脑。

- 本功能只支持采用 FAT 32/16 格式的单一磁区 U 盘。
- 当更新 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅 3.9 退出 BIOS 程序 一节中 Load Optimized Defaults 项目的详细说明。

3.11.3 华硕 CrashFree BIOS 3

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序，让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或毁损时，可以轻松的从驱动程序及应用程序光盘，或是从含有最新或原始的 BIOS 文件的 U 盘中恢复 BIOS 程序的数据。

在驱动程序及应用程序光盘中的 BIOS 程序版本可能会比官方网站上的 BIOS 程序版本旧，若是想要使用更新的 BIOS 程序，请至 http://support.asus.com 网站下载，并存储在便携存储设备中。

恢复 BIOS 程序

请依照下列步骤使用应用程序光盘恢复 BIOS 程序：

1. 启动系统。
2. 将主板的应用程序光盘放入光驱，或是将含有最新或原始的 BIOS 文件的 U 盘插入 USB 接口。
3. 接着工具程序便会自动检查光盘或存储设备中是否存有 BIOS 文件。当搜索到 BIOS 文件后，工具程序会开始读取 BIOS 文件并自动进入 ASUS EZ Flash 2 程序。
4. 系统需要您进入 BIOS 程序来恢复 BIOS 设置，为了确保系统的兼容性与稳定性，推荐您按下 <F5> 按键来载入 BIOS 程序的默认值。

当更新 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

3.11.4 华硕 BIOS Updater

华硕 BIOS Updater 让您可在 DOS 环境下更新 BIOS 程序，还可以用来复制现有的 BIOS 文件，当您的 BIOS 程序在更新过程中失败或中断时，可以作为备份使用。

以下的程序画面只能参考，您实际操作的画面可能会与手册所示的画面不尽相同。

更新 BIOS 之前

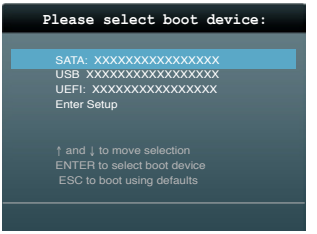
1. 准备本主板的驱动程序与应用程序光盘，以及 FAT32/16 格式且单一磁区的 U 盘。
2. 访问华硕网站 http://support.asus.com 下载最新的 BIOS 程序与 BIOS Updater，然后存储在 U 盘。

- DOS 环境下不支持 NTFS 格式，请勿将 BIOS 文件与 BIOS Updater 存储在 NTFS 格式的 U 盘。
- 请勿将 BIOS 程序存储在软盘，以免软盘的容量不够使用。

3. 将电脑关机，并移除连接所有的 SATA 硬件设备（选购）。

DOS 环境下启动系统

1. 将存有最新 BIOS 文件与 BIOS Updater 的 U 盘插入 USB 接口。
2. 启动电脑，当 ASUS 标识出现时，按下 <F8> 来显示 **BIOS 启动设备选择菜单**。将驱动程序与应用程序光盘放入光驱，然后选择光驱作为启动磁盘。



3. 当 **制作软盘** 菜单出现时，通过按下项目号码来选择 **FreeDOS command prompt** 项目。
4. 当 FreeDOS 出现时，输入命令 **d:**，然后按下 <Enter>，将磁盘 C（光驱）改为磁盘 D（U 盘）。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:
D:\>
```

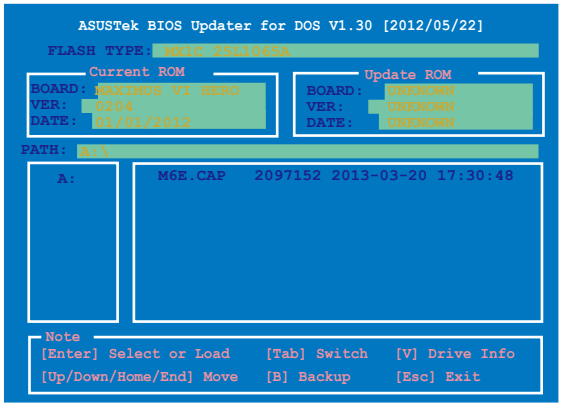
更新 BIOS 文件

请依照以下步骤更新 BIOS 文件：

1. 当 FreeDOS 出现时，输入命令 bupdater /pc /g，然后按下 <Enter>。

```
D:\>bupdater /pc /g
```

2. 接着会出现如下图所示的 BIOS Updater 画面。



3. 按 <Tab> 按键切换画面，使用 <Up/Down/Home/End> 按键选择 BIOS 文件后，按 <Enter> 键，BIOS Updater 检查所选的 BIOS 文件后，会弹出确认更新的画面。

4. 选择 Yes 后按 <Enter> 键，当 BIOS 更新完成时，按 <ESC> 键退出 BIOS Updater 并重新启动电脑。

请勿在 BIOS 进行更新时，运行关机或重新启动电脑，以防止 BIOS 更新失败。

- BIOS Updater 1.04 或更新的版本在更新 BIOS 之后会自动退出更新程序回到 DOS 模式。
- 请载入 BIOS 程序的默认值以确保系统的兼容性与稳定度。在 退出 BIOS 程序（Exit menu）菜单 选择 Load Optimized Defaults。
- 在完成 BIOS 更新后，请确认将刚刚移除的 SATA 硬件设备连接至 SATA 接口。

4.1 安装操作系统

- 本主板支持 Microsoft® 32-bit/64-bit Windows® 7 与 32-bit/64-bit Windows® 8 操作系统（OS，Operating System）。
- 由于主板和外围硬件设备的选项设置繁多，本章只就软件的安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的信息。

4.2 驱动及应用程序 DVD 光盘信息

随货附赠的驱动及应用程序 DVD 光盘包括了数个有用的软件和应用程序，将它们安装到系统中可以强化主板的性能。

华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘的内容会不定时地更新，但不另行通知。如欲得知最新的信息，请访问华硕的网站 http://www.asus.com.cn。

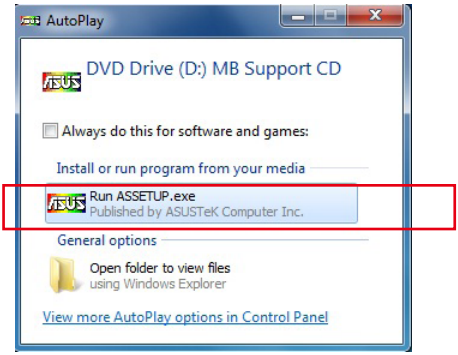
4.2.1 运行驱动及应用程序 DVD 光盘

当您安装 AI Suite 3 至 Windows® 7 或 Windows® 8 操作系统前，请确认您有 Administrator（主管理者）的帐号。

欲开始使用驱动及应用程序 DVD 光盘，只需将光盘放入您的光驱中即可。若您的系统已启动光驱「自动播放」的功能，那么稍待一会儿光盘会自动显示华硕欢迎窗口和软件安装菜单。

请依照以下步骤来运行驱动及应用程序 DVD 光盘：

1. 将驱动及应用程序光盘放入光驱中。
2. 当显示 AutoPlay（自动运行）对话框时，点击 Run ASSETUP.exe（运行 ASSETUP.exe）。



如果欢迎窗口并未自动出现，那么您也可以到驱动及应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。

驱动及应用程序 DVD 光盘主菜单

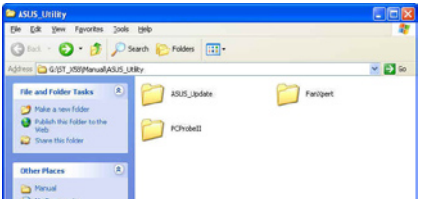
4.2.2 取得软件用户手册

您可在驱动程序 DVD 光盘中找到软件用户手册，请依照以下步骤来取得您需要的软件用户手册。

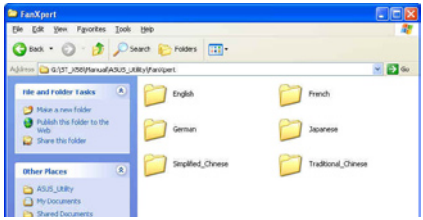
软件用户手册文件为 PDF 格式，在您开启用户手册文件前，请先安装 Adobe® Acrobat® Reader 浏览软件。

1. 点击 Manual（用户手册）项目，由列表中选择 ASUS Motherboard Utility Guide。

2. 进入 Manual 文件夹后，在您需要的用户手册文件夹用鼠标左键点二下。



3. 请由数个语言的用户手册中选择您需要的用户手册。



本章节的图标只能参考，在驱动程序 DVD 光盘中所包含的软件用户手册，会依照您所购买的型号而有不同。

4.3 软件信息

驱动程序及应用程序光盘中大部分的应用程序都会有安装指导向导来协助您一步一步轻松地安装软件。您也可以由个别软件所提供的在线说明档或读我档取得安装方式及其他信息的说明。

4.4 华硕 AI Suite 3 程序

通过友善的用户界面，华硕 AI Suite 3 程序将所有的华硕独家功能集成在一个软件套件中，可以同时操控并运行各项功能及应用程序。

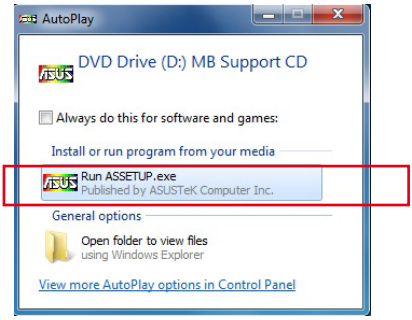
安装华硕 AI Suite 3 程序

当您安装 AI Suite 3 至 Windows® 7 或 Windows® 8 操作系统前，请确认您有 Administrator（主管理者）的帐号。

安装华硕 AI Suite 3 程序至电脑中

Windows® 7 操作系统

1. 将应用程序光盘放入光驱中。
2. 在 AutoPlay（自动运行）对话框里，点击 Run ASSETUP.exe（运行 ASSETUP.exe），然后选择 Utilities（应用程序）标签页。



3. 从 Utilities（应用程序）标签页中，点击 AI Suite 3，然后依照画面上的指示完成安装。

Windows® 8 操作系统

1. 放入应用程序光盘至光驱中，并依照画面的指示操作。
2. 从华硕主板驱动及应用程序主菜单里，点击 Utilities（应用程序）标签页，然后点击 AI Suite 3 程序。
3. 依照画面上的指示操作。

   若华硕主板驱动及应用程序主菜单并未自动显示，请试着用以下方式操作：

   a. 进入 Start Screen（开始），然后点击 Desktop（桌面）应用程序。

   b. 在 Desktop（桌面）的左下角，点击 File Explorer（文件总管） 然后选择您的 DVD 光驱，再点击或双按 Setup（设置）应用程序。

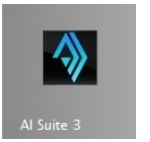
运行华硕 AI Suite 3 程序

Windows® 7 操作系统

- 从 Desktop（桌面），点击 Start（开始）> All Programs（所有程序）> ASUS > AI Suite 3 > AI Suite 3 后进行开启。
- 您也可以在 Windows® 7 系统桌面的下方任务栏上点击 AI Suite 进行开启。

Windows® 8 操作系统

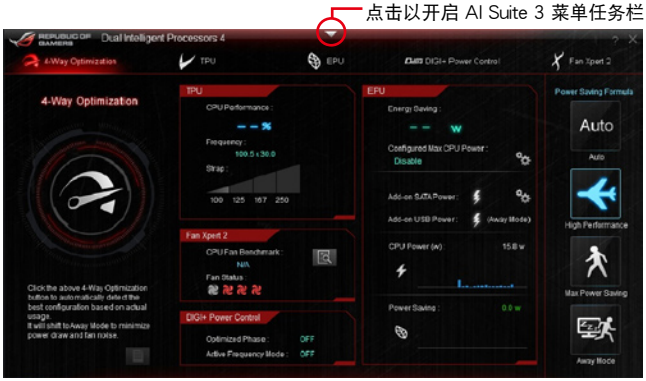
若在 Windows® 8 系统中运行 AI Suite 3 程序，点击位于 Start Screen（开始画面）中的 AI Suite 3 程序进行开启（或若是您使用鼠标操作，请点击在 Start Screen（开始画面）上的 AI Suite 3 应用程序图标。



AI Suite 3 主画面

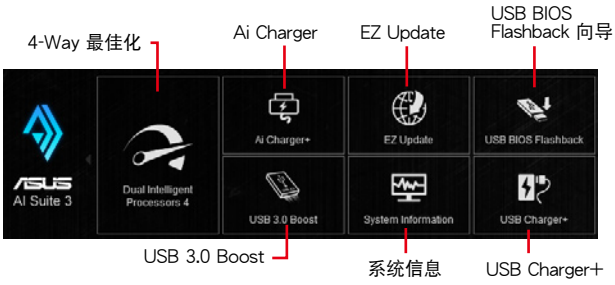
AI Suite 3 主画面提供您轻松进入控制和了解电脑发生了什么状况 - 能提供您将性能做最佳化设置，并同时确保系统的稳定性。

AI Suite 主画面包含一个快速进入的主菜单任务栏，可以让您快速开启任何集中在这里的华硕应用程序。点击在主画面上方 ▼ 图标便可以开启此主菜单任务栏。



AI Suite 3 主画面只能参考，请以您实际看到的画面为准。

AI Suite 3 主菜单任务栏



- 本章节的画面只能参考，请以您实际看到的画面为准。
- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或是访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。

4.4.1 Dual Intelligent Processors 4

Dual Intelligent Processors 4 界面包含五个工具程序：

4-Way Optimization、TPU、EPU、DIGI+ Power Control 以及 Fan Xpert 2。

在某些主板上，Dual Intelligent Processors 4 会在运行 AI Suite 3 程序时出现。

4-Way Optimization（4-Way 最佳化）

4-Way Optimization 工具程序可让您自动将 TPU、EPU、DIGI + Power Control 以及 Fan Xpert 2 调整为最佳设置。

在设置过程中请勿移除风扇。

TPU（TurboV Processing Unit）

华硕 TPU 可让您手动调整 CPU 频率、CPU Cache 与 Core 频率、DRAM 频率以及相关电压值以增加系统稳定并提升性能表现。

在调整 CPU 电压前，请先参考 CPU 说明文件。设置过高电压可能会造成 CPU 永久损害；电压设置过低可能会导致系统不稳定。

为求系统稳定，TurboV 中做的所有更改都不会存储至 BIOS 程序中，同时也不会保留至下次启动。请使用 Save Profile 功能存储您自订的超频设置，并在启动后手动载入设置档。

使用 TPU

CPU Frequency

点击 ◀ 或 ▶ 以调整 Base Clock Frequency、CPU Ratio、与 CPU Ring Ratio

点击 ▶ 或 ◀ 以选择核心数进行调整

点击以应用更改

点击以载入已存储的设置档

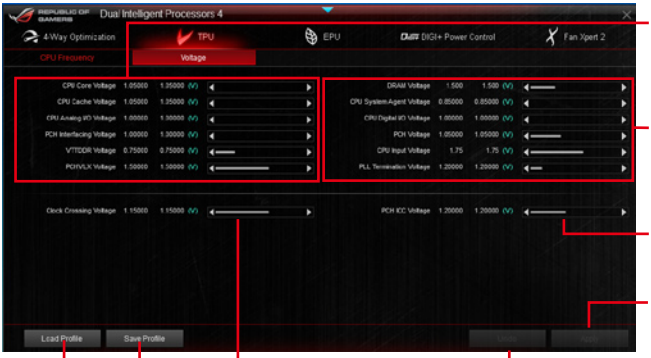
点击以将更改存储至设置档

勾选以启 Group Tuning

点击以不作更改

- 在使用 TPU 的 CPU Frequency 功能之前，请将 BIOS 程序中的 CPU Ratio Setting 项目设为 [Auto]。更多细节请参考主板用户手册中 BIOS 程序设置 章节中的说明。
- CPU Frequency 状态栏显示 CPU 的核心状态，视您的 CPU 型号而定。

Voltage



拖曳滑杆以调整 CPU Core、CPU Cache、CPU Analog I/O、PCH Interfacing、VTTDDR 以及 PCHVLX 电压

拖曳滑杆以调整 DRAM、CPU System Agent、CPU Digital I/O、PCH、CPU Input 与 PLL Termination 电压

拖曳滑杆以调整 PCH ICC 电压

点击以应用更改

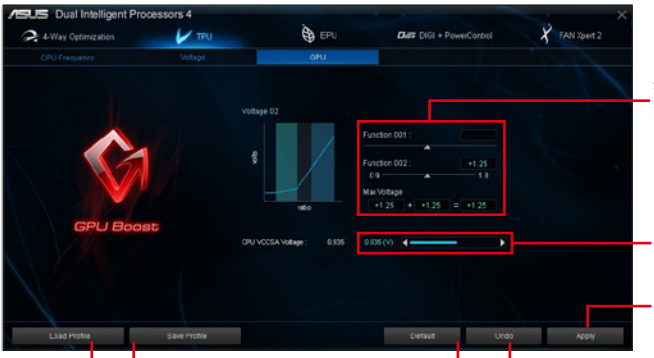
点击以不作更改

点击以载入已存储的设置档

点击以将更改存储至设置档

拖曳滑杆以调整 Clock Crossing 电压

GPU Boost



拖曳 ▲ 以调整 iGPU 最大电压

点击 ◀ 或 ▶ 以调整 CPU VCCSA 电压

点击以应用更改

点击以不作更改

点击以载入已存储的设置档

点击以将更改存储至设置档

点击以开启默认值

- 超频性能视 CPU 型号与系统设置而定。
- 推荐您提供一个更佳的散热环境以避免过热造成主板损害。

EPU（Energy Processing Unit）

EPU 是电力处理单元，可让您调整 CPU、GPU 与 Fan Control 设置至省电状态。

使用 EPU

- 当您启动 Configured Max CPU Power 以求高级省电状态时，Windows® 操作系统信息中的 CPU 频率可能会显示为 800 MHz。然而 CPU 频率会根据您手动设置的功率数值而有所不同。您可以根据您偏好的默认值将 CPU 功率调至最低。
- 启动 Configured Max CPU Power 可能会降低在重系统负载情况下的 CPU 供电量并影响 CPU 性能。要将系统恢复至默认值，请重新启动。

DIGI+ Power Control

DIGI+ Power Control 可让您调整 VRM 电压与频率以获得最佳化系统效率、全系统的稳定与性能。

CPU Power

您可以设置以下 CPU Power 项目：

- CPU Power Duty Control

  CPU Power Duty Control 调整每个 VRM 相式电流与每个零组件的散热状态。

- CPU Load-line Calibration

  CPU Load-line Calibration 调整电压范围并控制系统温度。较高的 load-line calibration（负载校正）会得到更高的电压与更佳的超频性能，但会增加 CPU 与 VRM 工作温度。

- CPU Current Capability

  CPU Current Capability 提供超频更充裕的电力供应。较高的数值设置会增加 VRM 的耗电量。

- CPU Power Thermal Control

  较高的温度可为 CPU 电源带来更宽广的散热范围并延伸超频容许度以提升超频性能。

- CPU Power Phase Control

  CPU Power Phase Control 通过在重系统负载情况下增加相式数以得到更快更佳的散热性能；在轻系统负载情况下减少相式数以增加 VRM 效率。

  * 当使用 Intel iGPU 时，系统会自动将默认值设为 [Extreme]。

- CPU Voltage Frequency

  CPU Voltage Frequency 影响 VRM 的反应时间与散热组件。较高的 VRM 频率反应时间更短。

DRAM Power

您可以设置以下 DRAM 项目：

- DRAM Power Phase Control

  选择 Extreme 以全相式模式增加系统性能或选择 Optimized 以 ASUS 最佳化相式调校模式以提升 DRAM 电力使用效率。

- DRAM Current Capability

  较高的数值带来更宽广的电力供应范围同时并延伸超频频率范围。

- DRAM Voltage Frequency

  可让您调整 DRAM 切换效率维持系统稳定或增加超频范围。

- 实际表现性能将依使用的处理器与内存型号而异。
- 请勿将散热系统移除，散热情况应受到监控。

Fan Xpert 2

FAN Xpert 2 会自动检测与调整所有风扇的速度，并依照风扇的规格与位置提供最

使用 Fan Xpert 2

点击任一窗口以选择您要自订的风扇类型

点击以将风扇速度设置为 silent 模式

点击以将风扇转速调至最大

点击以调整风扇噪音与转速间的平衡设置

点击以切换至 CPU 或机箱风扇

点击提高风扇转速以获得更佳冷却效果

自订风扇设置：

Smart Mode

Smart Mode 可让您根据系统温度自订风扇转速与反应速度。

点击并拖曳以设置风扇转速

点击并拖曳滑杆调整风扇反应速度

点击以返回至前一个窗口

点击以切换至 CPU 或机箱风扇窗口

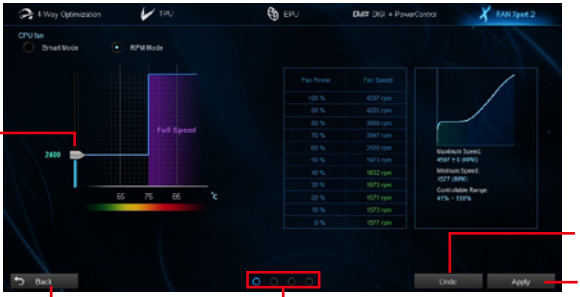
点击以不作任何更改

点击以应用更改

第四章

RPM Mode

RPM Mode 可让您设置当 CPU 温度低于 75℃ 时的风扇转速。



- 当 CPU 温度达到 75℃ 时，风扇会自动以全速运行以保护 CPU。
- 在未配备 CPU 风扇检测闩的主板上，Fan Xpert 2 只能控制 4-pin 的 CPU 风扇。
- 若是风扇有外接控制套件来控制转速，FAN Xpert 2 可能无法检测风扇的转速。
- Fan Xpert 2 并不支持 2-pin 风扇。如果您安装 2-pin 风扇，风扇只能以全速运行。
- 若 CPU 或机箱风扇已经更改，Fan Auto Tuning 程序应重新进行。

在 Fan Auto Tuning 设置过程中请勿移除风扇。

4.4.2 EZ Update

EZ Update 应用程序让您可以轻松地自动更新主板的软件、驱动程序以及 BIOS 版本。

通过这个程序，您可以手动更新 BIOS，并选择开机自检（POST）时想要用来显示的启动图标。

运行 EZ Update

若要运行 EZ Update，请点击 AI Sutie 3 主菜单上方的 图标，然后点击 EZ Update。

EZ Update 主画面

EZ Update 需要经由局域网或 ISP（网络服务供应商）所提供的互联网连接。

4.4.3 华硕 USB 3.0 Boost 程序

华硕 USB 3.0 Boost 程序可提升 USB 3.0 设备的传输速度，并支持 USB 连接 SCSI 协议（UASP，USB Attached SCSI Protocol）。通过华硕 USB 3.0 Boost 程序，可轻松提升您的 USB 3.0 设备之传输速度。

运行华硕 USB 3.0 Boost 程序

若要运行 USB 3.0 Boost，请点击 AI Sutie 3 主菜单上方的 图标，然后选择 USB 3.0 Boost。

使用华硕 USB 3.0 Boost 程序

1. 请将 USB 3.0 设备连接至 USB 3.0 接口。
2. 从 USB 3.0 Boost 窗口选择一个 USB 设备。
3. 若要启动 USB 设备的 UASP 功能，请点击 UASP。若要还原为正常的传输率，请点击 Normal。

USB 3.0 Boost 主画面

- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获得软件设置的详细说明。
- 使用 USB 3.0 设备来获得高性能表现，数据传输的速度会依照 USB 设备的不同而改变。

4.4.4 系统信息

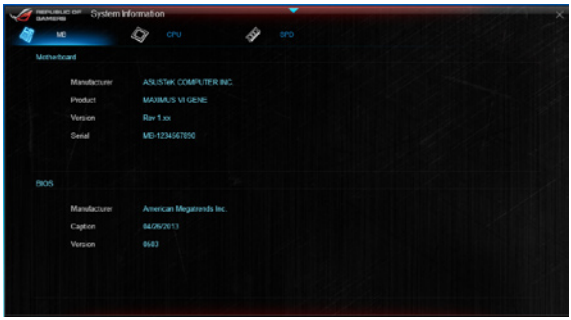
这个程序可以让您获得本主板、处理器与内存设置的详细信息。

运行系统信息

若要运行系统信息，请点击 AI Sutie 3 主菜单上方的 图标，然后选择 System Information（系统信息）。

查看主板信息

从系统信息主画面，点击 MB（主板） 标签页来查看主板的相关信息。



查看处理器信息

从系统信息主画面，点击 CPU（处理器） 标签页来查看处理器的相关信息。

查看 SPD 信息

从系统信息主画面，点击 SPD 标签页来查看内存的相关信息。

4.4.5 USB BIOS Flashback 向导

USB BIOS Flashback 向导可以查看并将最新版 BIOS 程序存储至 USB 存储设备，配合 ASUS USB BIOS Flashback 的硬件特色，让您不需重新启动即可更新 BIOS 程

USB BIOS Flashback 向导画面

设置下载 BIOS 更新的排程

1. 请于 Download Setting（下载设置） 中勾选 Schedule (days)（排程），并选择下次进行下载更新的天数。
2. 请点击 Apply 应用更改，或是点击 Cancel 以取消更改。

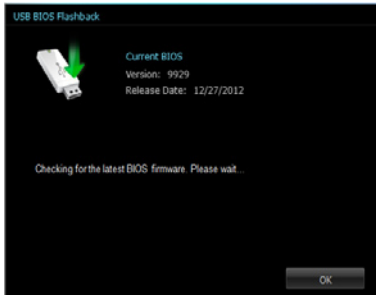
下载最新版 BIOS

下载前请先确认已经将支持 USB BIOS Flashback 的 USB 存储设备连接至电脑的 USB 接口。请参考 2.3.1 **後面板接口** 一节的详细说明。

请依照以下步骤下载最新版 BIOS：

1. 在 USB BIOS Flashback 主画面中点击 Check for New BIOS Update 查看是否有 BIOS 固件更新可下载。

   请等待系统确认最新版的 BIOS 固件版本。



4.4.6 USB Charger+

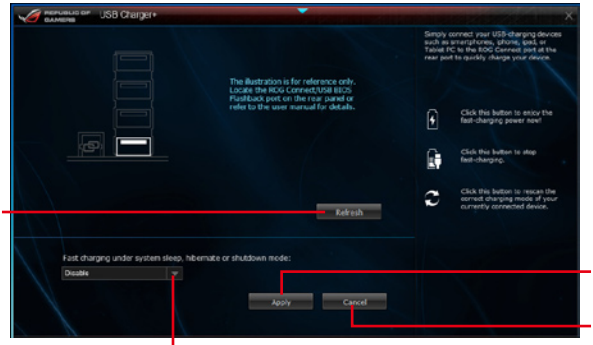
USB Charger+ 用来快速充电您的便携 USB 设备，即使在电脑关机、睡眠状态或休眠状态仍可进行充电。

在使用 USB Charger+ 之前，请先确认关闭在 BIOS 设置中 Advanced 模式的 Advanced > APM > ErP Ready 的 Erp Ready 选项。

运行 USB Charger+

若要运行 USB Charger+，请点击 AI Sutie 3 主菜单上方的 图标，然后选择 USB Charger+。

USB Charger+ 主画面



点击来检测已连接的 USB 设备

点击以应用设置

点击以取消应用设置

点击您想要在系统关机时进行充电的 USB 设备类型

请确认将您的 USB 设备连接至支持本程序之 USB 接口。请参考 2.3.1 後面板接口 一节的详细说明。

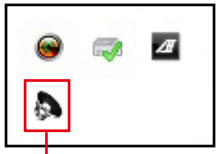
- USB Charger+ 不支持 USB 集线器、USB 延长线及一般的 USB 排线。
- 由于特殊设计的因素，USB Charger+ 可能无法辨识某些 ASUS 设备。

4.4.7 音频设置程序

本主板内置一个支持八声道音频输出功能的 Realtek 音频处理芯片，可以让您通过电脑体验前所未有的音响效果。这套软件提供接口自动检测（Jack-Sensing）功能、支持 S/PDIF 数码音频输入/输出、中断功能等。Realtek 音频芯片也拥有 Realtek 独家的通用音频接口（UAJ，Universal Audio Jack）技术，让用户可以享受即插即用的便利性。

请依照安装向导的指示来安装 Realtek 音频驱动程序与应用程序，您可以在华硕驱动程序光盘中找到这个 Realtek 音频驱动程序与应用程序。

当 Realtek 音频驱动程序与应用软件安装完成后，您可以在右下方的任务栏上找到 Realtek HD Audio Manager 图标。在任务栏的 Realtek HD Audio Manager 图标上以鼠标左键点二下就会显示 Realtek HD 音频控制面板。



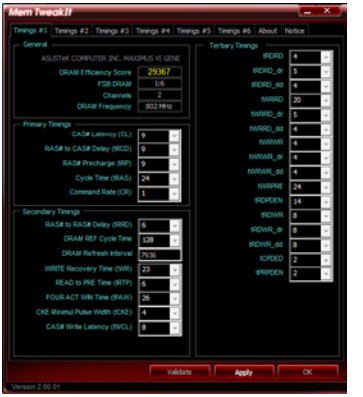
Realtek® HD Audio Manager

A. Windows® 8 / Windows® 7 操作系统下的 Realtek® HD Audio Manager

4.5 MemTweakIt

MemTweakIt 是一套软件，提供您查看各等级的内存时序。您可以验证 MemTweakIt 设置，以生成内存性能的得分，可以在 ROG 网页上分享或与其他用户比较。

要开启此功能，请使用鼠标左键双按桌面上的 图标。



点击 About 标签页然后点击 REPUBLIC OF GAMERS 可以进入 ROG 官方网页

点击 OK 以离开 MemTweakIt

验证和存储您的 MemTweakIt 设置

请依照以下方式验证与在在线存储您的设置值：

1. 开启 MemTweakIt 后点击 Validate（验证）。
2. 在 Online Mode（在线模式），输入您的华硕 Account（帐号）与 Password（密码）后，点击 Submit（提交）。

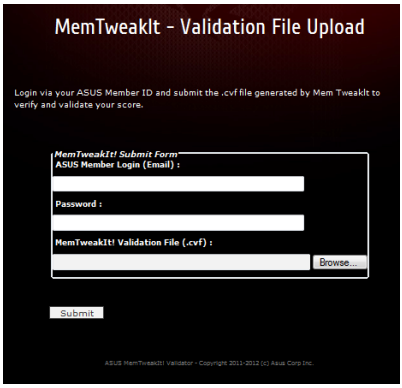
您的设置值将会显示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 网页）上。

手动设置 validate（验证）与存储您的设置值：

1. 开启 MemTweakIt 后，点击 Validate（验证）。
2. 在 Manual Mode（菜单模式）中，点击 Save Configuration File（存储设置文件）。

Validation
Online Mode
Login via your ASUS Member ID (Email) to validate your score !
Account
Password
Submit
Forgot your password?
If you are not an ASUS Member, please register here.
What is an ASUS Member ID?
Manual Mode
Step #1 : Save your current settings as a validation file on your hard drive (use the button below).
Save Validation File
Step #2 : Submit your validation file on the validation web page.
If the validation succeeds, you will get an ID.
OK

3. 针对您的设置文件输入一个文件名，然后点击 Save（存储）。
4. 点击 validation webpage。
5. 在 MemTweakIt - Validation File Upload 窗口中，输入您的 account ID（帐号）与 password（密码）。
6. 点击 Browse（浏览），找到存储 .cvf 文件的位置后，点击 Open（开启）。
7. 点击 Submit（提交）。


MemTweakIt - Validation File Upload
Login via your ASUS Member ID and submit the .cvf file generated by Mem TweakIt to verify and validate your score.
MemTweakIt! Submit Form
ASUS Member Login (Email) :
Password :
MemTweakIt! Validation File (.cvf) :
Browse...
Submit

您的设置值将会显示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 网页）上。

4.6 RAMDisk

RAMDisk 是数据存储软件，使用部分系统内存将它变成一个高速的虚拟磁盘，提供您在此存储缓存文件与游戏程序，而能达到立即读取。RAMDisk 允许您自动备份、更新与恢复文件。

下列的文件夹并非为最适合的 RAMDisk 最佳化，移动它们至 RAMDisk 可能会对您的系统生成负面的影响。

- Swap file/Page file（交换文件/页面文件）：Swap file 是一个永久的存储空间，由系统内存的虚拟内存所延伸。移动 Swap file至 RAMDisk 容易发生全部占有的缺点，而可能会影响系统性能。
- Startup folders（启动文件夹）：当 RAMDisk 在启动时一起载入汇合的文件夹内容时，更改启动文件夹的区域可能会导致系统异常并且关闭载入您的 RAMDisk。

请点击

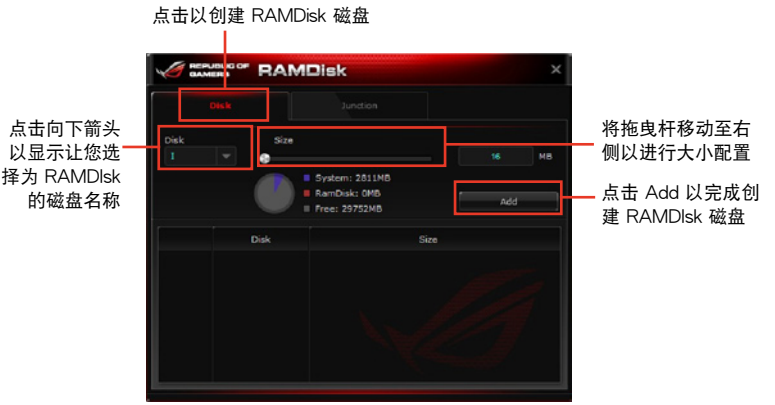
以开启 RAMDisk。

创建/删除 RAMDisk 磁盘

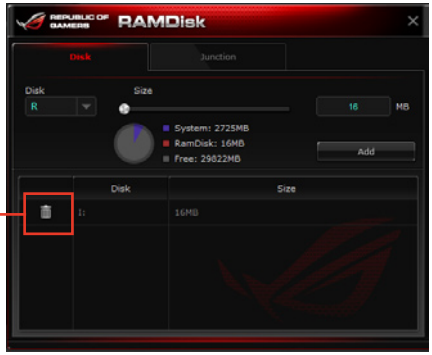
RAMDisk 磁盘提供放置您最爱的应用程序与文件至 RAM（内存）里，这么一来便可以更好地运用内存速度，以获得最佳的读取/写入性能。当您的电脑每次关机时，存储在 RAMDisk 里的文件则会自动进行备份。

启动可能需要一段等待时间，视您的 RAMDisk 磁盘大小而定。

创建 RAMDisk 磁盘：



删除现有的 RAMDisk 磁盘：

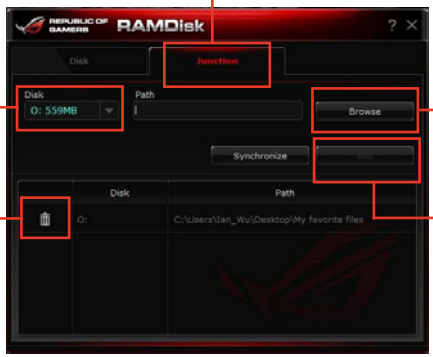


点击以删除现有的 RAMDisk 磁盘.

Creating/Deleting（创建/删除）一个 Junction Point（结点）

Junction Point 创建一个链接，可以重新对应 RAMDisk 的原始内容，启用读取需要的应用程序或文件作为原始文件位置。

选择 Junction 字段以创建 Junction Point（结点）



点击向下键以选择 RAMDisk 磁盘与其可用的存储空间.

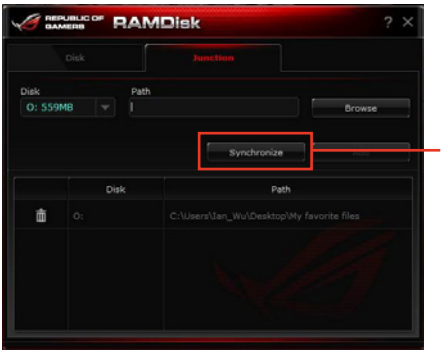
点击 Browse（浏览）以选择创建一个结点

点击以删除现有的结点

点击 Add（增加）来创建一个新结点

Synchronizing backup files（同步备份文件）

在完成创建结点（junction point）后，RAMDisk 会自动创建一个文件夹在原始的位置。使用 RAMDisk 以手动方式同步更新这些备份文件。

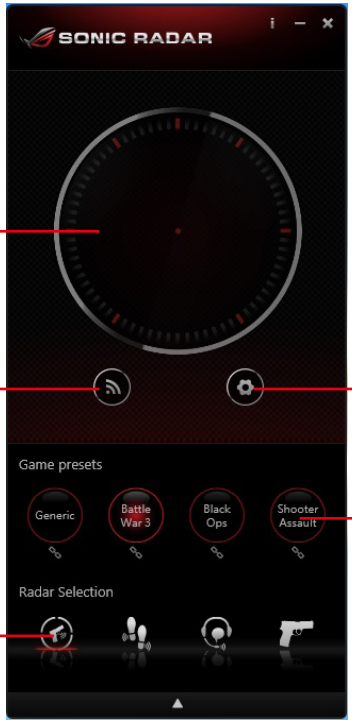


点击 Synchronize（同步）来更新文件

4.7 Sonic Radar

打破在线实战遊戏的传统模式，ROG 独家开发的Sonic Radar 可以重复堆栈在遊戏画面上，帮助您实时得知对手和队友所在的具体位置。屏幕上的雷达可精确显示枪声、脚步声等来源，以提供更好的情报，不给对手任何攻击偷袭的机会。

除了可以将所有的音效视觉化并呈现在雷达画面上，Sonic Radar 还提供了“Enhancer”（增强）功能，可以放大想要的带宽并同时将其余的部分最小化，让您更清楚地听到威胁所在。



Sonic Radar 的视觉显示

Game Detection 图标可以自动检测并选择游戏默认的首要选项

点击以设置 Sonic Radar 画面上所显示的威胁音频

点击以设置 Sonic Radar 的流畅度、透明度和放置的位置

点击以选择不同的 FPS 游戏默认

4.7.1 快捷键和功能

玩家可以自行订定快捷键来切换不同的选项，而无须在离开游戏后才能设置。

功能	说明	默认快捷键
隐藏/显示快捷键	这项功能可以隐藏/显示 Sonic Radar	右 <Ctrl> +数字键 0 键
降低不透明度	这项功能可以降低 Sonic Radar 显示的透明度	左 <Ctrl> + 左<Alt> + <+> 键
增加不透明度	这项功能可以增加 Sonic Radar 显示的透明度	左 <Ctrl> + 左<Alt> + <-> 键
切换雷达的位置	这项功能可以将 Sonic Radar 显示在屏幕的 9 个不同的位置上	左 <Ctrl> + 左<Alt> + Q 键
调整雷达大小	这项功能可以将 Sonic Radar 画面以 3 种不同大小显示	左 <Ctrl> + 左<Alt> + S 键
切换雷达选项（Radar selection）	这项功能可以更改 Sonic Radar 显示	左 <Ctrl> + 左<Alt> + D 键
启用/关闭 Enhancer	这项功能可以启用/关闭音频 Enhancer（增强）	左 <Ctrl> + 左<Alt> + F 键

4.7.2 Perfect Voice（完美声音）

完美的声音是单音麦克风降噪的解决方案，适用于 VOIP 软件。其主要具备两个功能：Noise Gate 和 Noise Reduction，介绍如下：

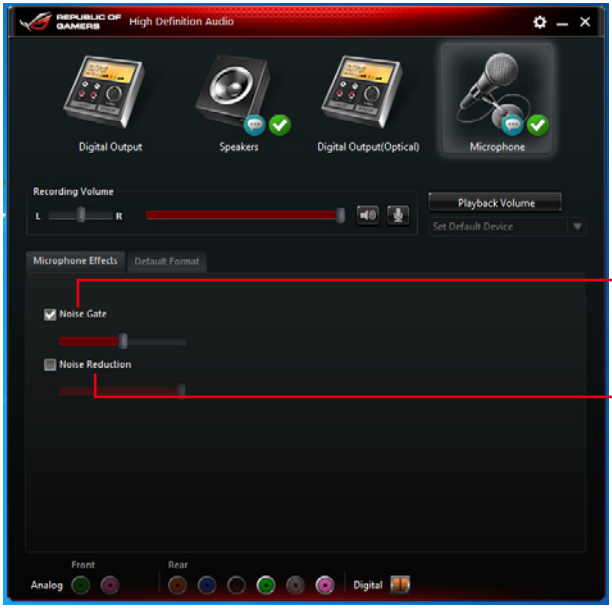
Noise Gate

Noise gate 提供在字词和句子之间降低环境噪声。例如：停顿和周期的沈寂。

推荐的 Noise gate 等级是 30% 左右，设置较高的等级，可能会影响来源数据。

Noise Reduction

分析并估算字词和句子之间的环境噪声的量，并尽量减少环境噪声。



勾选以启用 Noise Gate，并拖曳滑杆以调整想要的等级

勾选以启用 Noise Reduction，并拖曳滑杆以调整想要的等级

第五章

5.1 RAID 功能设置

本主板内置 Intel® 芯片组，可以让您通过 Intel® Rapid Storage 技术来设置 RAID 0、1、5 与 RAID 10 磁盘数组。

若您想要使用设置有 RAID 磁盘数组的硬盘来启动系统，请在安装操作系统到选定的硬盘之前，先将应用程序 DVD 光盘内的 RAID 驱动程序文件复制至软盘中。请参考 5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘 一节的说明。

5.1.1 RAID 定义

RAID 0 的主要功能为「Data striping」，即区块延展。其运行模式是将磁盘数组系统下所有硬盘组成一个虚拟的大硬盘，而数据存取方式是平均分散至多颗硬盘，是以并行的方式读取/写入数据至多颗硬盘，如此可增加存取的速度，若以二颗硬盘所建构的 RAID 0 磁盘数组为例，传输速度约为数组中转速最慢的硬盘的二倍速度。整体而言，RAID 0 模式的磁盘数组可增加数据传输的性能与速率。

RAID 1 的主要功能为「Data Mirroring」，即数据映射。其运行模式是将磁盘数组系统所使用的硬盘，创建为一组映射对应（Mirrored Pair），并以平行的方式读取/写入数据至多颗硬盘。而写入至各个硬盘的数据是完全一样的，在读取数据时，则可由本组内所有硬盘同时读出。而 RAID 1 模式的磁盘数组最主要就是其容错功能（fault tolerance），它能在磁盘数组中任何一颗硬盘发生故障的情况时，其它硬盘仍可以继续动作，保持系统不中断运行。即使数组中某一颗硬盘损毁时，所有的数据仍会完整地保留在磁盘数组的其它硬盘中。

RAID 5 的主要功能为将数据与验证信息加以延展，分别记录到三部或以上的硬盘中。而 RAID 5 数组设置的优点，包括有取得更理想的硬盘性能、具备容错能力，与更大的存储容量。RAID 5 数组模式最适合的使用范畴，可用于交叉处理操作、数据库应用、企业资源的规划，与商业系统的应用。这类型的数组模式，最少需要三部硬盘方可进行设置。

RAID 10 的主要功能为「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 与 RAID 1 之所长，不但可运用到 RAID 0 模式所提供的高速传输速率，也保有了 RAID 1 模式的数据容错功能，让您不但享有高速的数据传输功能，对于数据的保存也无后顾之忧。

5.1.2 安装 Serial ATA（SATA）硬盘

本主板支持 Serial ATA 硬盘。为了最佳的性能表现，当您要创建数组模式设置时，请尽可能采用具备相同型号与容量的硬盘。

请依照以下安装方式来建构 SATA RAID 磁盘数组。

1. 将硬盘安装至硬盘槽中。
2. 安装硬盘连接排线，将欲建构磁盘数组的硬盘连接至主板。
3. 将 SATA 电源线连接到每一部硬盘。

5.1.3 在 BIOS 程序中设置 RAID

在您开始创建数组之前，您必须先在 BIOS 程序设置中设置对应的 RAID 选项。请依照下列步骤进行操作：

1. 在启动之后系统仍在内存的开机自检（Power-On Self Test，POST）时，按下 <Delete> 按键进入 BIOS 设置程序。
2. 进入主菜单（Main）后，选择 **Advanced > SATA Configuration** 选项，然后按 <Enter> 键。
3. 将 **SATA Mode** 选项设置为 [RAID Mode]。
4. 存储您的设置值并退出 BIOS 程序。

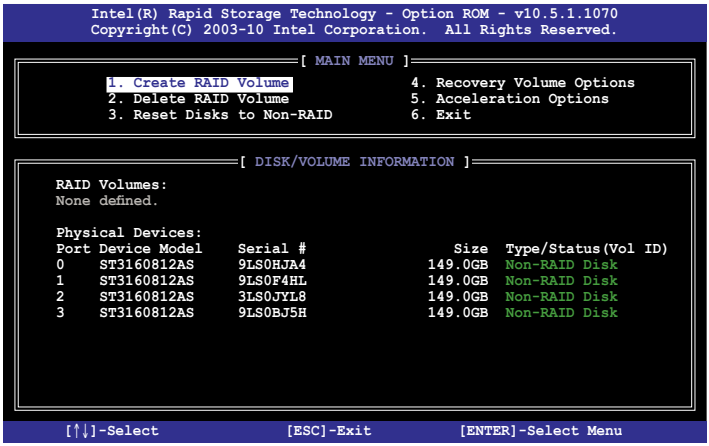
关于如何在 BIOS 中针对菜单进行浏览与输入，请参考第三章的相关说明。

由于芯片的限制，当您设置 SATA 接口为 RAID 时，所有的 SATA 接口均会以 RAID 模式运行。

5.1.4 进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序

请依照下列步骤来进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序：

1. 启动您的电脑。
2. 当系统运行开机自检（POST）时，按下 <Ctrl> + <I> 键来进入应用程序主菜单。



在屏幕下方的 navigation 导览键可让您移动光棒到不同的选项并选择菜单中的选项。

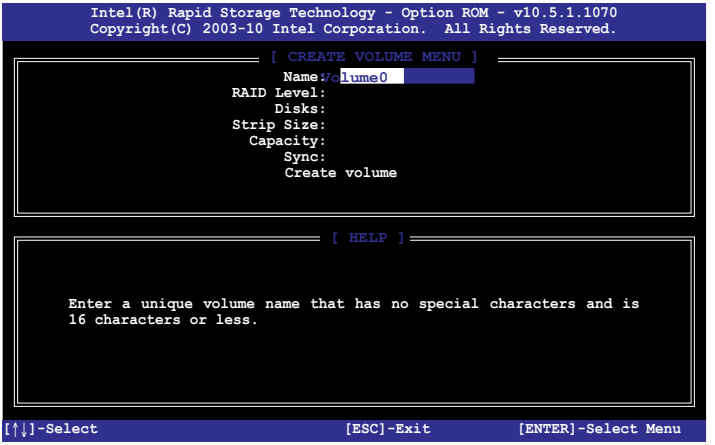
本节中的 RAID BIOS 设置画面只能参考之用，故所显示的画面与实际设置画面可能稍有不同。

本应用程序可以支持四个硬盘进行 RAID 设置。

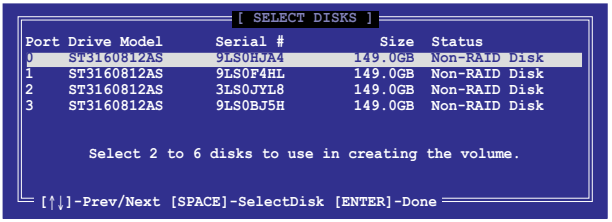
创建 RAID 设置

请依照下列步骤创建 RAID 设置：

1. 选择 1. Create RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键，会出现如下图所示的窗口画面。



2. 为您的 RAID 磁区键入一个名称，然后按下 <Enter> 按键。
3. 使用向上、向下方向键来选择您想要的 RAID 层级，然后按下 <Enter> 按键。
4. 当 Disk 选项出现，请按下 <Enter> 按键以便选择要进行数组设置的硬盘设备。接着如下图所示的画面便会出现。



5. 请使用向上、向下方向键来选择硬盘设备，确认后请按下 <Space> 按键来进行选择。接着被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当要进行数组设置的硬盘设备选择完毕后，请按下 <Enter> 按键。
6. 使用向上、向下方向键来选择 RAID 磁盘数组（RAID 0、RAID 10、RAID 5）要分区的容量，然后按下 <Enter> 按键。分区的数值可由 4KB 递增至 128KB，数据分区的数值应该以硬盘使用的目的来决定。下列为推荐：

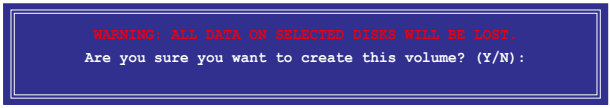
   RAID 0: 128KB

   RAID 10: 64KB

   RAID 5: 64KB

若此系统欲作为服务器使用，推荐您选择较低的磁区大小；若此系统欲作为多介质电脑用来运行影音的编辑制作，推荐您选择较高的磁区大小来获得最佳的性能。

7. 输入您所要的数组容量，接着按下 <Enter> 按键。本项目默认值是采用最高可容许的磁盘容量。
8. 在 Create Volume 的提示对话框中再按下 <Enter> 按键来创建磁盘数组，接着便会出现如下图的窗口画面。



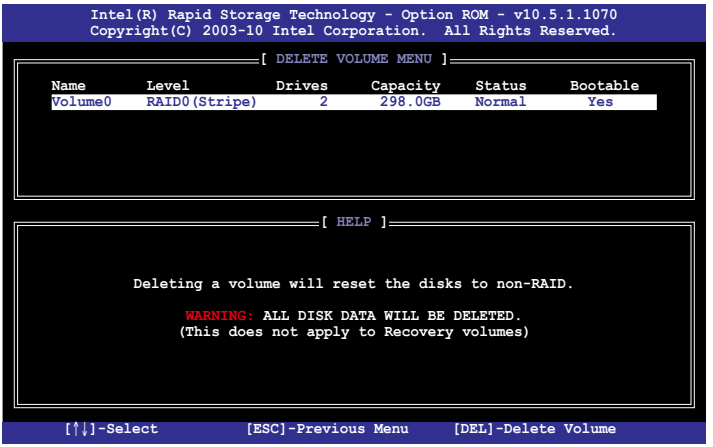
9. 按下 <Y> 键创建数组并回到主菜单，或是按下 <N> 键回到 CREATE VOLUME MENU（创建数组标签）菜单。

删除 RAID 数组

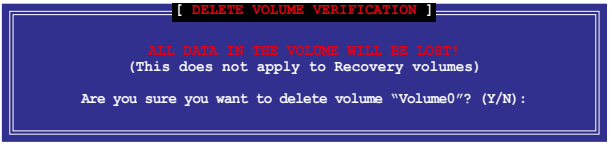
当您要删除 RAID 设置时请小心，存储在硬盘中的数据会被全部删除。

请依照以下步骤删除 RAID 数组：

1. 选择 2. Delete RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键，会出现如下图所示的窗口画面。



2. 使用向上、向下方向键来选择您想要删除的 RAID 设置，然后按下 <Del> 按键。接着如下图所示的画面便会出现。



3. 按下 <Y> 键删除 RAID 并回到主菜单，或是按 <N> 键回到 DELETE VOLUME MENU（创建数组标签）菜单。

离开 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序

请依照以下步骤离开应用程序：

1. 选择 5. Exit 然后按下 <Enter> 按键，会出现如下图所示的窗口画面。

2. 按下 <Y> 按键来离开应用程序，或是按下 <N> 回到主菜单。

5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘

当您欲在拥有 RAID 设置的硬盘中安装 Windows® 操作系统时，您需要准备一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘。

本主板没有软驱插槽，请使用 USB 软驱来创建 SATA RAID 驱动程序的软盘。

5.2.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在不进入操作系统状态下创建 RAID/SATA 驱动程序软盘：

1. 开启您电脑的电源。
2. 当进行 POST 开机自检时按下 <Del> 键进入 BIOS 程序设置。
3. 将光驱设置为主要启动设备。
4. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
5. 存储更改并退出 BIOS 程序设置。
6. 当菜单出现时，点击 **制作驱动程序软盘** 标签页，按下 <1> 来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
7. 将已格式化的软盘放入 USB 软驱中，并按下 <Enter> 键。
8. 依照屏幕的指示完成驱动程序软盘的创建。

5.2.2 在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘：

1. 启动 Windows 操作系统。
2. 连接 USB 软驱并将软盘放入软驱中。
3. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
4. 点击 **制作驱动程序软盘** 标签页，接着点击 **Intel AHCI/RAID Driver Disk** 选项来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
5. 选择 USB 软驱。
6. 依照屏幕指示完成驱动程序软盘的创建。

请将驱动程序软盘切换为防止写入以避免遭受电脑病毒的感染。

5.2.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序

请依照下列步骤在 Windows® 7 安装 RAID 驱动程序：

1. 当安装操作系统时，选择 Load Driver。
2. 将搭载有 RAID 驱动程序的软盘/U 盘安装软驱/USB 接口，并点击 Browse。
3. 请选择您的设备后，选择 Drivers > RAID，并选择 RAID 驱动程序文件再按 OK。
4. 请依照屏幕指示来完成驱动程序的安装。

在从 U 盘载入 RAID 驱动程序之前，您必须使用另一台电脑来将应用程序光盘中的 RAID 驱动程序复制到 U 盘。

华硕的连络信息

华硕电脑（上海）有限公司

市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路508号
电话：86-21-54421616

技术支持

免费服务电话：免费技术支持专线：
800-820-6655
400-620-6655
020-28047506
传真：86-21-54420088
互联网：http://www.asus.com.cn/

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路15号
电话：886-2-2894-3447

技术支持

免费服务电话：0800-093-456
传真：886-2-2890-7798
互联网：http://tw.asus.com/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
电话：+1-510-739-3777
传真：+1-510-608-4555
互联网：http://usa.asus.com/

技术支持

电话：+1-812-282-2787
传真：+1-812-284-0883
在线支持：http://support.asus.com/

ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
电话：+49-2102-95990
传真：+49-2102-959911
互联网：http://www.asus.de
在线连络：http://www.asus.de/sales
（只回答市场相关事务的问题）

技术支持

电话：+49-2102-95990 ...主板/其他产品
：+49-2102-959910 ...系统/笔电/Eee/LCD
传真：+49-2102-959911
在线支持：http://support.asus.com/

* 从德国拨号采固网的费率每分钟 0.14 欧元；行动电话的费率每分钟 0.42 欧元。

附件二

符合性聲明書
Declaration of Conformity

報驗義務人代碼 Code of the applicant	編　　號 Number
D33005	

本符合性聲明書應依商品檢驗法規定備齊相關技術文件後始得簽具
Please check all the related technical documents in accordance with the Commodity Inspection Act before signing the form.

報驗義務人：華碩電腦股份有限公司
Obligatory Applicant

地址：台北市北投區立德路 150 號 4 樓
Address

電話：02-2894-3447
Telephone

商品中（英）文名稱：主機板 (Motherboard)
Commodity Name

商品型式（或型號）：MAXIMUS VI HERO
Commodity Type （Model）

符合之檢驗標準及版次：CNS 13438 : 95 年完整版 (乙類) (Class B)
Standard(s) and version

試驗報告編號：134242R-ITTWP01V04
Test Report Number

試驗室名稱及代號：快特電波股份有限公司(SL2-IN-E-0043)
Testing laboratory name and designation number

符合性聲明檢驗標識及識別號碼：
The form of the DoC marking appears like this

D33005

或
or

D33005

茲聲明上述商品符合商品檢驗法符合性聲明之規定，若因違反本聲明書所聲明之內容，願意擔負相關法律責任。

I hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration of Conformity requirements stipulated in the Commodity Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations against the Declaration of Conformity occur.

報驗義務人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（簽章）
Obligatory Applicant　　（Signature）

中　華　民　國　一百零二　年　五　月　二　日
DATE　　（year）　（month）　（day）

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : MAXIMUS VI HERO

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature :

Date : **May 06, 2013**

Ver. 120601

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Motherboard**
Model name :	**MAXIMUS VI HERO**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2008+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☐1999/5/EC-R &TTE Directive

☐ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☐2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

☒CE marking

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 06/05/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____